神鋼パンテック技報 1990・Vol.34・No.3 121 SHINKO PANTEC ENGINEERING REPORTS

目次

CONTENTS

- = 特別講演抄録 =
- 1 分 級
- 8 CFDによる撹拌槽内流動解析
- 15 PMX-98 化学プラントへの適用例
- 22 静電気によるGLの損傷とその対策
- 28 内部ジャケット付リアクターの溶接技術
- 32 高粘度液用薄膜蒸発機「エクセパ」の蒸発性能
- 37 イオンスクラバー実装置紹介
- 40 新型球状充填材の開発
- 44 深層曝気装置による貯水池の水質改善
- 49 エマルジョン型高分子凝集剤
- 52 社内ニュース

The Classification

Flow Analysis for a Stirred Tank by Computational Fluid Dynamics (CFD)

PMX-98 Application to The Chemical Plant

Troubles of Glass Lined Equipments by Static Electricity and Countermeasures against |‡

Welding Engineering in Reactor with Inner Jacket

The Evaporating Performance of The Thin Film Evaporator "EXEVA" for High Viscous Products

Full Size lon Scrubber

Aptitude Tests of Newly Developed Spherical Media at Anaerobic Bio Reactor (AB Reactor)

Improvement of Impounded Water Results Achieved by Use of Hypolimnetic Aerator

Application of New Emulsion Type Synthetic Flocculants

TOPICS



(写真説明)

ポリマーの高品質化、高機能化が進む高分子化学工業界 では高粘度化、高温化する製品の処理に適した経済的で高 性能な機器へのニーズが高まっています。

このようなユーザニーズに応えて当社が開発した高粘度液 用薄膜蒸発機EXEVA(エクセパ)は、超高粘度物質の脱 溶剤、脱モノマー、脱揮を可能とした新しいタイプの薄膜 蒸発機です。

In the polymer chemistry where development of higher quality and performance polymer is booming, there is a growing stemand for more economical and higher efficient equipment suitable for processing more highly viscous and higher temperature products. To meet such users' needs, Shinko Pantec has developed the "EXEVA" the new type of film evaporator for handling such highly viscous liquids. The "EXEVA" is capable of removing solvent, monomer and volatile products from liquids having ultrahigh viscosity —特別講演抄録—





講師 東京大学生産技術研究所 助教授 工学博士 山 本 英 夫 Dr. Hideo Yamamoto



This is the abridgement of the lecture given by Dr. H. Yamamoto.

To estimate a classifier or to confirm the sharpness of particle size distribution, it is required to measure particle size. The wrong way of measurement leads to the scattering of products however.

On this abridgement, principles of classification are introduced and then the estimation of classifier and the measurement of particle size are explained.

まえがき

粒子の大きさが本当に揃っているのかどうか,あるいは この粒子を揃える機械は性能がいいのかという評価をする ためには,粒子の粒度分布を測定しなければなりません。 この粒度分布の測定方法を間違えると製品が非常にばらつ き,品質に対する信頼度が薄いものになってしまいます。 本講演では,まず分級原理の解説を行い,分 級結果の評価方法と粒子の粒度について説明 を行います。

1. 分級の目的と分級原理

粒子を分けることを一般に分級と呼んでい ますが,はじめに分級の定義を明確にしてお きたいと思います。分級とは、字のごとく級 (クラス) に分けることを意味します。特性 が連続的に異なる粒子群から、目的とする特 性範囲だけに区切って、いくつかの集団に分 けていく操作を一般に分級と呼んでいます。 特性としては、粒子の大きさだけでなく、粒 子の形状、粒子の密度、電気的な性質、化学 的な組成の違いや色の違いもあります。こう いった特性が連続的に異なり広い幅を持った 粒子の集合体の中から、ある特殊な範囲だけ を選びだして区切っていくという操作を分級 といいます。ただし多くの場合、単に分級と いえば、主に粒子の大きさに注目してある種 の大きさの幅に区切って行くこと,いわゆる 粒度分級を意味します。それでは,現在どの くらいまで粒度分級が可能かといいますと, だいたいミクロンオーダーぐらいまでは技術 が確立しているといえます。しかし1µm以 下のものについては大変難しいといわざるを

えません。

第1図は、種々の粒子の大きさを比較したものです。 100 μ mから1Åまでの範囲で粒子の大きさを比較してい ます。また、粒子を作る方法として、粉砕法いわゆるプレ イクダウン法と粒子を合成して作るビルディングアップ法 を用いた場合の粒子製造の限界、並びに各粒子測定方法の



Building up

第1図 粒子径と測定方法

Fig. 1 Particle sizes and measurement methods

第1表 材料と粒径範囲 Table 1 Materials and spheres of particle size

-	
Materials	Spheres of particle size
Powder metallurgy	500~ 10 μm
Fine ceramic	$1 \sim 0.1 \ \mu m$
Toner for electrophotography	$15\sim 5 \mu \mathrm{m}$
Resistance, dielectric substance	$5 \sim 0.5 \mu \mathrm{m}$
Magnetic substance for sintering	$5\sim 0.05 \mu\mathrm{m}$
Material for menbrane	$1 \sim 0.01 \ \mu m$
Carrier for electrophotography	$0.1 \sim 0.01 \ \mu m$
CVD	0.8∼0.005 µm
Ultra-fine metal catalyst	$0.05 \sim 0.005 \ \mu m$
Magnetic fluid	$0.01 \sim 0.001 \ \mu m$

Geometric classification



第2図 古典的粒度調整法 Fig. 2 Classical methods to regulate particle size

測定可能範囲も示しております。第1表に,実際に工業的 規模で使われている粒子の大きさを示します。最近注目を 浴びているファインセラミックスは,1~0.1 μm 程度いわ ゆるサブミクロン領域にあります。焼結性が良くなること から,さらに小さい粒子が望まれているのが現実ですが, ハンドリングが困難なため0.1 μmが限界となっています。 ただし,非常に粒度幅が狭い,粒の大きさの揃った粒子が 望まれております。金属超微粒子触媒など非常に細かい粒 子が用いられていますが,実際に粒度を揃えるのは非常に 難しいことです。

第2図に示します¹⁾ように,分級はその分級原理により, 大きく,幾何学的分級と動力学的分級に分けられます。幾 何学的方法とは篩分けのことであり,動力学的方法とは, 風起しに代表される粒子の大きさにより生じる運動速度の 差を利用して行う分級のことです。

動力学的分級の原理は、粒子と流体との間に相対運動を 起こさせ、その相対運動の差により分級を行うものです。 粒子と流体との間に起こる相対運動の原因には、粒子自身 の動力学的性質である慣性力、ブラウン運動力とエネルギ ー勾配場による重力、遠心力、静電気力、熱泳動力などが 考えられます。基本的な原理はいずれの場合も同様ですの で、ここでは第3図を用い、重力による場合を例に説明し ます。

平行平板状のダクト内に気流を流しておき,粒子を上部 より気流中に導入しますと,粒子には重力が働き,気流中 を沈降し始めます。粒子が沈降し始めると空気より粘性抵



抗を受け始め、 粒子の 沈降速度どともに 粘性抵抗は 増大 し、重力と粘性抵抗がつり合う点で沈降速度は一定となり ます。このことは、雨粒が地表に到達するとき、一定の速 度で落ちてくることを思い浮かべて頂ければ理解しやすい と思います。この一定で沈降する際の沈降速度は、粒径D_p の関数となり、大きい粒径のものほど沈降速度も大きくな ります。今、気流が左から右に流れているところに粒子を 落としますと、粒子は気流に乗り右側に運動しますが、同 時に重力により下方にも沈降しますので、第3図の破線に 沿った方向に運動します。ところが下に向かう速度すなわ ち沈降速度は、粒子が大きいほど大きくなりますから、大 きい粒子は短い時間で下面まで到達し,気流に乗りながら 比較的近い場所に位置することになります。一方、小さい 粒子は非常に沈降速度が遅いため、この気流に乗って遠く まで運ばれた後、下面に沈降することになります。このよ うに粒子の大きさにより下面に到達する距離が異なります ので、各々個別に回収することにより分級が行われること になります。これが分級の基本原理であり、こういった原 理に基づき大きさ別に効率良く分ける装置が種々開発され ております。

粒子と 流体の間に 相対速度を 発生させる ための力とし て、重力と遠心力が容易に想像できるわけですが、この他 に慣性力があげられます。慣性力とは、粒子が流体ととも に流れている場合に、流体の急激な変化に追随しないで同 方向の運動を持続し続けようとする力です。これは、自動 車がカーブする際の体の揺れを想像すると理解しやすいと 思います。このようにある大きさを持った物体が運動をし ているときには、必ず慣性力が存在します。慣性力の大き さは粒子の大きさによって異なりますので、この慣性力を 利用して粒子を分けることもできます。第4回は、粒径と 慣性力や重力、遠心力などによる移動速度を表したもので す。例えば、1 µm の粒子の沈降速度は 0.1 mm/sec 以下 であることが読み取れます。移動速度が大きいほど分級が 容易となりますので、 粒子が 大きいほど 分級が容易であ り, 逆にサブミクロン領域では, 100 G の遠心力でさえ1 秒間に1mm しか移動しなくなり,重力は利用が不可能な 領域となります。



第4図 粒子径と移動速度 Fig. 4 Particle size and mobility



第5図 部分分離効率曲線

Fig. 5 Partial separation efficiency curve

2. 分級の評価と分級効率

実際に分級を行った場合の分級の評価方法として、分級 効率を考えなければなりません。ある分級機に原料を入れ 大きい粒子と小さい粒子に分けた際に、どのような状態に 分かれているのか、本当に大きい粒子と小さい粒子に分か れているのかを評価する必要があります。原料粒子の粒度 分布が第5図に示す³⁰ような分布の場合に、分級機に要求 されていることは、ある大きさから右の部分(大きい粒子) と左の部分(小さい粒子)に分けることですが、実際には 斜線に示すような分布になります。粗粉側に取り出された 粒子は、大きい粒度分布を持ち、微粉側に取り出された粒 子は、小さい粒度分布を持つといった状態となり、ある大



第6図 ターボクラシファイア構造断面図 Fig. 6 Structural cross section of TURBO CLASSIFIER

きさから大きい粒子と小さい粒子に分かれることにはなり ません。したがって、この分級機の性能をどうして評価す るかが問題となりますが、結局はそれぞれの大きさの粒子 が、どのような割合で粗粉側と微粉側に分けられたかによ り評価するしか方法がありません。

その評価の方法は、原料中のそれぞれの大きさの粒子の 分かれ方に着目し、粗粉側に回収された粒子の割合をそれ ぞれの粒子の大きさに対して計算し、部分分離効率曲線な るものを求めて評価を行います。かりに、ある大きさの粒 子を境に完全に粗粉と微粉に分かれた場合には、この曲線 は垂直に立ち上がります。したがって、分級機の性能はこ の部分分離効率曲線の立ち上がり方により評価できます。 この曲線が寝ていれば寝ているほど分級の精度は悪くなっ ていると評価されます。分級後の粒度分布が原料と同じも のであった場合には、この部分分離効率曲線はどの粒子径 においても同じ値を示し、もはや分級機ではなく分割機と でもいわざるをえない状態となります。

それではこの部分分離効率曲線がどの程度立ってくれば よいのかといいますと、目的によって違いはありますが、 非常にシャープといわれる分級機の場合には、部分分離効 率曲線で25%の粒径と75%の粒径の比が1.2~1.4くらい となり、通常のもので2.0くらいまでの値を示すようです。

3. 分級機の実例

分級機は、湿式分級と乾式分級に分けられます。湿式分 級とは水中で分級を行うことであり、乾式分級とは水を使 わないで空気中で分級を行うことです。乾式分級とは水を使 わないで空気中で分級を行うことです。乾式分級はさらに 篩分け、重力分級、慣性力分級、遠心力分級に分類できま すが、なるべく小さい粒子を分級するためには遠心力を使 うことになります。第6図は、この一例であるターボクラ シファイア(日清エンジニアリング製)の構造断面図で す³⁾。高速回転をしている分級ロータにより空気が本体内 部に導入され、粒子と混じり合いながら気流を形成しま す。気流は分級ロータと共に高速にて回転していますの で、同時に遠心力が働きます。大きい粒子には大きい遠心 力が働きますので、気流に対抗して逆方向(半径から遠い 方向)に移動します。ところが小さい粒子には小さい遠心



Fig. 10 Schematic view of virtual impactor

りしか働きませんので、気流に取り込まれてしまいます。 良終的には,大きい粒子は粗粉取出口から,小さい粒子は ↑級ロータ 内を 通って 渦巻ケーシングから 取り出されま **す。**粗粉側から回収された粉体並びに微粉側から回収され こ粉体をサイクロンにて捕集したもの, さらにサイクロン で捕集しきれなかったものをバグフィルターにて捕集した 5のの粒度分布を示したものが第7図です⁴⁾。最初50%粒 圣が 0.7 μm 程度であったものが、この分級機にて処理す 5ことにより、粗粉側で 50 %粒径がだいたい 1.0 μm, 微 分側で 0.6 μm 以下のものに分けることができます。これ よ,かなり優秀な分級機であると考えられます。

また,第8,9図は,慣性力を利用した分級機であるエ レボージェット(日鉄鉱業製)の構造新面図および窒化珪 を分級の部分分離効率曲線です⁵⁾。 2 カ所から空気が高速 こて供給され気流を形成し、気流に向けて供給ノズルから 立子を非常に高速で供給します。気流が形成されていない 場合には粒子は直進しますが、慣性力の小さい粒子すなわ >お粒径の小さい粒子は、この気流により進路を大きく曲げ うれます。中粉は半ば進路を曲げられ、粗粉は慣性力が大 きいために気流を通過します。そして、それぞれの場所に 回収口を設けることにより分級を行います。

第10図は、私共が開発したものであり、インパクター形 式のものを 工業的規模に 発展させた 慣性力式の 分級機で す。(a)は、インパクターの模式図です。ノズルから勢いよ く吹き出した気流の正面に邪魔板を置いておきますと、気 流は大きく曲げられますが,大きい粒子は慣性力により気 流に追随できずに邪魔板にぶつかります。ここに粘着剤を 置いておきますと大きい粒子を回収することができます。 一方小さい粒子は、慣性力が小さいために気流に追随し流 れ出て、分級が行われるという原理です。しかし、粒子が 多くなりますと邪魔板上に粒子がたくさん堆積し粒子の再 飛散が始まりますので,処理量が非常に少なくなるという 欠点があります。

そこで、堆積する粒子を連続的に排出する方法として考 案されたのが(b)の方法です。邪魔板の代わりにノズルを設 置し、ごく一部の気流を下方向に流します。大部分の気流 は横方向に流れますので、原理的には(a)のインパクターと 同様の効果を有し、大きい粒子は慣性力によりノズル内に 飛び込みます。粗粒子はノズル内のごくわずかの気流によ り、取り出すことができます。これは粒子が実際には板に 衝突(インパクト)しない,つまり仮想的なインパクター で「バーチュアルインパクター」と呼ばれています。



100 $u_0 = 20 \text{ m/s}$ $\alpha = 0.67$ Separation efficiency η_{j} [%] $u_{Cl} = 40 \text{ m/s}$ 50 Key M[kg/Nm³] 0.072 Δ 0 0.36 Π 0.62 20 Particle size Dp [µm] 部分分級効率曲線 第13 図 Fig. 13 Partial separation efficiency curve

第11 図 実験装置概要図 Fig. 11 Schematic view of experimental equipment



第12 図 K型分級機概要図 Fig. 12 Schematic view of K-type classifier

ところが、このバーチュアルインパクターにも円型ノズ ル使用による処理量の限界が問題としてあります。このイ ンパクターの分離性に影響を及ぼす因子はノズルの直径で あるために、これを大きくすることは分離性能を悪くする ことになります。したがって、処理量を大きくするために はこのような円筒状では好ましくないこととなります。そ こで(C)のスリットノズルタイプを考案しました。分離性能 はノズルの直径に影響されますので、ノズルの直径と同じ 幅でL方向に延ばされたダクトを作成します。この場合、 粒子の分離性能はダクト幅に影響されることとなりますの で、(b)の方法と同様の分離性能で、なおかつ処理量を増や すことが可能となります。

実際の実験装置を第11図に示します。分級部形状を拡大

したものが右側の図です。粒子は気流と共に上部より分級 部に至り,ごく一部の気流のみ下側に流れます。気流の大 部分は右側に流れますので,小さい粒子は気流に沿って右 側に至り,大きい粒子は下側に回収されます。この装置を 用いることにより,ミクロンオーダーの分級が可能となり ます。ところが実際には,このままではシャープな分離が 行えません。なぜなら,この形のままでは分級のカットサ イズ(分級粒径)は下がりますが,気流が曲がる際にエッ ジの部分に気流の乱れを生じ,渦が発生します。渦が発生 すると粒子は気流に乱されて,きれいな分級ができなくな ります。

きれいな気流の流れをつくるために実際に拡大模型を作成し、煙による気流の可視化を行い、渦ができないような 形に改良したものが第12図の分級機です⁶⁾。供給口から原料を気流と共に供給し、別途粒子の入っていないきれいな 気流を供給します。2つの気流を分級部にて合流させた 後、全流量の大部分を微粉側に流し、ごく少量の気流を粗 粉側に流します。供給された粒子のうち、大きい粒子は気 流の流れに追随できずに粗粉側に回収され、小さい粒子は 気流の流れに沿って微粉側に流れてきます。この装置を使 った分級実験の結果は非常に良く、第13図のように、部分 分離効率曲線が非常に立った状態となっています。

いま,分級部での流速が 20 m/sec の場合において 8~9 μ mの50 %分離径が得られていますが,この流速を速くす ればさらに小さな分離径が得られます。流速を速くすれば するほど,カットポイントは小さくなるわけですが,流速 が変わると慣性力も変わることになりますので,一つの部 分分離効率曲線として表現するためには,粒子の慣性力を 表すファクター(慣性パラメータ)で表現する必要があり ます。慣性パラメータで表示しますと流速が変わった場合 においても,第14図に示すように一つの部分分離効率曲線 として表すことができます。実際に分級部での気流流速が 20 m/secの時に11.4 μ mの分離径が得られ、54 m/secの時 に6.8 μ mの分離径が得られましたので,100 m/sec の時に は 4 μ m,200 m/sec の時には 2 μ m の分離径に達すること が期待されます。この分級機は大変有望な分級機と考えら











第15図 分離効率の低下例

Fig. 15 Example of deterioration in separation efficiency

れましたので、分級機の形状からK型分級機と名付け、現 在実用機として完成させることを考えております。

乾式の分級機と比較して湿式の微粉分級機は現在あまり 存在しません。現在湿式分級機として市販されているもの こは、重力沈降式、遠心式などいくつかありますが、実際 の分級粒径は $10~100 \mu m$ のものしか分級できないのが現 伏です。

4. 粒子の分散と分級性能

分級の粒度とともに重要な要因が分級精度,すなわち分 級のシャープさであります。分級精度を良くするために, まず分級性能を低下させる要因を考え,その問題を解決す る方法を考えることが必要です。一番の問題として粒子の 疑集現象があり,原料をいかに均一に分散させて供給する ことができるかが,分級精度に大きく影響するといえま す。また,分級機内における気流の乱れの問題も大切であ り,このほか反復分級,多段分級により分級精度を向上す ることも考えられます。 第15図は,粒子の凝集現象による分級精度低下の例を示したものです。粒子というものは一個ずつ単独に存在するのではなく,ある集団の状態で存在しています。それを分級機に入れても一個一個の粒子になることはありません。分級機にばらばらに入った場合でも,分級機内でお互いがぶつかり合って,大きい粒子いわゆる凝集粒子になることがあります。このような場合には,いくら優秀な分級機でも精度の著しい低下が避けられません。

いま,第15図において⑤の粒度分布を持った粉体がある とします。この粒度分布は粒子が一個一個ばらばらな状態 のものであります。ところが実際に分級機に入る時には, このような状態ではなく,写真1に示すような凝集体とし て分級機に入り,この凝集体が単一の粒子として振舞いま す。したがって実際に観測される凝集体の粒度分布は,第 15図®または©の粒度分布となり,一次粒子の粒度分布よ り大きい粒度分布となります。これを カットサイズ4µm の非常に優秀な分級機に掛けて分級を行ったとしますと, 本来,粒子が完全に分散されている場合には,微粉側に80 %,粗粉側に20%回収されなければならないものが, の場合には微粉側に30%,粗粉側に70%,さらに©の場 合においては微粉側にわずか5%,粗粉側に95%回収され ることになります。粗粉側の95%の粒子の中には,微粉側 に回収されるべき粒子が多量に混入していますので,もは や分級精度が保てなくなります。このように分級機の性能 を評価する場合には,粒子がいかに分散された状態で供給 されているかを確認することが重要となります。

5. 粒子の粒度と粒度分布測定

分級機の性能評価を行うためには、粒子を分散状態にて 供給するとともに、分級された粒子の粒度分布を正確に測 定する必要があります。第3章で述べましたように、部分 分離効率曲線は分級機の性能を評価する一つの方法です が、この部分分離効率曲線を求めるためには、少なくとも 原料の粒度分布と粗粒側の粒度分布を測定する必要があり ます。この粒度分布の測定の仕方を間違いますと分級機を 正確に評価することができませんので、粒度分布をいかに 正確に測定するかが問題になります。世の中には種々の粒 度分布測定装置がありますが、2つとして同じ結果を出す ものがないといえる程粒度測定方法に問題があるのが現状 です。粒度分布測定原理というのは、基本的には分級原理 と同じです。つまり、粒度分布測定とは大きさ別にどの程 度の数量の粒子があるかを知ることですので、大きさ別に 分けること自体分級と全く同じ訳です。

粒度分布測定装置には、重力沈降式、遠心沈降式、慣性 力式、静電気力式のほか、顕微鏡によるもの、コールター カウンター法や最近脚光を浴びています光散乱法などがあ ります。粉体になじみのない大からは、粒子の大きさを測 定するには、顕微鏡と物差しによる測定で十分ではないか という意見をよく耳にしますが、顕微鏡により測定できる のは球形粒子の場合であり、実際の粒子の場合どこを粒子 直径とするかの判断を下すことが困難です。

粒子の大きさとは何かということを考えてみたいと思い ます。直径 100 μ m の球形粒子と一辺が 80 μ m の立方体の 粒子のいずれの粒子が大きいかを質問するとしますと, 直 径 100 μ m の球形粒子の方が 大きいと答える人が多いでし ょう。ところが, 通過できる円孔の直径を比較しますと, 直径 100 μ m の球形粒子は 直径 100 μ m の円の穴を 通過で きますが, 一辺80 μ m の立方体は通過することができませ ん。

一方, 通過できるスリット幅を比較しますと、 直径100 μmの球形粒子は、幅80 μmのスリットを涌過できません が、一辺80 µmの立方体は通過できます。また、投影面 積,体積に ついては,100 µm の球形粒子 の方が大きくな り、表面積については80 µm の立方体の方が大きくなりま す。したがって何をもって大小を比較するのかが問題とな りますが, 結果的には 粒子の大きさを 利用する 目的によ り, 比較のための 基準を決める 必要が あることになりま す。ふるいを利用する場合には、立方体の方を大きい粒子 と扱い、スリットを利用する場合には、球形粒子の方を大 きい粒子と扱う,つまり,粒子の使い方により粒子の大き さの定義を変えることが要求されます。すなわち、その目 的に応じて, 体積や面積などの幾何学的量, あるいは沈降 速度などの物理量で、粒子の大きさ(粒度)を表現すべき でありますが、便宜的にこれらを一次元の粒径に換算して 用いているわけです。長さの単位で表現した方がわかりや すいように見えるからです。流体分級機においては、流体 中を流れる運動速度が問題となりますから、沈降速度径な るものを定義し、粒子がある等速沈降速度で沈降する場合 に、その速度で沈降する 球形粒子の 大きさで 代表させま す。このように、われわれが粒子の大きさを測定する場合 には、粒子の 目的に応じて 粒子の 大きさを 定義し、粒子 の測定方法を選択しなければなりません。

むす

75

これまで粉砕や分級について、いろいろ話をさせて頂き ましたが、粉砕機または分級機の性能を評価する際には、 粒度分布測定が一番重要になります。しかし、この粒度分 布を測定する装置が現状では完成されたとはいえない状態 にありますので、ユーザ側がその装置に精通して、自分の 目的に応じた粒度分布測定装置を選択し、使いこなす必要 があると考えています。

〔参考文献〕

- 1) 日本粉体工業技術協会編:分級装置技術便覧(1978)
- 2) 化学工学協会編:化学工学の進歩19,粉粒体工学(1985)
- 3) 化学工学協会編:化学工学の進歩19,粉粒体工学(1985)
- 4) 化学工学協会編:化学工学の進歩19,粉粒体工学(1985)
- 5) 日本粉体工業技術協会編:粉体分級技術マニュアル(1990)
- 6) 山本英夫,吉江健一, 菅沼彰:化学工学,第49巻,第1号 (1985), p. 65
- 注:引用図表の表記方法については本技報にあわせて変更してあ ります。

C F D に よ る 撹 拌 槽 内 流 動 解 析

Flow Analysis for a Stirred Tank by Computational Fluid Dynamics (CFD)



The flow structure and mixing mechanism in stirred tank with paddle impeller have been investigated. Navier-Stokes and scaler equations have been numerically solved both in laminar and turbulent flows using finite difference method to obtain the details of the velocity field and concentration distributions. The computed velocity field and mixing process well agree with published data, and they showed that mass transfer between the large scale recirculating flows are suppressed when a number of recirculating flows are generated in the tank. This result suggests that higher mixing efficiency can be attained by controlling the number of circulating flows.

まえがき

撹拌装置は化学プロセスの中で重合反応機あるいは混合 機として広く用いられている。これら撹拌装置内部の流動 機構および熱や物質の輸送機構を正確に把握することは装 置の最適設計・特性解析・トラブル解析を行ううえで重要 である。これら流動機構や輸送機構を解明するには,従来 実装置やモデル装置などを用いて実際に流速や温度, 濃度 を測定する方法がとられているが,撹拌装置内では循環流 や逆流を伴う複雑な3次元流となるので,これらの量を正 確に把握することは困難となる場合が多い。このような場 合には,実験によるよりも数値計算法を用いて流速や物質 などの輸送機構を決定する方が有利となり,種々の条件下 で計算を繰り返すことにより,流れ場の多くの情報を得る ことができる。

近年になって, 撹拌装置内部流動を数値シミュレーショ ンによって解いた例が報告されてきている。撹拌槽の層流 問題については、上ノ山ら¹⁾ がタービン翼の撹拌槽におけ る擬塑性流体の流動状態の3次元数値解析を行っている。 また、大田ら²⁾ はアンカー翼撹拌槽の r-z 平面における解 析を、平岡ら3)4)は、パドル翼撹拌槽の流動解析を行って いる。さらに、梅垣5)は、境界適合法(BFC)を用いて パドル翼並びに後退翼を用いた撹拌槽内3次元流動解析を 行い, 撹拌翼の 形状の違いが 及ぼす流動状態の 変化につ いて考察している。一方撹拌槽の 乱流問題に ついては, Placek ら 6 が k- ϵ モデルを用いてタービン翼撹拌槽の r-z 面における2次元流動解析を行い,流速の計算値を実測値 と比較し良好な一致を得ている。 また, Harvey ら⁷⁾ は, パドル翼撹拌槽の r-z 面における 2 次元流動解析を行って いる。さらに、 Middleton ら⁸⁾ は、 汎用流体解析用コー ドを用いてタービン翼撹拌槽の3次元流動解析を行ってい る。

このように, 撹拌槽内の流動解析は広く行われているも のの,その内容は解こうとする流れに適した支配方程式や モデルの妥当性の検討に限られており, 撹拌装置の最適設 計に有用と考えられる槽内の流れに基づく混合機構の解明 は十分になされていない。 本研究では, 撹拌装置 後載 適款計法の確立を最終目的と して,まず,パドル翼を用いた撹拌槽内の層流および乱流 状態における流動・混合機構を数値計算法を用いて明らか にすることにより, 撹拌槽内の混合に及ぼす流れの影響を 解明することを試みた。

1. 数 值 計 算

1.1 支配方程式

化学装置内で取り扱われる流れのほとんどは、液体であれ気体であれ、非圧縮性流れとみなせる。ここで、撹拌槽 内の流れの方程式を考える時、通常の静止した円筒座標系 ($\mathbf{r}, \theta, \mathbf{z}$) でこれを考えるよりも、撹拌翼と同一角速度で 回転する回転円筒座標系 ($\mathbf{r}, \theta', \mathbf{z}$) で考えた方が、翼を じかに回転させた時に生じる移動境界問題を避けることが できるため、数値計算が容易となる。従って、流れが層流 で取り扱う流体がニュートン流体の場合、支配方程式は次 の偏微分方程式系で表される。

連続の式

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}'}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial \theta} + \frac{\partial \mathbf{w}'}{\partial z} = 0$$
(1)

Navier-Stokes 方程式

$$\frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial \mathbf{t}} + \mathbf{u}' \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\mathbf{v}'}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial \partial \theta} - \frac{\mathbf{v}'^2}{\mathbf{r}} + \mathbf{w}' \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial \mathbf{z}} - 2\omega \mathbf{v}' - \omega^2 \mathbf{r}$$
$$= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{g}'_{\mathbf{r}} + \nu \left(\frac{\partial^2 \mathbf{u}'}{\partial \mathbf{r}^2} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial \mathbf{r}} - \frac{\mathbf{u}'}{\mathbf{r}^2} + \frac{1}{\mathbf{r}^2} \frac{\partial^2 \mathbf{u}'}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{u}'}{\partial z^2} - \frac{2}{\mathbf{r}^2} \frac{\theta \mathbf{v}'}{\partial \theta} \right) \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial \mathbf{t}} + \mathbf{u}' \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\mathbf{v}'}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial \theta} + \mathbf{u}' \frac{\mathbf{v}'}{\mathbf{r}} + \mathbf{w}' \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial z} + \underline{2\omega \mathbf{u}'}$$

$$= -\frac{1}{\rho \mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial \theta} + \mathbf{g}'_{\theta} + \nu \left(\frac{2}{\mathbf{r}^2} \frac{\partial \mathbf{u}'}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 \mathbf{v}'}{\partial \mathbf{r}^2} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{v}'}{\partial \mathbf{r}} + \frac{1}{\mathbf{r}^2} \frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial \theta^2} - \frac{\mathbf{v}'}{\mathbf{r}^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{v}'}{\partial z^2}\right) \quad (3)$$

$$\frac{\partial \mathbf{w}'}{\partial \mathbf{t}} + \mathbf{u}' \frac{\partial \mathbf{w}'}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\mathbf{v}'}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{w}'}{\partial \theta} + \mathbf{w}' \frac{\partial \mathbf{w}'}{\partial z}$$

$$= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial z} + \mathbf{g'}_{z} + \nu \left(\frac{\partial^{2} \mathbf{w'}}{\partial \mathbf{r}^{2}} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{w'}}{\partial \mathbf{r}} + \frac{1}{\mathbf{r}^{2}} \frac{\partial^{2} \mathbf{w'}}{\partial \theta^{2}} + \frac{\partial^{2} \mathbf{w'}}{\partial z^{2}} \right)$$
(4)

物質の輸送方程式

$$\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial r} + \frac{v}{r} \frac{\partial C}{\partial \theta} + w \frac{\partial C}{\partial z}$$

$$= D_m \left(\frac{\partial^2 C}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 C}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 C}{\partial z^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial C}{\partial r} \right) + \dot{d} \quad (5)$$

回転円筒座標系における支配方程式は,式(2),(3)にアン ダーラインで示した遠心力項とコリオリ力項を付加した形 となり,他の項および他の式は両座標系で全く同一となる。 式(1)~(4)を解くことによって得られる流動は,観察者が翼 に乗って翼と同一速度で流れを観察しているイメージに相 当する。従って,境界条件の簡単な回転円筒座標系で速度 分布を計算したあと,次式で静止円筒座標系の速度に変換 することにより実際の速度分布が得られる。

$$u = u'$$

$$v = v' + r\omega$$

$$w = w'$$
(6)

次に、撹拌槽流動系における乱流問題を解明するために は, 翼, 槽壁およびバッフルによって形成される複雑な渦 を計算する必要がある。このための計算方法には層流計算 と同様のダイレクトシミュレーション法がある。しかし, 乱流には空間・時間のスケールのかなり小さな乱れ成分が 存在するため、実際の反応機内流動の高レイノルズ数流れ に対して式(1)~(4)を直接解くことは、現在のところ計算機 容量・計算速度の問題上不可能に近い。そこで、差分法に 基づくダイレクトシミュレーションのもつ記憶容量ならび に計算時間などの問題を解決するために、式(1)~(4)をある 種の平均化操作によって簡略化し,大スケールから小スケ ールまでのすべてのスケールの乱流渦を求めなくても,あ る程度の 近似解を得る 方法がある。この 方法を 乱流モデ ルと呼ぶが、本計算ではその1つの方法として2方程式 $(k-\epsilon)$ モデルをとりあげる。 $k-\epsilon$ モデルは時間平均操作を 施した連続の式および Navier-Stokes 方程式の他に乱流 エネルギー(k)および粘性消散率(ε)の輸送方程式を連立 させて解くことにより流速やスカラー量に対する時間平均 解を得る方法である。k-ε モデルではコルモゴロフスケー ルに代表されるような小スケール渦(100 µm 程度)まで 計算することはできないが, 撹拌槽内の循環流のような大 スケール渦による流れを求めることにより、装置内の大局 的な流動機構を把握することが可能と考えられる6)。

従って、 $k-\varepsilon$ モデルでは、流れの支配方程式として式(1) ~(4)に時間平均操作を施した時間平均 Navier-Stokes 方 程式(7)~(10)式と、次に示す乱流エネルギーと粘性消散率の 輸送方程式(14~(15)を連立させて解くことにより解を得るこ とができる。 時間平均連続の式

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r} \cdot \mathbf{\bar{u}}}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{\bar{u}}}{\partial \theta} + \frac{\partial \mathbf{\bar{w}}}{\partial z} = 0$$
(7)

時間平均 Navier-Stokes 方程式

$$\frac{\partial \overline{\mathbf{u}}}{\partial \mathbf{t}} + \overline{\mathbf{u}} \cdot \frac{\partial \overline{\mathbf{u}}}{\partial r} + \frac{\overline{\mathbf{v}}}{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial \overline{\mathbf{u}}}{\partial \theta} - \frac{\overline{\mathbf{v}^2}}{\mathbf{r}} + \overline{\mathbf{w}} \cdot \frac{\partial \overline{\mathbf{u}}}{\partial z} -$$

$$= -\frac{1}{\rho} \cdot \frac{\partial \overline{\mathbf{P}}}{\partial \mathbf{r}} + \mathbf{g'}\mathbf{r} + \nu \left(\frac{\partial^2 \overline{\mathbf{u}}}{\partial r^2} + \frac{1}{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial \overline{\mathbf{u}}}{\partial r} - \frac{\overline{\mathbf{u}}}{\mathbf{r}^2} + \frac{1}{\mathbf{r}^2} - \frac{\partial \overline{\mathbf{u}}}{\partial r} - \frac{\overline{\mathbf{u}}}{\mathbf{r}^2} + \frac{1}{\mathbf{r}^2} \cdot \frac{\partial^2 \overline{\mathbf{u}}}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \overline{\mathbf{u}}}{\partial z^2} - \frac{2}{\mathbf{r}^2} \cdot \frac{\partial \overline{\mathbf{v}}}{\partial \theta} + \frac{1}{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \tau_{r\theta} + \frac{\partial}{\partial z} \tau_{rg}}$$

$$(8)$$

$$\frac{\partial \overline{\mathbf{v}}}{\partial \mathbf{t}} + \overline{\mathbf{u}} \frac{\partial \overline{\mathbf{v}}}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\overline{\mathbf{v}}}{\mathbf{r}} \frac{\partial \overline{\mathbf{v}}}{\partial \theta} + \overline{\mathbf{u}} \frac{\overline{\mathbf{v}}}{\mathbf{r}} + \overline{\mathbf{w}} \frac{\partial \overline{\mathbf{v}}}{\partial z} + \\
= -\frac{1}{\rho \mathbf{r}} \frac{\partial \overline{\mathbf{P}}}{\partial \theta} + \mathbf{g'}_{\theta} + \nu \left(\frac{2}{\mathbf{r}^2} \frac{\partial \overline{\mathbf{u}}}{\partial \theta} + \frac{\partial^2 \overline{\mathbf{v}}}{\partial \mathbf{r}^2} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial \overline{\mathbf{v}}}{\partial \mathbf{r}} + \frac{1}{\mathbf{r}^2} \frac{\partial^2 \overline{\mathbf{v}}}{\partial \theta^2} - \frac{\overline{\mathbf{v}}}{\mathbf{r}^2} + \frac{\partial^2 \overline{\mathbf{v}}}{\partial z^2} \right) \\
+ \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} - \tau_{r\theta} + \frac{2}{\mathbf{r}} \tau_{r\theta} + \frac{\partial}{\partial z} \tau_{yz} \qquad (9)$$

$$\frac{\partial \overline{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{t}} + \overline{\mathbf{u}} \frac{\partial \overline{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\overline{\mathbf{v}}}{\mathbf{r}} \frac{\partial \overline{\mathbf{w}}}{\partial \theta} + \overline{\mathbf{w}} \frac{\partial \overline{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{z}} \\
= -\frac{1}{\rho} \frac{\partial \overline{\mathbf{P}}}{\partial \mathbf{z}} + \mathbf{g'}_{\mathbf{z}} + \nu \left(\frac{\partial^2 \overline{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{r}^2} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial \overline{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{r}} + \frac{1}{\mathbf{r}^2} \frac{\partial^2 \overline{\mathbf{w}}}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 \overline{\mathbf{w}}}{\partial \mathbf{z}^2} \right) \\
+ \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \tau_{\mathbf{y}\mathbf{z}} + \frac{1}{\mathbf{r}} \tau_{\mathbf{y}\mathbf{z}} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial}{\partial \theta} \tau_{\theta\mathbf{z}} \quad (10)$$

ここで,速度の2乗相関項(レイノルズ応力)は次式で 与えられる。

$$\tau_{\mathbf{r}\theta} = -\mu \left[\mathbf{r} \cdot \frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} \left(\frac{\mathbf{\tilde{v}}}{\mathbf{r}} \right) + \frac{1}{\mathbf{r}} \cdot \frac{\partial \mathbf{\tilde{u}}}{\partial \theta} \right] \tag{1}$$

$$\tau_{\theta z} = -\mu \left[\frac{\partial \overline{\mathbf{v}}}{\partial z} + \frac{1}{\mathbf{r}} \quad \frac{\partial \overline{\mathbf{w}}}{\partial \theta} \right] \tag{12}$$

$$\tau_{zr} = -\mu \left[\frac{\partial \vec{w}}{\partial r} + \frac{\partial \vec{u}}{\partial z} \right]$$
(13)

乱流エネルギーの輸送方程式

$$\frac{\partial \mathbf{k}}{\partial \mathbf{t}} + \mathbf{\bar{u}} \frac{\partial \mathbf{k}}{\partial \mathbf{r}} + \frac{\mathbf{\bar{v}}}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{k}}{\partial \theta} + \mathbf{\bar{w}} \frac{\partial \mathbf{k}}{\partial \mathbf{z}}$$
$$= \frac{\nu_{t}}{\sigma_{k}} \left(\frac{\partial^{2} \mathbf{k}}{\partial \mathbf{r}^{2}} + \frac{1}{\mathbf{r}^{2}} \frac{\partial^{2} \mathbf{k}}{\partial \theta^{2}} + \frac{\partial^{2} \mathbf{k}}{\partial \mathbf{z}^{2}} + \frac{1}{\mathbf{r}} \frac{\partial \mathbf{k}}{\partial \mathbf{r}} \right)$$
$$+ \mathbf{G}_{s} - \varepsilon \qquad (14)$$

粘性消散率の輸送方程式

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} + \vec{u} \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} + \frac{\vec{v}}{r} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \theta} + \vec{w} \frac{\partial \varepsilon}{\partial z}$$

$$= \frac{\nu_{t}}{\sigma \varepsilon} \left(\frac{\partial^{2} \varepsilon}{\partial r^{2}} + \frac{1}{r^{2}} \frac{\partial^{2} \varepsilon}{\partial \theta^{2}} + \frac{\partial^{2} \varepsilon}{\partial z^{2}} + \frac{1}{r} \frac{\partial \varepsilon}{\partial r} \right)$$

$$+ C_{1} \frac{\varepsilon}{k} G_{s} - C_{2} \frac{\varepsilon^{2}}{k}$$
(15)



Boundary conditions

$$\begin{split} \nu_{t} &= C_{t} \frac{k^{2}}{\epsilon} \\ G_{S} &= \nu_{t} \bigg[2 \left\{ \left(\frac{\partial \overline{u}}{\partial r} \right)^{2} + \left(\frac{1}{r} - \frac{\partial \overline{v}}{\partial \theta} + \frac{u}{r} \right)^{2} + \left(\frac{\partial \overline{w}}{\partial z} \right)^{2} \right\} \\ & \left(\frac{1}{r} - \frac{\partial \overline{u}}{\partial \theta} + \frac{\partial \overline{v}}{\partial r} - \frac{\overline{v}}{r} \right)^{2} + \left(\frac{\partial \overline{v}}{\partial z} + \frac{1}{r} - \frac{\partial \overline{w}}{\partial \theta} \right)^{2} + \\ & \left(\frac{\partial \overline{w}}{\partial r} + \frac{\partial \overline{u}}{\partial z} \right)^{2} \bigg] \end{split}$$

$\sigma_{k} = 1.0$	$\sigma = 1.3$	
$C_1 = 1.44$	$C_2 = 1.92$	$C_t = 0.09$

.2 数值解析方法

層流に関する支配方程式(1)~(4)およびそれに付随する拡 な方程式(5)ならびに乱流に関する支配方程式(7)~(15)を,差 >法を用いて解く。なおここでは,差分化の詳細は式が複 性になるため省略する。差分計算は収束を容易にするため こ空間的には風上差分を,時間的には後退差分スキームに こる半陰解法によった。格子にはスタガードグリッドシス こる半除解法によった。格子にはスタガードグリッドシス こを用いた。すなわち,流速を格子面の中心において定 をし,圧力,濃度,乱流エネルギーおよび粘性消散率など ンスカラー量を格子空間の中央において定義した。解く方 呈式群はいずれも時間依存形であるため,計算の収束判定 冬件を

 $|(P^{n+1}-P^n)/P^n| < 0.001$

ただしnは計算ステップ数

:し,この条件を満足するまで繰り返し計算を行った。

Free slip Periodic boundary condition No slip Periodic boundary condition Free slipD=0.2 m d/D=0.5 n=200 rpm fluid viscosity=10 Pa,s Rem=4.7

第4図 境界条件及び計算条件(撹拌槽内層流)

Fig. 4 Boundary and calculating conditions for laminar flow in stirred tank

1.3 計算する問題および境界条件

本研究では, 撹拌槽内の基礎的な流動・混合機構の把握 を目的としているので計算モデルには,

(1) パドル翼を用いた撹拌槽内層流

(2) 多段パドル翼を用いた撹拌槽内乱流(バッフルなし)

(3) ク (バッフルあり)を選定した。

第1~3 図にそれぞれのメッシュ構成を示す。第4 図に 計算(1)の計算条件および境界条件を示す。翼面および壁面 においてすべりなし (no-slip) 条件を, 撹拌槽上下部にす べりあり (free-slip) 条件を与えた。第5 図に計算(2)の計 算条件および境界条件を示す。本計算では, 大スケールか らなるフローパターンのみを知ることを目的としているの Boundary conditions







第6図 翼先端部での半径方向流速分布

Fig. 6 Measured radial velocities at the periphery of the impeller.

で, 翼の吐出部に境界条件として流速の実測値(第6図) を, 壁面の境界条件として対数則速度分布をそれぞれ与え ることにより計算を簡略化した。なお, 槽上部の自由表面 の形状を計算により求めることは困難であることから, そ の形状には写真撮影による実測値⁹⁾を与え, 表面をすべり あり条件とした。この方法を用いればかなり粗いメッシュ でも計算が可能となり, 槽内の循環流を求めることができ ると考えられる。第7図に計算(3)の計算条件および境界条 件を示す。この計算においてもバッフルなしの場合と同様 に, 翼の吐出部に流速の実測値(第6図)を与えた。なお, 槽上部の自由表面には大きな凹凸がみられなかったことか ら, これを水平に近似し, すべりあり条件とした。

本計算では、富士通 FACOM M360 スカラープロセッ サを使用した。定常解を得るのに要する計算時間はケース Boundary conditions



D=0.3 m	d/D=0.5	$h_{b}/D=0.7$	
L/D=1.0	H/D=2.0	n=200 rpm	n
fluid viscosit;	y=0.001 Pa.s	(Water) Rem	≕75 000





(1)で約4時間,ケース(2)および(3)共に約20時間であった。

2. 結果および考察

2.1 撹拌槽内層流(流動機構および混合機構)

第8図にパドル翼を用いた撹拌槽内層流流動の速度ベクトルを示す。翼の回転によって生じた半径方向への吐出流は、槽壁面に衝突して上下方向への循環流に分かれ翼の内側にもどる。これら循環流の速度は、翼の回転速度にくらべてはるかに小さいが、翼の回転数が大きくなって遠心力が増大すると大きくなってくる。第9図に濃度方程式(5)を解いた場合の等濃度線を示す。本計算では、拡散物質を槽上部の自由表面域から瞬間的に投入した(ステップ応答)。投入された拡散物質は時間の経過と共に軸を伝って翼部へ吸い込まれるように移動し、翼部に達した拡散物質は翼の回転によって生じる半径方向吐出流により翼先端部より吐出されている。しかし、この流動系では、撹拌翼よりも上



- 第10図 撹拌槽内乱流(バッフル なし)の流速ベクトル
 Fig. 10 Computed velocity vectors
 - of turbulent flow in stirred tank without baffle.

部に投入された拡散物質は撹拌翼を中心とした軸に垂直な 平面よりも下方へは移動していかない。このことは、上部 の循環流と下部の循環流との間で物質移動がほとんど行わ れないことを示すと同時に、槽内に複数の循環流が存在す る場合には循環流の存在そのものが槽内の効率よい混合を 妨げる要因になることが示唆される。

2.2 搅拌槽内乱流(流動機構および混合機構)

第10図にバッフルがない場合の撹拌槽内乱流流動の速度

ベクトルを示す (\mathbf{r} - \mathbf{z} 面, \mathbf{r} - $\boldsymbol{\theta}$ 面)。層流の場合と同様に, 翼の回転によって生じた半径方向への吐出流は, 槽壁面に 衝突して上下に分かれ翼の内側にもどる。なお, この撹拌 系においては槽内全体に 4 つの大きな循環流を形成する。

計算により求めた速度が実際の流れと一致しているかど うかを検討することは重要である。特に本計算では乱流モ デルを用いて大スケール渦からなるフローパターンを知る ことを目的としていることから,たとえフローパターンが 計算されたとしても,そのシミュレーション結果が真に正 しい解を与えているかを検証しなければならない。ここで は,槽内流速をレーザー・ドップラー流速計(LDV)を 用いて実測したものと比較する¹⁰⁾¹¹⁾。第11図に計算値と実 測値を比較したものを示す。翼から吐出したすぐの流速は 実測値と良好に一致しているが,翼から離れて壁面に近い





第12図 撹拌槽内乱流(バッフルな し)の流速ベクトル Fig. 12 Computed velocity vectors of turbulent flow in stirred tank with baffle.

ところでの流速は実測値からすれてくる。この不一致は, 壁面近くになると流速が遅くなるため,LDVの測定精度 が低下することに起因する。しかし,全体のフローパター ンが実測値¹¹⁾と一致することから,計算結果は妥当である と判断される。

第12図にバッフルがある場合の撹拌槽内乱流流動のフロ ーパターンを示す(**r**-**z** 面, **r**-θ 面)。バッフルなしの場合 と同様のフローパターンを形成しており,全体のフローパ ターンは実測値¹¹⁾とよく一致する。**第10**図と**第12**図を比較 するとバッフル近傍では循環流の流速が3倍程度に強まっ ており,バッフルの存在により2次循環流を起こす能力が 高まる様子がよくわかる。

次に, 撹拌槽内の混合機構を知ることは, 混合時間の最 適化並びに槽内のデッドスペースを予測する上で重要であ る。そこで, 計算により求めた流速分布を用いて混合過程 を予測した。混合過程の予測には, ラグランジュ・ランダ ムフライトモデル¹²⁾を流れ場に適用した。このモデルでは 流れ場に投入した仮想マーカーを流れによる移流速度と分 子拡散の相互作用で移動させることにより, マーカーが装 置内で どのように 挙動するかを 明らかにする ことができ る。このモデルに従えば, r, θ, z 方向のマーカーの位置は 次式で与えられる。

$d\mathbf{r} = \mathbf{u} \cdot d\mathbf{t} + \sqrt{D_m} \cdot dW_d$	
$d\theta = v \cdot dt + \sqrt{D_m} \cdot dW_d$	(16)
$dz = w \cdot dt + \sqrt{D_m} \cdot dW_d$	

格子内のマーカーの位置は格子面上で定義される速度を 内挿して求めた。第13図に自由表面域から投入したマーカ ーが時間の経過と共にどのように動くかを計算した軌跡を 示す。自由表面より投入されたマーカーは上段翼上部の循



第14図 翼先端より投入した仮想マーカーの軌跡Fig. 14 Trajectories of the marked particles thrown into upper and lower impeller regions.

環流域で数回循環し、そのあと上段翼下部循環流域に流れ 込んでいる。これより、多段翼を用いた撹拌槽内部で複数 の循環流を生じる場合、マーカーを自由表面から投入した とすれば、その混合過程としては自由表面近傍の循環流域 から順次下方の循環流域へ混合していく経路をたどる。 第 14図は翼の吐出流域に投入したマーカーの軌跡である。投 入されたマーカーはそれぞれの循環流域を何回も循環し, 一部のマーカーを除き上下方向, つまり循環流間でマーカ -の大きな入れ替えが認められない。さらに,上段翼と下 段翼との間の循環流同士が衝突する部分および槽下部域で マーカーが局所的に滞留する現象(デッドスペース)が起 きている。このことは,単に多段翼にした場合には,流れ がたとえ乱流であっても槽内に形成された複数の循環流同 士の物質交換が促進されないばかりか, 槽内にデッドスペ ースを形成する危険性があることを示す。このことから効 率よい撹拌を達成するための1つの手段として, 槽内に存 在する複数の循環流をうまくコントロールすることによ り,循環流同士の干渉をできるだけなくしてやればよいこ とが示唆される。事実,Komoriら¹¹⁾は撹拌槽において消 費されるエネルギー E = P・T (E:撹拌エネルギー,P :撹拌動力,T:混合時間)を測定して多段撹拌系の撹拌 効率を考察した結果,多段撹拌系において槽内に複数の循 環流が存在する場合には,循環流が少ない場合に較べて撹 拌効率が悪くなることを示している。

むすび

パドル翼を用いた撹拌槽内流動の層流から乱流における 数値シミュレーションを行い,それらの流動・混合機構に ついて考察した。その結果,次に示す結論を得た。

- 1)流動数値シミュレーションにより撹拌槽内の流動・混 合機構を明らかにすることができる。層流計算にはダイ レクトシミュレーションを、乱流にはk-εモデルを適用 することにより得られた計算結果は、実測値などと良好 に一致し、本計算法が実用的に有用であることが示され た。
- 2) パドル翼を用いた撹拌槽内の混合状態は,層流,乱流 のいずれにおいても大スケールの循環流によって支配さ れる。循環流の数が多くなると循環流同士が干渉して物 質移動が抑制されるばかりか,槽内にデッドスペースを 生じる危険性があることが示された。

謝 辞

本研究を行うにあたり,九州大学工学部化学機械工学科 村上泰弘教授,小森悟助教授より 有益な 助言を いただい た。ここに記して感謝します。

(使用記号)

~~~~		
С	:濃度	(mol)
Cı	:モデル定数	
$C_2$	:モデル定数	
C ₃	:モデル定数	
D	:槽径	(m)
$D_m$	:分子拡散係数	$(m^2/s)$
d	:翼径	(m)
ġ	:拡散物質発生量	(mol/s)
$dW_{d}$	:ガウスの白色ノイズプロセス	$(S^{1/2})$
Е	:撹拌エネルギー	(])
gr'	:回転座標系 r 方向重力加速度	$(m/s^2)$
g₀'	:回転座標系 $\theta$ 方向重力加速度	$(m/s^2)$
g _z '	:回転座標系 z 方向重力加速度	$(m/s^2)$
k	:乱流エネルギー	(1)
n	:回転数	
Р	:圧力	(Pa)

P	:時間平均圧力	(Pa)
q	:熱発生量	(J/s)
Reм	:撹拌レイノズル数〔-〕	
r	:静止座標系 r 方向	(m)
r'	:回転座標系 r 方向	(m)
Т	:混合時間	(s)
u	:静止座標系 r 方向速度成分	(m/s)
u'	:回転座標系 r 方向速度成分	(m/s)
ū	:静止座標系 r 方向時間平均速度成分	(m/s)
v	:静止座標系 θ 方向速度成分	(m/s)
v'	:回転座標系 $\theta$ 方向速度成分	(m/s)
$\overline{\mathbf{v}}$	:静止座標系 θ 方向時間平均速度成分	(m/s)
w	:静止座標系 Z 方向速度成分	(m/s)
w'	:回転座標系 Z 方向速度成分	(m/s)
$\mathbf{\bar{w}}$	:静止座標系 z 方向時間平均速度成分	(m/s)
Z	:静止座標系 2 方向	(m)
z'	:回転座標系 z 方向	(m)
ギリシ	ャ文字	
ε	:エネルギー消散率	(J/s)
θ	<b>:</b> 静止座標系 θ 方向	(m)
$\theta$ '	:回転座標系 θ 方向	(m)
ν	:動粘性係数	$(m^2/s)$
$\nu_{\rm t}$	:渦動粘性係数	$(m^2/s)$
$\rho$	:流体密度	$(kg/m^3)$
$\sigma_{ m k}$	:モデル定数 -	
σε	:モデル定数	
$\tau_{r\theta}$	: レイノルズ応力	$(m^2/s^2)$
TO2	:レイノルズ応力	$(m^2/s^2)$
$\tau_{zr}$	:レイノルズ応力	$(m^2/s^2)$
ω	:角速度	(rad/s)
Supers	script	

n :計算ステップ

#### 〔引用文献〕

- 1)上ノ山周ら:化工論文集, 14, 6(1988)
- 2) Ohta, M et al.; J. of Chem. Eng. J., 18, 1 (1985)
- 3) Hiraoka, S et al.; J. of Chem. Eng. J., 11, 487 (1978)
- 4) ibid 12, 56 (1979)
- 5) 梅垣菊男:機論B, 54, 505(昭63)
- 6) Placek, J. et al., AIChE J.: 32, 11 (1986)
- 7) Harvey, P. S. and M. Greaves; Trans. IChem. E., 60 (1982)
- 8) Middleton, J. C.; Cem. Eng. Res. Des., 64, 1 (1986)
- 9)田中政一:九州大学工学部修士論文(昭61)
- 10) Komori, S: Private communication
- 11) Komori, S et al. : AIChE J., 34, 6 (1988)
- 12) Sawford, B. L. et al.: J. Fluid Mech., 106 (1986)

## **PMX-98** 化学プラントへの適用例

## **PMX-98** Application to The Chemical Plant

(化)プラント部 野口收次 Shuji Noguchi 技術開発本部 平田逸郎 Ituro Hirata

A lot of computers are used for the production control of batch process recently in a chemical industrial field. Although many of them are a large scale computer or specialized computer, personal type computers are growing to fill the operator needs by the development of software, economics, multiversatile and enlarging capacity.

This paper shows a batch plant operation management system, using a personal computer (PC-9801RX41) and a process monitor PMX-98 for a process operation and monitoring in the fine chemical factory.

### まえがき

近年,化学分野のバッチプラントは多品種少量生産,高 機能化がますます進んでおり,その運転管理難度が高くな っており,従来の手動操作から,制御用プロセスコンピュ ータによる自動運転へと移行しつつある。

制御用コンピュータは, これまで専用のハードウェアが 用いられることが多かったが, 最近, パソコンなどの市販 機器を利用するケースも増えつつある。それは, 経済性, 柔軟性, 保守性に優れているためである。

しかし、ソフトウェアにおいては、適当なパッケージソフトがなくその開発が望まれていたが、当社開発のPMX -98 により、柔軟性に富んだ運転管理システムが簡単に構築できるようになった。

本報では,パッケージソフト PMX-98 を応用したバッ

チプラント運転管理システムをファインケミカル分野の工 場へ納入したので,適用事例として報告する。

#### 1. 導入経緯

対象プラントは**第1図**フローシートに示すように、反応 缶を主機とするバッチプロセスの化学プラントであり、多 目的生産設備である。図中、 $\Theta$ 、〇は従来思想計装で、 $\overline{\Theta}$ , 〇がシステム導入に伴う計器である。

## 1.1 従来の運転管理

- (1) 自動化は反応缶の温度制御程度が主であり、単ルー プコントローラである。
- (2) 原料供給,ユーティリティ供給,動力操作,各種バルブ操作などは現場手動操作が主体である。
- (3) 生産管理は、オペレータがロット管理報告書に、仕込 量と時間ごとおよび状態変化ごとの各種データを記入



Vol. 34 No. 3 (1990/12)

- (4) 品種切り換え,工程進行の都度に計器設定値の変 更,手動操作手順の変更を必要とする。
- (5) オペレータのシフトチェンジの際,引継ぎ確認内容 が多く、またその引継打合に時間を要する。 従って、
- (6) ロット毎の品質安定性を維持するためには, 熟練オ ペレータが必要である。
- 1.2 自動化の目標課題およびシステム選定
- プラントの自動化に当り、次に目標課題を列記する。
- (1) 品質の安定化
- (2) オペレータの省力化
- (3) 省エネルギー,省時間化
- (4) アラーム機能による危険予知化
- (5) バッチレポートによるロット管理化

これら課題に対して PMX-98 システムは十分な機能を 備えており,しかも制御用プロセスコンピュータと比較す ると,操作の容易性,システムの信頼性,拡張性では遜色 なく,汎用性,互換性および,組合わせハードウェアの自 由度では逆にすぐれていることが認識された。特に,経済 生においての優位性は大きく,PMX-98 システムの採用 が決定された。

#### 2. PMX-98 の概要

PMX-98 は、パソコンと計測制御機器を接続してプロ セス運転監視システムをプログラムレスで構築できるパッ ケージソフトウェアである。パソコンは日本電気製 PC-3800 シリーズ, FC-9800 シリーズが使用できる。また, 計測制御機器はプログラマブルコントローラ, 調節計, 記 暴計などの市販ものを広く利用できる。

計測制御機器との接続は,通信インターフェース(RS -232Cなど), I/Oボードなどを介して行う。このため各重のハンドラ(インターフェースプログラム)を用意している。

また, PMX-98は, MS-DOSをマルチタスク化した リアルタイム・マルチタスクOS上に, C言語で作成した プログラムが並行して動作しており,速度面,機能面で優 れたソフトウェア構成となっている。

PMX-98 の主な機能としては

- (1) イベント監視機能
- (2) データ収集機能
- (3) グラフィック画面表示機能



第2図 バッチプラントの運転管理システム

Fig. 2 Management system of a operation for the batch plant

- (4) トレンドグラフ表示機能
- (5) メッセージ表示機能
- (6) 設定操作出力機能
- (7) レポートファイル作成機能
- (8) 文書ファイル表示機能

などがある。これらの機能はプログラムレスで設定,構築 することができ、メニュー形式で入力項目を選択し、文字 データはキーボードからFIF(Fill in the form:空欄 記入)方式で、また、グラフィック・データはマウスでデ ータの入力を行える。接続機器の登録を終えると、その後 の作業はすべてタグ名のみでシステム構築が行えるように なっており、ユーザにも使いやすいものとなっている。

#### システム基本思想

3.1 システム設計方針

化学プラントにおける自動化の基本思想を次に示す。 (1) 運転操作の容易性

特別な知識技能を必要とせず,異常時においても簡単 に取り扱えるものとする。

(2) CRTによる装置運転状況把握

オペレータが現場巡回確認をしなくてもグラフィック 画面,ステータス表示などにより一目で運転状況が判断 できるものとする。

(3) マンマシン対話形式

自動による工程進行を原則とするが、原料投入などオ ペレータの介入を必要とする場合には、自動運転を一時 停止してメッセージにで操作要求を行えるようにする。 (4) データの保存

バッチレポート,各種トレンド記録機能を有し,後日各 種パラメータのデータを引き出すことができるものとす る。

(5) 運転操作の自由度

自動運転中であっても個々の計器,バルブ,動力機器 に対して危険でない範囲において,プログラムより回避 し操作ができるものとする。

(6) プログラムデータの変更の容易性

変更を必要とするデータはプログラム領域でなく,オ ペレータ領域で行えるものとし,運転中であっても印字 確認が可能にする。

(7) 停電対策

動力機器に対してバックアップ電源がないために, 瞬 停(2秒内)および停電(2秒以上)を区分してその対 策を備えるものとする。

#### 3.2 運転管理システムの階層レベル

バッチプラントの運転管理システムは第2図に示すよう に管理レベル,監視レベル,操作レベル,制御レベルの4 つの階層からなる。

3. 2. 1 管理レベル

管理レベルはバッチプラントの各種データ,実績データ を管理することが目的であり,品種管理,バッチ管理など がある。

品種管理は多品種少量生産に対応するため、品種ごとに 異なる製法パラメータの管理を行うものである。品種ごと の製法パラメータとしては例えば、温度、圧力、時間など があり、PLC(Programmable Logic Controller) ある

第1表	主要機器一	覧表
Table 1	Equipment	list

Item no.	Name	Capacity	Press.	Temp.
R-101	Reactor	8 m ³	F V••1.9	280
V-103	Receiver	3 m ³	FV••1.9	180
T-101	Feed tank	1.5 m ³	FV••1.9	100
T-102	Feed tank	1.5 m ³	FV••1.9	100
V-501	Hotwater tank	2 m ³	latm	100
DC-101	Decanter	0.3 m ³	FV••1.9	100
E-101	Condenser	30 m ³	F V••1.0	180
V P -501, 502	Roots vac. pump	Max 0.1 mmHgabs		
<b>P-101</b>	Feed pump	3.6 m ³ /h		
P-102	Discharge pump	8 m ³ /h		
P-103	Discharge pump	10 m³/h		
P-503	HW circu. pump	16 m³/h		
<b>P</b> -504	PHW feed pump	10 m³/h		
<b>P</b> -505	HO circu. pump	30 m³/h		
<b>P</b> -506	CW feed pump	60 m³/h		

いは調節計に設定される。

ある品種が選択されるとその品種に設定されたパラメー タが制御機器にダウンロードされた後,確認キーなどの入 力により実際の運転が開始される。品種ごとのパラメータ はディスク上にファイルとして記録保存される。

バッチ管理は一つのバッチ生産が終了した時,そのバッ チに関する一連の管理データをバッチレポートとして出力 するものである。

このバッチレポートから,原料管理および品質管理のデ ータを得ることができる。

3. 2. 2 操作レベル

操作レベルはパッチプラントと人間とのマンマシン機能 であり,運転操作,工程歩進,パラメータチューニングを 行う。

運転操作は自動運転進行/停止操作,および機器,バル ブなどの運転操作を手動で行うものであり,従来の制御パ ネル上の押釦スイッチの代わりにCRT画面上で行う機能 である。

パラメータチューニングは調節計の各種パラメータ(PID定数,設定値など)の入力設定をCRT画面上に表示 されるリアルタイムトレンドを確認しながら行うものであ る。調節計は市販の機器を利用するので,汎用性が高くな っている。

工程歩進は各工程間の移行をオペレータが確認するため のマンマシン機能である。

工程終了→メッセージ出力→オペレータ確認→次工程

という半自動運転を行うことができる。

3. 2. 3 監視レベル

監視レベルは機器やプロセスの状態監視とオペレータに 対する画面表示が主な機能であり,アラーム監視,グラフ イック画面監視,トレンド表示などの画面表示ができる。

アラーム監視は機器やプロセスの故障信号を常時監視し て異常時に警報を発生するものである。

グラフィック画面,トレンド画面表示はプロセスフロー などのリアルタイム表示,レコーダのような時系列データ A R PROVIDE ALL ARC PLOAD ALL IS AS NIC-313 FIC-313 PACE PIC-313 FIC-313 PROVIDE ALL ARC PIC-314 PROVIDE ALL ARC PI

第3図 グラフィック画面例 Fig. 3 Example of graphic display

のグラフ表示などを行う。

3. 2. 4 制御レベル

制御レベルはプロセス制御機能であり, バッチプラント の計量, 調合, 反応, 分離, 抜出工程などのシーケンス制 御, プロセスの温度, 圧力 などを 一定に 保持する 定値制 御, あるいは予め登録された変化パターンを段階的に変化 させるプログラム制御などがある。

制御用機器は PLC, ディジタル 調節計などを 使用する。パソコンは監視レベルより上位のマンマシンインターフェース機能として使用することで,制御用と監視・管理用との機能分離を行っている。

#### 4. プラントの概要

主要機器一覧表を第1表に示す。

(1) 多目的 バッチ 反応装置であって 品種ごとに 異なるが,基本工程は

原料投入→反応→製品抜出

であり,品種切り換えごとに溶剤およびスチームによ る装置洗浄を行う。

- (2) 1バッチ当たりの運転時間は10~30時間である。
- (3) 粉体原料投入については、入荷形態の関係により手動投入となる。
- (4) 今回, ソフトウェア対応において, 自動運転化した 品種(銘柄)は5種類である。

(5) 設置場所:第2種危険場所

第1図フローシートにおける1銘柄用グラフィック画面 を,第3図に示す。

5. システム構成およびハードウェア

プラントの電気計装全体系統図を第4図に示す。本プラ ントのシステム構成はスタンドアローン型(1台独立型) であり、システム構成図を第5図に、使用機器一覧表を第 2表に示す。スタンドアローン型は1台のパソコンと複数 台のPLC、ディジタル調節計などの制御用機器を接続し て構成する。

パソコンと制御機器とのインターフェースは通信を用い るのが一般であり、PLC,ディジタル調節計などの制御 用機器は同一の通信ライン上に接続されているのが望ましい。

使用機器第2表に示すハード機器として富士電機(株)



第4図 電気計装全体系統図





第5図 スタンドアローン型システム構成 Fig.5 Hardware for stand alone system

製PLC:MICREX-F120H,ディジタル調節計:PYH9シ リーズ調節計を採用し,通信ラインは同社が持つ F-NET (Tリンク)を利用して日本電気(株)製のパソコンへ接続した。Tリンクインターフェースは富士電機独自の情報 ネットワークの名称であり,分散されたディジタル機器を 高速でしかも経済的に結合するシリアル伝送システムイン ターフェースで,Tリンクを使用することによりPLCと ディジタル調節計を組合わせた複合制御システムを構築 し,パソコン⇔PLC間でデータ伝送を行う PMX-98 コ ントロールシステムを形成した。以上のように,使用ハー ド機器は市販汎用機器の組合わせであり,全てが短納期対 応品である。

主要機器の機能を次に示す。

(1) パソコン:マンマシンユニット部

ハードディスクを装備した市販品であり、拡張スロットへTリンク用インターフェースボードをスロットイン して PLC とのデータ伝送を行う。ソフトウェアは、 PMX-98により マンマシンインターフェースの役割を 果たしている。ここでは装置の制御は一切行われず、指 令、データ変更、監視、管理の機能をつかさどる。従っ

#### 第2表 使用機器一覧表 Table 2 Device list

Device list										
No.	No. Symbol Component									
1	PC	Personal computer	1							
		Display " Printer	1 1							
2	PLC	C · Programmable logic controller								
		Digital input module Digital output module Analog input module	2 2 1							
		High speed pulse counter PC interface board	1 2 1							
3	PHY	(Digital controller)	i							
		Constant value control type Dual control type	5 1							

てPLCで自動運転領域に入っている時は、パソコンは OA用として別個の作業にも使用できる。

(2) PLC: 主制御ユニット部

運転制御プログラムを有し、パソコンよりの指令を受け、銘柄管理、動力機器の運転停止、バルブの開閉、ディジタル調節計へのモード、パラメータ、データ伝送を行う。制御の心臓部であるので信頼性の高い工業用機器を用いる。

(3) ディジタル指示調節計:単ループPID指示調節計 単ループ系でPID制御を行うディジタル指示調節計 である。これにTリンク通信機能を付加させて、銘柄お よび工程ごとに変化するモード(CAS, AUTO, MAN), SV値(Set Value)などの各種パラメータをPLCよ りの指令を受けて制御を行う。また、システムダウン時 には、手動バックアップ計器として使用可能でプロセス コントロールに重要な役割を果たす。

(4) 無停電電源ユニット:バッテリー付無瞬断切替電源 ユニット 第3表 オペレーションスケジュール例 Table 3 Example of operation schedule

		REACTOR_								
PRODUCT:	FM			OPERATION	SCHEDU	LE		REV.6:1990.2.17		PLANT
No.PR	OGRESS OF WORK	PARAGRAPH	_	SEQUENCE	EQUIPMENT	SET VALUE	BATCH DATA	STATUS	NOTE	AUGUCAI
		(JUDGENENT)				PRESET VALUE	():MAN.INPU:	(MESSAGE)		
O PRI	EPARATORY VORM				ACV311 CLOSE		*******		PC START	
	- 1A1 CHINCE							PREPARATION OK	2 2 4 2 2	
	K-IUI CHARGE	VACUUM CHARGE	6	LOW VAC. START	ACV319 OPEN			(RED. CHARGE)	PC OPE.	<b>U-0</b>
		R-IM 970kg					(CHARGE)		LO. OPE.	
		R-TF 150kg					(CHARGE)		LO. OPE.	
		CL45 2704kg					(CHARGE)		LO. OPE.	
		IAC 1673kg					(CHARGE)		LO. OPE.	
	·····		.7	VAC. BREAK	R-101AG RUN	YIC-311 XV= 100mm			PC OPE.	
		(VAC. BREAK END)			A-IUIBO RUN	A10-511 A1- 1001PE		(CL90 CHARGE)		8-10
		VAPOR LINE	6	AMBIENT CONDITION						
P	OWDER CHARGE	CL90 450kg		N Z PARGE			(CHARGE)		TO OPP	
	ONDER COBREE	(LCB-101 PB ON)					(oundo)	<b>R-101CHARGE END</b>	DOT OFE.	
N	2 REPLACEMENT		8	LOW VAC. START		PIC-311 SV=100mmHg				
		(PIC-311PV=<101mmHg)	7	VAC BREAK						
		(VAC. BREAK END)		TRO- DADAR						
			6	LOW VAC. START		PIC-311 SV=100mmHg				
·····		(PIC-311PV=<101mmHg)								
2	REACTION								PC OPE.	· · ·
		CPI PCT NO CONDENSATO	6	AMBIENT CONDITION						
	HEATING	JACKET	9	HO (HOT OIL)		TIC-311 PRG01(2h)		REACTION START		
		2017.202-1203.0000 minutes				SV=40→171℃				
		(TIC-311 PV=>170°C)		TWAS CTIPT		THOS-201				
				INVJ JIANI		TIC-311 PRG02(5h)				
			_			SV=170→235℃				
		(TROS TRUP)	- <u>o</u> -	STC(COOLING)		TTC-311 #V=50%				
	COULING 1	(TIC-311 PV=<210°C)		<u>510(0000184</u> /		110 011 11-008				210:FIXED
		SELECT OF CONDENSATE	13	RUNDOWN				(V-103 RUNDOWN)	D C 000	8-11
PR PR	COVERY DE AC	TACKET	9	HO (HOT DIL)		TIC-311 SV=2101C		RECOVERY OF AC	PC UPE.	₹
		VACUUN	Ğ	LOW VAC. START		PIC-311 PRG01(4h)		ABOVIERA MALAN		
		(TTC 211 DU-> 20091)				SV=300→30mmHg				
		(110-311 PV=>209°C) &								
		(PIC-311 PV=<31mmHg)								
				THOS START		TN06=80min				
1		(THOS THUP)				110-311 34-230 C				
		&					2-2-2-2-2-Po			
DEC	OUPPY OF FUN	(TI-314 DV=>±3°C)		UYCU VAC START		PTC-211 PPC05(30-1-)	LI-313 DATA1	PECOUPPY OF FRE		DV=PV-SV
	LUYGAL OF EFA	(LI-313 PV=>150L +		ATAU TUC. START		SV=30→2mmHg		ACOULT OF BLA		
		LI-313 DATA1)						DEGAUEDN EN-		
	COOLTNG- 2					TIC-311 NV=50%	LI-313 DATA2	RECOVERY END		
										200: FT
						TIC-311 SV=40°C				
·						•		REACTTON P		
•										

通電時は商用電源で停電時はバッテリー電源でパソコ ン, PLC, ディジタル調節計,および自動オンオフ弁用 ソレノイドバルブへ電源を供給するものである。瞬停時 は継続運転を行い、停電時にはプラントを安全方向に停 止させるための操作可能時間をもたせることができる。

- 6. **ソフトウェア**
- 6.1 ソフトウェア構成
  - 本適用例のソフトウェア構成を次に示す。
- 6. 1. 1 パソコン
  - パッケージソフトPMX-98
  - Tリンク伝送ハンドラによる
  - 総処理点数 :1024 点
  - 使用処理点数: 664 点
- ビルドアップ,メンテナンスはユーティリティソフトで 行う。ユーティリティソフトは 6.2.3項で述べる。
- 6. 1. 2 PLC

プログラミングローダLITEにおいて, D25ソフトに よりラダープログラムを作成する。ローダにてデバッグ、 プログラムモニタが可能である。

- *LITE :富士電機㈱のPLC用プログラミン グローダの商品名である。 プログラム容量:16 K ステップ :7801ステップ
- 使用容量
- 6.2 ソフト構築

プラントの自動運転を行うに当たりソフト作成の大項目 を順を追って記すと次のようになる。

- (1) PFD
- 2 PID
- ③ プロセス操作手順
- ④ タイムスケジュール
- ⑤ オペレーションスケジュール&サブシーケンスフロ ーチャート
- ⑥ パソコン↔PLC取合リスト
- ⑦ PLCラダーソフト作成
- ⑧ PMX-98システム構築
- ⑨ パソコン単独デバッグ
- ⑩ パソコン, PLC結合シュミレーション
- ① 実装置試運転調整
- (12) 実液運転調整
- (13) 各種図書変更修正
- ⑭ 引き渡し
- 6. 2. 1 ソフト作成用図書の解説

前記①PFD~④タイムスケジュールまでは省略する。

1) サブシーケンスフローチャート

プラントの銘柄,工程に直接関係しないシーケンスブロ ック(例えば 反応缶 ジャケットの ユーティリティ 切り換 え,真空ユニットの起動/停止順序など)をメインフロー から切り離しサブシーケンスとして取り扱うべく作成され



第6図 メッセージ表示画面例

Fig. 6 Example of message display

る動作フローチャートである。内容理解度を上げるため, 動作機器状態一覧表を作成すると効果がある。

2) オペレーションスケジュール

工程の流れに従って、オペレーションスケジュールに必要とするサブシーケンス、変化する動機器、自動オンオフ バルブの状態、各種計器群のモード、設定値、プログラム 状態を記し、必要時点でのバッチデータ、ステータス、オ ペレータメッセージおよびオペレータへの手動操作要求を 表形式で表現するものである。サブシーケンスを表にプロ ック化することにより自動運転の流れを把握するのにたい へん便利である。その例を**第3**表オペレーションスケジュ ール例に示す。

3) パソコン↔PLC取合リスト

本リストはパソコンで運転管理を行うのに必要な画面, データを整理し PMX-98 システム構築のワークシートと なるものである。次に項目およびその内容を記す。

 フローグラフィック画面 および モディファイ I/O リスト

一画面当たりのフロー図案を作成しカラー,モディファイ機器の指定を行う。

(2) 銘柄/工程管理画面

銘柄/工程管理用の画面図案およびPLC内メモリの 割付指定を行う。

- (3) ワードデータアドレス
- アナログ入力,パルスカウンタ,ディジタル調節計, パソコン,およびPLC内のワードデータアドレスを指 定する。
- (4) ステータス用I/Oリスト

必要なステータスの文字列とそのメモリアドレスを指 定する。

(5) メッセージ,ガイダンスI/Oリスト

オペレータメッセージおよびそのガイダンスの文字列 とそのメモリアドレスを指定するワークシートである。

- メッセージ表示画面の例を第6図に示す。
- (6) アナンシエータメッセージ I / O リスト

アナンシエータメッセージおよびそのガイダンスの文 字列とそのメモリアドレスを指定する。

(7) バッチデータ収集リスト画面上で、必要データ項目、そのデフォルト値、およ



第7図 PID調節計画面例 Fig.7 Example of PID controller display

び設定データメモリ,収集データメモリまたはワードデ ータ,そして収集条件メモリ(このビットが立った時に 収集データメモリ内のデータをハードディスクへ収集す る)の各アドレスを指定する。デフォルト設定値がある のは手動粉体投入などの場合にデフォルト値以外の量を 投入すれば画面上でデータを書換え、デフォルト値どお りであれば無操作でデフォルト値がバッチデータとして 収集される。

(8) S/W (スイツチ) 画面リスト

スイッチは銘柄セレクト,工程歩進,工程セレクト, サブシーケンスブロックの起動/停止,および単体機器 遠隔手動操作用のスイッチ名称,およびその Di/Do ア ドレス指定を行う。

(9) オンオフ調節計

オンオフ調節計はPID調節計とは異なり、PLC内 で作成する計器であり、ディジタル調節計のように単体 では存在せずパソコンのCRT上でのみ確認される。

この上下限設定値,HLアラーム,インターロック条件のデータメモリの指定を行う。

(10) PID調節計

ディジタル調節計はPLCにおいて通信で各種データ 変更を行い、I/O 領域の割付は(3)項で指定されている ので、ここでは、メッセージ通信領域のデータメモリを 指定する。指示値はパソコンのCRT上に計器画面が表 現でき、ディジタル調節計の各種パラメータまでパソコ ンにて監視操作を可能にするものである。プログラム的 に設定値を変更する場合もCRT上で指定する。第7図 にPID調節計画面例を示す。

(11) タイマ,カウンタ

タイマ,カウンタ共に設定値と現在値を持っておりパ ソコンにてデータ変更を必要とするものをTS,TR, CS,CRnnnで指定し管理を行う。

(12) 可変データリスト

例えば1ループの流量カウンタにおいて銘柄,工程ご とに設定値が変化するような場合にあらかじめデータメ モリにデータをストックしておき,自動的に運転する場 合にシーケンス上で引き出すものである。これらのデー タ変更はパソコンでその使用する工程に入る前であれば いつでも可能である。

#### 6. 2. 2 PLC ラダーソフト

バッチプロセスは基本的に工程歩進型で考えるべきであ り、富士電機のPLCに標準装備されているSC命令を基 本に作成し、パソコン、ディジタル調節計が持つデータ取 扱い上、BIN/BCD交換、データ転送を多用している。 SC命令のメリットは

- (1) プログラム作成の手順が簡単である。すなわちリレー間の複雑なインターロック,自己保持回路に頭を悩ますことなく、ソフト作成が容易でユーザの自己メンテナンスが容易である。
- (2) タイムチャート, ラダー図, フローチャートの対応 が非常に理解し易い。
- (3) テスト,調整時のモニタは、一連のリレーが順次に ONするのを確認するだけで行える。
- 6. 2. 3 PMX-98ユーティリティ機能

PMX-98のシステムを構築するツールとして,ユーティリティソフトがある。ユーティリティソフトとは,ユーザがシステムのハードウェアの定義,アラームの登録,データ収集の設定,各種表示画面の登録,グラフィック画面の作成などを行うことで,プログラムレスでシステムを構築することができるソフトウェア機能である。

ユーティリティソフトは,一種のデータベースを構成し ており,ユーザはメニュー画面の表示に従い,目的の入力 画面を開けデータを入力することができる。ユーザが登録 したデータは,システムの起動,または画面表示の際に参 照される。

ユーティリティ機能により, システム構築時のみならず, プラント改造時のシステム追加変更にもユーザ自身で 柔軟に対応が可能となり,機密保持,費用面,工期短縮に メリットが生じる。

本バッチプラントはプラント一括として当社が受注した ので,運転管理システムのシステム構築についても,プラ ントメーカである当社が行った。しかしながら,プラント 納入後,グラフィック画面,メッセージ内容などの,オペレ ータのシステム運用の容易性を向上するための軽微なシス テム変更は,すべてユーザ側で行えるようになっている。

例えば、ユーザが変更できるデータ、およびその方法を 述べる。

6. 2. 4 変更内容

データの設定は大まかにハードウェア,バックグラウン ド,マンマシン機能,ファンクションキーの登録に分類さ れる。ベースとなるデータ(ハードウェアの登録など)を 保護する意味で,ユーザでの変更可能なデータはマンマシ ン機能のみとしている。マンマシン機能では,グラフィッ ク画面,トレンド画面,オペレータメッセージ,設定操作 画面,レポートファイルの設定,変更が可能である。

(1) グラフィック画面

グラフィック画面は静止画と動画を重ね合わせて表示 している。静止画はプロセス機器などの,状態に応じて 変化しない画像である。これは,ほとんど変更すること がないが,もしプロセス 機器構成に若干の 変更があっ た場合には,市販の グラフィックツール Z's STAFF KID98 により変更が可能である。動画は プロセスの状 態によって変化する内容を表示するが,アナログ値にお いては,数値またはバーグラフの選択があり,表示位置, 色,表示データの追加,変更が可能である。ディジタル 値は記号,文字列の選択があり,それぞれON時,OF F時の表示属性の指定が可能である。 (2) トレンド画面

トレンドでは、プロセスのデータをリアルタイムに取 り込み画面に表示するリアルタイムトレンド画面と、一 定周期、またはイベントにより取り込んだデータ収集フ ァイルからデータを読み出して画面に表示するヒストリ カルトレンド画面がある。リアルタイムトレンドは、ア ナログ値が1.画面当り6点まで表示でき、表示タグの追 加、削除とタイトル名の変更が可能である。ヒストリカ ルトレンドにおいては、アナログ値、操作端機器の状態 を表示ができるが、データロギングされているデータに 限られる。

(3) オペレータメッセージ, ガイダンス

プロセス異常発生時に表示するメッセージ内容,あるいは,各銘柄における工程の表示内容の変更ができる。 またメッセージについては,ガイダンスの表示内容の変 更ができる。

(4) 設定操作画面

銘柄,工程の選択,動力機器の起動停止,バルブの開 閉,およびタイマ,カウンタ設定値の変更などを行う画 面である。

ここでは、スイッチの表示位置の移動、スイッチの名称の変更、および、スイッチのタグ名の変更ができる。 (5) レポートファイル

バッチデータのレポートを銘柄ごとに出力する。レポ ートのタイトル,ファイル名,出力フォーマットの変更 ができ,プリンタ出力,テキストファイル出力の選択変 更も可能である。

#### むすび

化学プラントの計装は空気式から電子式アナログ、電子 式ディジタル,その後制御用 コンピュータによる DDC (Direct Digital Control) へと急速に変化し、現在は、 DCS (Distributed Control System) いわゆる "システ ム"が主流になってきた。一方,工場オートメーション (FA: Factory Automation) ではCIM (Computer Integrated Manufacturing) の時代を迎えている。しか し化学プラントへのシステム化は、複雑な計装制御を必要 とし、困難であるためFAからは一歩遅れをとっているの が現状である。特に、ファインケミカル分野においては少 量多品種のバッチ生産が多く,マンパワーを削減し生産性 向上、品質安定化を図るために、DCSの導入計画が練ら れる。 しかし, 制御用 プロセスコンピュータを 導入する と、プラント建設費の20~30%の費用が計装システムに 費やされ、製品コストへの波及が大きくなり、数多く採用 されていないのが実状である。

複雑な多品種生産を行うバッチプラントを経済的に成り 立つ価格でシステム化を遂げているのが PMX-98 バッチ プロセス運転管理システムである。本報紹介のユーザは更 に,入出力処理点数 750 点,ソフト 処理では, PMX-98 :1020 点, PLC:12 K ステップを越える単一製品バッ チラップ生産設備を導入され順調に稼動中である。

今後, PMX-98パッケージソフトをさらに拡大充実し, 生産管理, 生産計画などを含めた統合生産管理システムの 開発を図り, 信頼性の高く, しかも扱い易いソフトを安価 にプラントユーザへお届けできるよう努力していく所存で ある。

#### [注記]

MS-DOSは、米国マイクロソフト社の登録商標 Z's STAFF KID98 は(株) ツァイト社の登録商標

# 静電気によるGLの損傷とその対策

Troubles of Glass Lined Equipments by Static Electricity and Countermeasures against It



In the last decade, about twenty five cases of troubles have occured on glass lined equipments by static electricity. This static electricity is produced by three ways; collisions of contents themselves, frictions of contents and lined glass surface by agitating, and carrying from outside of a reactor. Then straged static electricity causes various spark discharges at the interface of contents and a lined glass or between a lined glass surface and a base metal. These spark discharges break the lined glass like as chipping or pinhole.

This report mainly shows the examples of these troubles and countermeasures against the static electricity.

## まえがき

本誌前報¹⁾ において,東京大学生産技術研究所の山本助 教授による講演の抄録を掲載させて頂いたが,その内容は 主に粉体に係わる静電気の基礎とその静電気を有効に活用 するための理論および応用例などについてであった。

GL搅拌槽に関する限り,静電気は否定的なものである 易合が多い。既報²⁾において,GL搅拌槽に発生する静電 気の概要を述べたが,その時点で経験した静電気によるG L機器の損傷は2例であった。以来,現在まで約10年間で 35件発生している。その25件は,GL機器が損傷したこと で当社がなんらかの対応をしたものだけの数であり,実際 こはもっと多くの事故や生産性障害が起きているものと予 則される。樹脂製品の量産化,多様化が進む中,各種原材 料のファイン化も手伝い,この種のトラブルは今後も引き 続き多発する傾向にあると考える。このような静電気に対 し、効果的な防止対策は見つかっていないのが現状である が、多くの損傷事例と、今現在考えられる静電気対策など こついて次に述べる。

#### 1. グラスライニング撹拌槽内での静電気発生

グラスライニング撹拌槽は、化学プラントのプロセス中 枢部に位置することが多く、撹拌槽の前後には原料仕込用 あるいは、排出用の配管類、熱交換器、貯槽などが付属す る。グラスライニング撹拌槽内の静電気には、このような 曹外のプロセスにおいて発生した静電気が槽内に持ち込ま れる場合と、槽内の撹拌により発生する場合の2種類に大 引される。ここでは特に、槽内で発生する静電気を扱うこ とにする。

#### 1.1 帯電

グラスライニング撹拌槽中で静電気を発生させる因子と して,槽内部の材質,形状,撹拌動力,仕込まれる原料の 重類とその性状,量がある。槽内部の材質はもちろん全面 グラスで体積抵抗率の高い誘電体である。槽形状は円筒堅 型で,撹拌効率を良くするため,撹拌翼の他にバッフルが 設置されているのが普通である。撹拌の強さは,仕込まれ る数種の原料が十分混合されるように設定されている。以 上のことから,仕込まれる原料次第では静電気が発生する ことは極めて当然の仕様といえる。今までに静電気が発生 したときの仕込まれた原料についての詳細は把握できてい ないが,体積抵抗率の高い(10¹⁴Q・cm 前後)溶剤および 粉粒体であることが分かっている。特にこの両者の混合物 である場合が多い。ここで帯電列の例を**第1表**に示す。帯 電列中の2つの物質を摩擦または剥離したとき,表中上の 物質が正極性(+)に帯電し,下の物質が負極性(-)に帯 電する。その帯電量は,帯電列中の位置が離れるほど大き くなる。例えば,ガラスとポリエチレンが摩擦,剥離を起 こすとガラスが正極性,ポリエチレンが負極性に帯電する ことになり,その帯電量はガラスと絹の場合より大きい。

グラスライニング 撹拌槽内で 撹拌され, 静電気を 発生 し,それが蓄積されるような原料としては,表中の物質以 外にベンゼン,トルエン,ヘプタン,ブタノール,ヘキサ ン,ブタジエン,四塩化炭素,キシレン,純水などがあ

第1表 帯電列の例³⁾ Table 1 An example of series of frictional electrification

Metals	Fiber	Natural matter	Synthesis resin
(+)	(+)	(+) Asbesto Hair Glass	(+)
Lead	Wool Nylon Rayon	Mica	
	Silk Cotton Hemp	Wood	
Zinc Aluminium	Glass fiber Acetet	Skin	
Chromium Iron		Paper	Ebonite
Nickel Gold Platinum	Vinylon Polyester	Gum	Polystyrene Polypropylene
	Acryl Polyvinylidene	Celluloid Cellophan	Polyethlene Vinyl chloride
↔	$\mapsto$	$\leftrightarrow$	Polytetraphloroethylene



第1図 撹拌時間と発生電位 Fig. 1 Relation between agitating period and potential



Fig. 2 An example of relation between agitating speed and potential

る。そして,これらの 原料の量が 多いほど 帯電量も 大き い。またポリエチレン,ポリプロピレン,ポリスチレンな どの粒体では,粒が細かくなるほど帯電量も大きい。この ような原料でも塩酸,硫酸,水道水などの体積抵抗率の小 さい物質が多く添加されていれば静電気の発生は問題にな らないようである。溶剤中への微量な水の添加は水滴と溶 剤との接触摩擦による帯電,さらには水滴が溶剤中の電荷 を集めるというように逆に静電気の発生を助長することが ある⁴。

撹拌槽内で発生する静電気は, 撹拌によるガラスと原料 の衝突摩擦, 分離の他に, 2種類以上の原料同士の衝突, 分離あるいは, 槽内の高圧洗浄の際の洗浄水の吐出, 衝 突, 付着物の剥離などによるケースもある。

体積抵抗率約 10¹⁴ Q・cm の粒状粉体と,約 10¹⁴ Q・cm の溶剤からなるスラリーを 100 ℓ のグラスライニング撹拌 槽内で,スパン 400 mm の撹拌翼を用い回転数 150 r.p.m. で撹拌したときに発生した電位の測定例を**第1図**に示す。

撹拌開始後20秒で約9 kV に達し、その後撹拌を続けて も電位の増加は認められず、電荷の発生量と漏洩量がバラ ンスされると考えられる。しかし、撹拌開始から 180 秒後 に撹拌を 停止したところ、一時的に 電位が上がり、約21 kV まで観測された。電位の測定は、液表面近傍で測定し たが、撹拌を停止したとき、沈降していた溶剤より高い電 荷をもった粉体が表面に浮いてきて測定プローブの近くに 集まったため、一時的な電位の上昇となった。すなわち撹 拌中には部分的に21 kV 以上の高い電位に達していたもの と思われる。



Temperature [1 000/T [°K]⁻¹]

第3図 グラスの体積抵抗と温度の関係





第4図 グラス厚みと破壊電圧6)

Fig. 4 Relation between enamel layer thickness and breakdown voltage with temperature

ピーク電位を記録した直後から電位は減衰し, 撹拌停止後150秒で電位は約1kV以下になった。

次に,同じ条件で回転数のみを変化させたときのピーク 電位を測定したので,その結果を第2図に示す。横軸の速 度は,翼先端の周速を表わす。この結果は,撹拌翼の回転 数の上昇は帯電電位を確実に増加させることを示すもので ある。

またこの時,槽内温度と帯電電位の関係も調べた。ライ ニングされたグラスの体積抵抗率と温度の関係をワイブル プロットにより 第3図に表わした。20°Cのグラスを45 °Cまで昇温すると、約1ケタ抵抗率が低下することが分 かる。ところが,槽内温度を同じように20°Cから45°C に上げても帯電電位は低下しなかった。これは $10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上の抵抗率が1ケタ程度下がって、漏洩し易くなっても 帯電量の方が大きく上回り、電位の低下につながらなかっ た。あるいは、一般に温度の上昇は静電気が発生し易くな るといわれており⁵)、相殺されたためと考えることもでき る。

#### 1.2 放電

正極性と負極性にそれぞれ帯電した2つの物体は,その 帯電電位が2つの物体で挟まれる電界の絶縁破壊強度以上 に達したとき,放電により急激に電位が緩和される。この 絶縁破壊強度は,例えば電界が空気であれば約3×10⁶ V/m であり,この値以上の電位が蓄積された場合に気中放電現 象が認められる。



(d) Surface discharge

一般的なライニング用グラスの絶縁破壊強度は,第4図 に示すとおりである。1.2 mm にライニングされたグラス に40°C下において,25 kV 以上の電位が加わったとき破 壊し,温度の上昇に伴いその絶縁破壊強度は低下し,破壊 電位も下がる。

グラスライニング撹拌槽内の放電は、3種類のケースが 考えられる。1つは内容物間での放電で、内容物が1種類 のときは強い撹拌により分裂した際にそれぞれが両極に帯 電し、再度接近した時放電を起こす。内容物が2種類以上 のときは、いずれかが正極性になり、他が負極性に帯電 し、それらが分離して放電を起こす。

別のケースとしては、内容物とライニジグされたガラス 表面との間で起こる放電である。第1表でも示したように 多くの場合、内容物とグラスの摩擦、衝突が繰り返される と内容物が負極性に、グラスが正極性に帯電する。撹拌に よる乱流や液面の上下で両者が接触・分離を繰り返すよう なところに放電が起こり易くなるわけである。撹拌槽内の 気液界面、撹拌翼やバッフル翼の裏側などがこの部位に相 当する。

さらにもう1つのケースとしては、上記現象から電気二 重層が形成され、正極の電荷が集まるグラスの表面と、ア ースされた負極性の素地金属との間で電位が生じ、第4図 で示した破壊電圧以上の電位が発生したときに起こる放電 のケースである。前記の2つのケースでは、内容物間ある いは、内容物とグラスの間の放電であったのに対し、この 場合は、グラスが絶縁破壊することによる放電であり、槽 内の帯電量が増せば、内容物とグラスの接触、分離の如何 にかかわらず発生する。

いったんグラスが絶縁破壊し,素地金属に達する貫通孔 (ピンホール)ができると,その後もピンホール近傍のグ ラス表面と素地金属間で放電が繰り返される。ここで静電 気放電の形態を**第5**図に示す。

(a)のコロナ放電は、帯電した物体に尖鋭な突起部分の刃 状部分があるとき、または帯電物体の近くに突起状あるい は、刃状の接地導体があるとき、突起部分などの近くだけ に微弱な発光が現れる放電といわれているが、グラスライ ニング撹拌槽内においては、内容物が流体であること、グ ラス面が平滑であることなどからこの形態の放電は少ない と思われる。 (b)のブラシ放電は,帯電量の大きい物体と比較的平滑な 形状を持つ接地導体との間で起こる放電で,内容物とグラ ス表面の間で起こる放電がこれに属するものと考えられ る。

(C)の火花放電は,帯電物体と接地導体の形状がともに比較的平滑なときに,強い破壊音と図に示すような一条の発光を伴って突然発生する放電で,グラス表面と素地金属間の放電はこの形態であり,グラス層にピンホール状の損傷を与える。

(d)の沿面放電は、帯電物体の背面に接地導体がある場合 に、帯電物体表面の電位が非常に大きくなったとき、帯電 物体の表面に沿って発生する放電である。グラスの損傷の 中でピンホールを中心にして、スタティックマークが観察 されることがあるが、正にこの沿面放電によるものであ る。火花放電によって形成されたピンホール中に出現した 素地金属とグラス表面との肌の放電現象と考えられる。

1.3 緩和

蓄積された電荷は、放電により解時にあるいは電気伝導 によって徐々に漏洩、緩和される。ここで電気伝導による 緩和時間  $\tau$ (時定数ともいう)は、帯電している物体の体 積抵抗率を  $\rho$ 、その誘電率を  $\varepsilon$  とすると次式で示される。

 $\tau = \rho \cdot \epsilon$ 

すなわち緩和時間は、帯電している物体の体積抵抗率ある いは、その誘電率に比例して長くなる。

また帯電電位 V_mの t 秒後の電位 Vは,次式の古典的緩 和法則で表される。

$$\mathbf{V} = \mathbf{V}_{\mathrm{m}} \cdot \mathbf{e}^{-\mathrm{t}/\tau} \tag{1}$$

①から $t = \tau$ を代入して、 緩和時間後の電位を求めると  $V=0.37 V_m$ となり、緩和時間とは初期の帯電電位の 37 % の電位になるのに要した時間ということになる。

北川ら⁸ は,約2ℓのグラスライニング容器中にミネラ ルスピリットを約1.8ℓ入れ,これを電気的に600 Vまで帯 電させた後,電極を取り除き,静置した状態で電位の減衰 を調べた。その結果を**第6**図に示す。(a)はグラスライニン グ容器の素地金属からのアースの有無による時間と電位の 関係を表したもので,アースを施すことによって初めてグ ラスを通し,電荷が漏洩することがわかる。この減衰曲線 を(b)に示すように縦軸の電位を対数表示すると,直線にな ることから①式にあてはめると,



 $V = 600 \cdot e^{-t/34 \cdot 6}$ 

2

電あるいは, トリーイングなどと呼ばれる放電による破壊 があるといわれている⁹。

と書き換えられる。 この式から 緩和時間は,34.6秒であり,半減期は24.6秒が求められる。

また,仮にこの容器に50 kV の帯電があったとし,そ れが100 Vまでアースからの電気伝導のみで緩和すると仮 定すると,約4分かかることになる。100ℓのテスト機の 場合も半減期は約30秒であったが,例えば約30 kV に帯 電していたものが100 V以下に減衰するには6分以上必要 であることが分かっており,実際に使用されているグラス ライニング撹拌槽は,これらのテスト容器に比べ,ライニ ングされた グラス表面積に対する内容物の量が大きいの で,静置した状態での漏洩時間はもっと大きいと予測され る。

## 2. 静電気によるGLの破壊状態

固体誘電体の電気的破壊は, 真性破壊および電子なだれ といった電子的破壊に始まり, 純熱的破壊を経て機械的破 壊に至ると説明される絶縁破壊と, トラッキング, 部分放 があるといわれている⁹。 静電気によるGLの破壊にも絶縁破壊と放電による破壊 の両者が存在する。GLの静電気による破壊例を**写真1**に

示す。 (a)から, 直径0.5~1.0 mm のグラス表面から素地金属に 達するピンホールで, グラス表面の開孔部周囲の角が取れ て丸くなっていることがうかがえる。これはグラスが絶縁 破壊あるいは, 放電により貫通孔ができ, その時あるいは その後の放電の熱により開孔部周囲が溶けて角が取れたも のと思われる。

(b)はグラス表面に形成されたスタティックマークの写真 である。中心部は,素地金属まで貫通したピンホールがあ り,樹枝状の部分はグラスの微細な表層チッピングの集団 である。

(c)も樹枝状ではなく、円形ではあるが、 $10~15 \text{ mm}\phi$ の同様のトリーイングが認められる。

バッフルチップの先端の小さいR部に破壊が起こるとピ





写真1 静電気によるGLの破壊例 Photo.1 Examples of GL destrustion by electrostatic discharge

Vol. 34 No. 3 (1990/12)

#### 第2表 静電気による損傷事例一覧表 Table 2 The list of troubles by static electricity

No.	Vessel M ³	Contents	Tip speed m/s	Temp. °C	¥ 1 Location of defects	¥ 2 Phenomena of defect	Remarks	No.	Vessel M ³	Contents	Tip speed m/s	Temp. °C	₩·1 Location of defects	¥ 2 Phenomena of defect	Remarks
1	2	Ligroin, powders, etc.	-	-	A, B, C, G	P, S (Numberless)	Dipping pipe and level sensor were made of metal.	13	3.5	Polyethylene, hexane, etc.	-	-	A, F, H	P (Many)	Pinholes occur at the downstream of nozzles with vessel wall.
2	2	Benzene, sulfouric acid, etc.	-	-	A	P, S (Numberless)		14	3	N-hexane, powders, n-cycrohexane, etc.	-	-	A, B	P, C (Many)	Charge climinating agent was added.
3	2	Polypropylene, toluene acetic anhydride, pyridine, benzene	-	-	B, C, J	P (Numberless)		15	16	Polyethylene, carbon tetrachloride, solvent, etc.	1.7 - 3.3	130	A, F, H	P (Many)	
4	55	Heptane, butanol, etc.	I	-	ί,j	P (Many)		16	1.8	Benzene, toluene, heptane, powders, etc.	-	-	A, C, G, I	P (Numberless)	A worker observed spark discharges from view window
5	40	Polypropylene, etc.	-	-	Е, Г	P (Numberless)		17	7	Carbon tetrachloride, polypropylene, polyethylene, etc.	5.5	120	A, B, C, F, I	P (Numberless)	
6	1.5	Tohuene, powders, hydrochloric acid, etc.	1.6 — 6.1	1	A, C, F, G, I	P (Numberless)		18	3	Toluene, nitrobenzene, methylethylketone, polyethylene, etc.	1.9 - 6.0	80 - 130	D, G, H, I	P, (52 pieces)	
7	4	Plastics, hydrochloric acid, etc.	-	-	A, B, C	P (Numberless)		19	13	Pure water, clorine, polyethylene, surface active agent, etc.	-	-	B, C	P, C (Many)	Pinholes increased in spite of Ta repairing.
8	14	Solvent, powders, etc.	-	-	В	P (Numberless)		20	3	Xylene, powders, etc.	-	170 - 180	D	P (6 pieces)	
9	 60	Polypropylene, etc.	1	-	F	P (Many)		21	15	Hexane, solvent, powders, etc.	5.3	110	с	P (2 pieces)	Pinholes occur just below inlet nozzle.
10	3	Plastics, etc.	-	-	B, G, I	P,S (Many)		22	12	Hexane, solvent, powders, etc.	5.0	60	С	P (3 pieces)	Pinholes occur just below inlet nozzle.
11	6	N-heptane, solvent, etc.	-	-	A, D	P, S (Numberless)		23	20	Hexane, globular silica, etc.	2.1I 6.7	150	Ć, G	P (70 pieces)	Baffles were made by metal.
12	40	Polypropylene, butadiene, etc.	_	-	G, F	P (Numberless)		24	8	Paraformakiehyde, sulfouric acid, etc.	_	-	A, C, F, G, H, I	P (103 pieces)	

Ж1



B : Middle hight of vessel wall C : Bottom of vessel

D : Drain nozzle

E : Inlet nozzle

F : Shaft of impeller

G : Blades of impeller

- H : Shaft of baffle
- I : Blades of baffle J : Tip of baffle

ンホールだけで済まされず,(d)の写真に示すようなチッピ ングへと発達し易い。バッフルおよび撹拌翼のブレード部 の小R部も同様の傾向になることが多い。

GLの静電気による破損の中には必ずしも素地金属まで 達しておらず, グラス表面の チッピングのみの 場合もあ る。これは、内容物とグラス表面との間の放電による衝撃 痕あるいは、熱に起因するものと推測する。

GLの静電気による破壊の最も顕著な特長は、破壊箇所 が無数に及ぶことである。過去の事故例では、1基の撹拌 槽内で合わせて1000箇所以上といった具合である。 そし て,その破壊の多くは写真1の(a)およびそのグラス表面の 開口部が欠けた状態を呈している。

#### 3. 損傷事例

最近10年間の当社に寄せられたグラスライニング撹拌槽 の静電気による損傷状況を第2表にまとめた。

表中で内容物に ついては、 判明している 範囲で 記入し た。その量比については明かでない。

チップスピードは、撹拌翼の回転数と翼のスパンから算

 $\approx 2$ 



Ρ

Glass Glass Base metal Base metal

#### 出した。

損傷部位と損傷状態は、表下に示した概略図と記号で表 した。

これらの事例の特長と共通点について次に述べる。

No.1と No.23 では、金属製のアクセサリーを 挿入してい てもまた, No. 13では Ta プラグで補修しても静電気による 損傷が起きていることから、これらの物がアースになり、 損傷を防止することにはならないことが解される。帯電し 易い物体は,電荷の移動が極めて遅く,金属部分に到達し て漏洩する以上に、蓄積する速度が上回るためである。ピ ンホールが発生しても、数ミリないし数十ミリ離れた部分 に新たに絶縁破壊が起こることからも裏付けられる。

№ 13の場合は, 槽の胴部(気液界面付近)に 設けられ た2カ所のノズルスエッジの下流側に発生しており、ノズ ルの存在による流れの乱れが損傷に結びついた例である。

No. 14 では除電剤を添加していたにもかかわらず, 多く のピンホールやスタティックマークが発生している。除電 剤は、緩和時間を小さくする効果はあるが、その添加量に

よっては不純物として帯電を助成する恐れがあることを示 唆している。

№ 21, 22は同じプロセスに同じ目的で設置された2台の 撹拌槽において、それぞれ同じようにして原料を仕込み、 共に同じ仕込ノズルの直下のグラスが破損されたケース で、この場合は槽外からの持ち込まれた静電気によるもの である。

№ 2, 6, 7, 24 では, 内容物に 体積抵抗率の 小さい (<10² Ω・cm) 塩酸や硫酸が 含まれているにもかかわら ず,多くのピンホールが発生している。これらの液体の添 加量, 濃度など詳細な条件が明らかでないが, 既に静電気 が発生している状態の中へ仕込んだものと理解している。

これら24件の事例で共通点としては、ほとんど溶剤と体 積抵抗率の大きい粉体の混合物であること、損傷状況がピ ンホール状で数が非常に多いことが分かる。発生部位は、 気液界面および内容物が接触、分離を繰り返すところに多 い。

#### **4**. 静電気対策

グラスライニング撹拌槽内の静電気は、機器の損傷だけ でなく、人体への感電、火災および爆発といった重大災害 の危険性があり、有効な対策を講じなければならない。田 畠¹⁰は災害の防止対策として、次のことを実施すべく提案 している。

- (1) 接地を確実に励行する。
- (2) 混合, 撹拌などの運動速度を大きくしない。
- (3) 容器の中にイオン化空気を送り,静電気を除電する。
   (4) 容器内で生成される可燃性混合気の濃度を測定し、 爆発範囲に入らないように管理する。

GL機器の上記以外に考えられる静電気対策を次に列挙

- する。まず、撹拌槽の仕様としては、
  - (1) 体積抵抗率の小さい材料の使用
  - (2) 強い撹拌を避ける。
  - (3) バッフル強さを低くする。
  - (4) 槽内面の凸凹を減らす。
  - (5) 防災の観点からアースを増す。

(1)について,現在使用されているグラスの体積抵抗率は,約 10¹³  $\Omega$ ・cm であるが,これを 10⁸  $\Omega$ ・cm 以下にするの が良いとされている。しかしながら,現時点では耐食性を 考慮して,なおかつ体積抵抗率を10⁸  $\Omega$ ・cm 以下にすることは困難であり,今後の開発が望まれる。静電気の発生ステージに合わせ,金属製の撹拌槽とグラスライニング撹拌槽の2 槽にすることなどは有効な手段であろう。(2)については撹拌翼の形状,スパンを小さくする。あるいは回転数 を下げるといった方法が考えられる。チップスピードは 1 m/s 以下¹¹⁾程度が妥当と思われる。

(3)について、バッフルの本数,翼の形状,設置角度などの変更が考えられる。

(4)について, 槽の液相部および気液界面にノズルや温度 計などを設けない。また,付着物があればそれを除去して 平滑なグラス面を確保する必要がある。

(5)のアースは、漏洩抵抗が100Ω以下にしないと効果が ないといわれている。アースの設置は、アースを通して電 気伝導による槽内の電位の緩和,人体の感電防止というこ とでは有効であるが,一方で,急激な電荷の蓄積があれば 電気伝導だけでなく放電による緩和が起り,機器の損傷, 火災などに結びつく可能性もある。

次に内容物の性状としては、

(6) 10⁸ Q・cm以下の体積抵抗率の原材料を使用する。

(7) 引火性原料を避ける。

(8) 粉体原料は、その粒径を大きくする。

- (9) 粉体原料を湿潤化して用いる。
- (10) 除電剤を添加する。
- (11) 量を減らす。
- などが挙げられる。
- また,原料の仕込過程では次のことに留意しなければな らない。
  - (12) 原料の搬送速度を下げる。
  - (13) 電導性物質を先に仕込む。
  - (14) 金属性スクリューフィーダーなどを使い,仕込速度 を下げる。
  - (15) 粉塵を起さない。
  - (16) イオン化ガス中を通す。
  - そして、運転時の対策としては次のような方法がある。
  - (17) 槽内に不活性ガスをパージする。
  - (18) 静置するなど緩和時間を設ける。
  - (19) 気相部の湿分を増し、65~70%以上に保つ。

グラスライニング撹拌槽における静電気現象は,再現性 に乏しい。それだけ影響を与える因子が多く,種々の対策 が考えられる反面,これといった効果的な対策が見あたら ないのが現状である。

経験的に撹拌槽内で発生した静電気を除電することは極めて難しく,除電対策が逆に静電気発生量を増加させることにもなりかねない。すなわち,製品の製造プロセスの変更をも含め,静電気を発生させない方策こそ重要と考える。

## むすび

静電気によるグラスライニング撹拌槽の損傷事例につい ては,詳細な情報が把握できていないし,また本報で公表 できる範囲にも制約があり,簡略化されたことをご容赦願 いたい。静電気対策については,結果的に製品品質,生産 性を低下させる内容に終始したが,これらが現在考えられ る対策であることをご理解頂く一方で,当社においては耐 静電気用GL機器の開発が急務であると痛感する次第であ る。

#### 〔参考文献〕

- 1. 神鋼パンテツク技報, Vol. 34, No. 3, (1990)
- 2. 神鋼ファウドラーニュース, Vol. 25, No. 1, (1981) p.1
- 静電気安全指針,(1988) p. 3
   森田;安全工学, Vol. 9, No. 3,(1970) p. 144
   静電気ハンドブック,静電気学会編,(1981) p. 799
- 6. I SO 2746, (1973)
- 7. 静電気安全指針,(1988)p. 8
- 8. 北川ら;未発表,(1962)
- 9. 「放電ハンドブック」電気学会, (1989) p. 414, オーム社
- 10. 田畠;「OHM」(1977) p. 68
- 11. 静電気安全指針, (1988) p. 20

内部ジャケット付リアクターの溶接技術

Welding Engineering in Reactor with Inner Jacket



Reactors with inner jacket have been designed to achieve higher productivity of PVC (Polyvinyl Chloride). Although the design of the special jacket has been proved in field operation to give better heat transfer rate, the fabrication of these reactors imposed several welding difficulties mainly because of much amount of weldment in closer joints.

Therefore we reviewed welding engineering in reactor with inner jacket and performed several tests on welding parameters by means of test model vessel.

This paper describes these test result and automated welding.

## まえがき

最近,塩化ビニールの懸濁重合反応などに使用されるリ アクターの設備更新が盛んであるが,従来タイプより少し でも生産効率を高めたいとの要望が強い。当社が開発した 「内部ジャケット付リアクター」は熱伝達効率が良くこの ような要望に合致したリアクターであるが,構造上溶接箇 所が非常に多く,かつ近接しており製作上の課題も多い。

このようなことから内部ジャケット付リアクターの溶接 上の課題について検討を行った。次にこれらの検討結果お よび溶接の自動化について紹介する。

## 1. 内部ジャケット付リアクターの概要

第1図は内部ジャケット付リアクターの概略を示す。従 来は「本体胴の外側」にあったジャケットを「本体胴の内 側」に持ってきた所に大きな特長があり、従来のリアクタ ーとはその構造が全く異っている。

このため機能面では、伝熱に影響を与える内部ジャケット板の板厚を、従来型の本体胴板厚に比べ込以下 に小さくできるので、伝熱効率が良く生産性の増 大に大きく寄与するものと期待される。一方製作 面に関しては、構造上溶接箇所が多くしかも仕切 板、内部ジャケット板のピッチが約70mmと近 接しているため、非常に工数のかかる作りにくい リアクターということができる。ちなみに 60 m³ クラスの内部ジャケット部分の溶接長は

仕切板部 :1500 m 内部ジャケット板部:2200 m(3 層仕上げと して)

であり,外部ジャケット式の場合に比べて格段に 長い。従ってこれらの溶接をトラブルなく効率良 く行うことが品質面,納期面で重要であり,施工 方法,開先形状などについて検討すると共に実機 モデル小型試験体による溶接試験,水圧試験を行 って施工法の妥当性を確認した。

また溶接の自動化についても検討し実機に適用 した。

## 2. 施工方法の検討

1) 開先形状

溶接残留応力, 能率の面から開先形状はできるだけ小さい方が好ましいが, あまりに小さいと開先底部の溶込みが 充分得られなくなる。試験板による予備試験の結果も踏ま え,開先形状は開先角度 30°, ルートギャップ 6 mm の狭 開先とした。

2)溶接方法 .

能率,自動化の容易さ(トーチ回りがコンパクト)など を考慮し,母材,クラッド部共に CO₂ フラックスコアー ドアーク溶接を採用した。

第2図はフラックスコアードアーク溶接の溶着速度を, ほかの溶接法との比較で示したものであるが,手溶接の約 2倍で CO₂ ソリッド溶接に比べても大きい。サブマージ アーク溶接は能率は良いものの(180g/分程度と考えられ る)フラックスの散布,回収,スラグの除去などの問題が





神鋼パンテツク技報

あり採用しなかった。

3) 積層

板厚,開先形状,溶着速度などを勘案し母材部1層,ク ラッド部2層の計3層仕上げとすることにした。また溶接 手順については,1継手ずつの仕上げは現場施工上やりに くいこと,また角変形により仮付けが外れ精度が保てない などの理由から各継手1層ずつ順次溶接することとした。

## 3. 実機モデル小型試験体による溶接試験

内部ジャケット板突合せ溶接部は, ピッチが約70 mm と非常に近接している。このためある継手の溶接での残留 応力などが隣の継手の溶接に悪影響を与え,溶接割れなど の問題を起こす恐れもある。これらを確認する目的で実機 モデル小型試験体を製作し溶接試験を行った。

実機モデル小型試験体での主たる試験目的を次に示す。

第2項で決定した開先形状,施工方法の妥当性確認
 開先が変動した場合の影響の把握

実機の製作においては多少の取付誤差は避けられない ため一部の継手をルートギャップ:5~8 mm, 目違い: 0~1.5 mmの範囲で変動させた。

(3) 溶接手順の影響の把握

溶接は2回に分けて中央から端に向かって順次溶接する場合と端から順次中央に向かって溶接する場合の2と

おりについて試験した。

(4) 水圧試験の実施

実機モデル小型試験体は 1000 ¢×2000 ℓ の円筒で, 溶接継手は全部で20継手あり溶接終了後,水圧試験がで きるよう上下に鏡を付けてある(片側は取り外し可能)。

第1表は、溶接条件を示している。板厚が比較的薄いこと、フラックス入りワイヤの拡散性水素が低いこと(3 cc/100g程度)から低温割れは出にくいと考え、1層目の溶接で予熱は特に行っていない。

#### 3. 1 超音波探傷試驗結果

20継手すべての溶接を終了し48時間以上経過した後,す べての溶接線について目視および超音波探傷試験により, 溶接割れなどの欠陥が出ていないか確認した。その結果, 標準開先,取付誤差を考慮して故意に開先を変動させた継 手など,いずれの継手にも欠陥は見られず施工の妥当性が 確認できた。

#### 3.2 水圧試験

実際に使用されるリアクターは、高圧ガス取締法などの 法規に該当するものが多く「水圧試験」が義務づけられて いる。実機モデル小型試験体についても上下鏡を取り付け (但し片側は取り外し可能),水圧試験を実施した。水圧 は約 5 kgf/cm² ごとに昇圧し、その都度水を抜き鏡を取 り外して目視および超音波探傷試験にて、内部ジャケット 板溶接部に割れなどの欠陥が発生していないかどうかを確 認した。





また水圧試験に当たっては,溶接部に歪ゲージを取り付け,水圧により溶接部に所定の応力がかかっていることを 確認した。

試験は 60 m³ クラスの実機を想定し,最大 43 kgf/cm² (実機長手方向の応力が設計圧力の約 2.2 倍相当)まで行 ったが,溶接部の異常は認められず,今回行った 施工方 法,条件で問題のないことが確認された。

#### 4. 実機施工についで

#### 4.1 実機製作時の留意点

第2項で述べた実機モデル小型試験体による各種の確認 試験結果から,溶接開先,条件など一定の条件下で施工を 行えば溶接割れなど問題の出ないことが確認された。従っ て実機の製作に際してもできるだけ確認された範囲で施工 することが重要であり,このため仕切板,内部ジャケット 板など,部材の製作,取付にも注意を払った。

第2項で述べた内容も含め、実機製作時のポイント、留 意点をあげると次のようになる。

- (1) 歪の出にくい狭開先施工
- (2) 高能率で自動化の容易なフラックスコアードアーク 溶接の採用

ただし1層目の溶接については、実機モデル小型試 験体での試験から、スラグの除去に時間を要し問題の あることがわかり、スラグの少ないタイプ(MX100) を使用することに変更した。

(3) 仕切板,内部ジャケット板の切断,開先加工は取付 精度向上のため機械加工,また取付時の取扱い易さを 考慮し2~3分割

溶接の品質は取付精度に大きく影響される。通常の ガス切断などでは板幅が狭いため長さ方向に「そり」 が発生し、取付精度が悪くなる恐れがある。このため

第 1 表 Table 1	実機モデルの溶接条件 Welding condition in	Edge preparation	Preheat [°C]	Layer	Welding comusmable	Ampare [A]	Voltage [V]	Speed
	mock-up test		Room Temp.	1	DW100 [1.2¢]	240	30	20~30
		D-THER	do,	2	DW309MoL[1.29]	220	35	25~30
		G: 5~8 mm D: 0~1.5 mm	do.	3	DW316L [1.2\$	220	35	25~35



**享 1** 仕切板取付用治具 **'hoto. 1** Jig for fitting up partition plate



第3図 2電極溶接装置 Fig. 3 Twin electrode welding equipment

Magnetic field

Force K

Up

Down

Strip

electrode

Current

Current

Up

Down

Steel bar

™ Force

Magnetic frame

Magnetic field

内部ジャケット部分の部材は機械加工とした。また部 材が大きいと(60 m³ クラスのリアクターで仕切板: 45 kg/1周,内部ジャケット板:65 kg/1周となる)取 扱いにくく結果として取付精度が悪くなる恐れがある ため、2~3分割とした。

また仕切板の取付けに際しては**写真1**に示すような 取付治具を作成し、精度の向上を図った。

以上のような考慮を払った結果,仕切板の取付ピッチ, 引れおよび内部ジャケット板の開先ギャップ,目違などの 文付精度を精度良く所定の範囲に納めることができた。

#### .2 内部ジャケット部溶接の自動化

実機の製作にあたっては、工程短縮、品質確保のため内 ポジャケット部溶接(仕切板隅肉溶接、内部ジャケット板 そ合せ溶接)の自動化を図った。

**第3図**は「倣い付き2電極自動溶接装置」の概略である。 Eな特長を次に示す。

- トーチブラットの部分を回転可能とすることにより、仕切板部、内部ジャケット板部いずれの溶接にも使用できる。
- (2) 2 電極方式のため効率が良い。また仕切板の溶接は 両側同時溶接となるので、倒れが出にくい(1電極に て片側ずつ溶接する場合には凝固収縮によって倒れが 発生し、もう片側を溶接しても元に戻らない)。



- **3 真 2** 2電極溶接装置による内部ジャケット板の 溶接
- **'hoto. 2** Welding of inner jaket plate by twinelectrode welding equipment

第4図 磁気制御方式の原理

Fig. 4 Principle of magnetic control method

(3) 開先倣いを付けているので,倣いのため常時監視している必要がなく監視作業が軽減される。

Weld pool

実機内部ジャケット板突合せ溶接の溶接条件例を**第2表** に,2電極自動溶接装置による内部ジャケット板の溶接状 況を**写真2**に示す。

### 4.3 肉盛溶接の自動化

内部ジャケット部の両端約100 mm は肉盛溶接が必要と なる。肉盛幅は狭いが, 60 m³ クラスの実機では缶径が4 m近くになるため,その肉盛量も相当な量となる。工数削 減,品質確保の面から肉盛溶接方法について検討し,磁気 制御方式による「バンドアーク溶接法」を採用することと した。

第4図磁気制御方式によるバンドアーク溶接法の原理図

### 第2表 実機溶接条件

 Table 2
 Welding condition in actual reactor

Layer	Welding comsumable	Ampare [A]	Voltage (V)	Speed [cm/min]	Built up
1	MX100 [1.4φ]	240~280	32 <b>~</b> 35	20~30	3
2	DW309MoL[1.2ø]	200~230	32 <b>~</b> 35	25~30	C C
3	DW316L [1.2\$]	200~250	32~35	25~35	

第3表 各種溶接棒の比較 Table 3 Comparison of various welding processes

Weldin	g process	FCAW	GTAW [auto]	BAW
Wire size	(min)	1.2φ	1.2φ	0.4t $\times$ 50w
Ampare	(A)	200~240	$200 \sim 240$	750~800
Deposition rate	[g/min]	60~75	15~20	⇒200
Layer		2~3	3	1
Quality of weld	ing bead	Good	Good	Excellent

Note FCAW : Flux cored arc welding

GTAW: Gas tungsten arc welding BAW : Band arc welding

第4表 バンドアーク溶接条件

 Table 4
 Welding condition of band arc welding

Base metal	Welding consumables	Ampare [A]	Voltage [V]	Speed [cm/min]
S S 41	PFB7/USB316EL	800	25	12

を示す。その特長は、溶接電流を利用して溶融プールに強 制磁場を与えることにより、溶融プールを外側に 押し広 げ、溶接上端部のアンダーカットを防止するとともに、肉 盛部を平滑にするところにある。その他バンドアーク溶接 法は次のような特長を有している。

- (1) 溶接電極として帯状電極を使用するので、一度で幅の広い肉盛をすることができる(50 mm 幅の電極では45~50 mm 幅のビードを置くことができる)。
- (2) 使用電流が大きいので, 溶着量が大きく, 効率が良い。
- (3) 帯状電極を使用しているため溶込み深さが小さく, 従って母材の希釈が小さい(約10%)ので,1層で 仕上げることが可能である。
- (4) サブマージアーク溶接同様,溶融プールの表面を溶 融スラグが覆うので,風などの影響を受けにくく溶接 部の品質が良好である。

第3表に各種溶接法により肉盛溶接した場合の比較(一例)を示す。

ハンドアーク溶接による溶着量は約200g/分で、フラッ クス入りアーク溶接の約3倍、ガスタングステンアーク溶 接の約8倍以上となっており、しかも1層で仕上げ可能な ので、非常に効率的な方法であることがわかる。

試験板 (50 t×300 w×500 ℓ) にて各種の確認試験を行った際の溶接条件を第4表に,分析, 側曲げ試験の結果を第 5表に,断面マクロの一例を写真3 に示す。

#### 第5表 バンドアークテスト結果 Table 5 Test result of band arc welding

Radiographic	Side bend test Chemical composition of weld meta										
examination	[n = 2]	С	Ni	Cr	Mo						
No defect	No defect	0.02	12.4	17.5	2. 35						



写 真 3 バンドアーク肉盛溶接断面マクロ Photo. 3 Overlaying macro-structure by band-arc welding

放射線透過試験は,ビードの重なり部についても実施し たが,全く問題はなく,側曲げ試験も良好であった。また 溶接金属の成分についても第5表に示すごとく1層盛でも 十分 SUS316L の規格内に入っている。

以上紹介した「2電極自動溶接装置」「バンドアーク肉 盛溶接」は1989年末から1990年5月にかけて合計5つの実 機に適用されたが、製作上のトラブルは全くなく計画どお りの作業を行うことができた。

#### むすび

内部ジャケット付リアクターの,主に内部ジャケット部 の溶接上の問題,および溶接の自動化について紹介した。 内部ジャケット付リアクターは冒頭に述べたように従来の リアクターに比べて生産性が高く,今後ますます増えてく るものと予想される。

今回紹介した 溶接以外に たとえば「ビードの 研削」な ど, 製作上の課題は他にも残っている。品質向上, 納期短 縮に向けて更に取組んで行く予定である。

〔参考文献〕

- 1) 神鋼パンテツク技報 Vol. 32 No. 3 (1988/12)
- 2)溶接法研究委員会資料(第117回)
- 3) 神戸製鋼所溶接技報 No. 539

## 高粘度液用薄膜蒸発機「エクセバ」の蒸発性能

The Evaporating Performance of The Thin Film Evaporator "EXEVA" for High Viscous Products



(化)技術部 設計第2課
 山 崎 忠 成
 Tadashige Yamasaki

"EXEVA", our newly developed thin film evaporator is much useful for highly viscous solutions which Wiped Film Evaporator (WFE) cannot process.

This paper describes some test results with various solutions offered by our customers. The test results show that "EXEVA" is ideally suited for the evaporation of large quantities of solvents or monomers from low viscosity solutions and also for the evaporation of small quantities of solvents or monomers from highly viscous solutions.

"EXEVA" is going to be used in the polymer industries to improve product quality and productivity, and to save energy and capital costs.

## まえがき

当社のWFE薄膜蒸留装置(撹拌式薄膜蒸発機)は,蒸 者面全体に均一な薄膜を形成し,薄膜表面を更新している )で,大きな伝熱係数がえられ高効率な蒸発を行うことが ごきる。この装置は,滞留時間が数秒と短く,真空下で操 ドすることができるので,熱影響を受け易い物質や沸点の 馴い物質の精製,濃縮,脱色,脱臭などの操作を必要とす 5食品, 医薬品,石油化学工業分野に広く用いられてい 5。しかし,この装置は,最終処理液が自然流下できる低 占度のものにしか適用することができない。

近年,高分子化学工業界では,ポリマーの高品質化,高 養能化,高性能化に対応してポリマー製造プロセスのポリ マー溶液の濃縮,脱モノマーや脱揮工程で高粘度液の効率 い蒸発装置が要望されている。このようなユーザニーズ ニ応えて,WFEで処理することのできない高粘度液から ン脱モノマー,脱揮が可能な高粘度液用薄膜蒸発機「エク ェバ」を開発し,その機構,特長および各特性については, 死に,本誌 (1989年 Vol. 33, No. 2)で詳述している。

「エクセバ」は、1989年11月東京で開催された化学プラ /トショーで発表以来好評を博し、種々の実液実験でその 注能をいかんなく発揮しており、本稿では、その蒸発実験 )中から一部を報告する。

なお、本機の基本構造は、日本・米国・欧州で特許出願 Pである。

## . エクセバ実験装置の仕様

写真1にテスト装置を示す。

本実験を実施するにあたって使用した実験装置の仕様を マに示す。

(1) エクセバ

材 質 : SUS316 本体内径 : 155 mm 搅拌機動力: 7.5 kW 排出機動力: 0.75 kW 伝熱面積 : 0.2 m² 回 転 数 : 50~1 750 rpm 〃 : 1~160 rpm - ※(2) 原料槽

材 質: SUS316 容 量: 30ℓ (3) コンデンサ 材 質: SUS316 伝熱面積: 0.3 m² (4) 受器 材 質: SUS316 容 量: 10ℓ

 (5) 加熱熱媒[`]
 0.4 MPa (4 kgf/cm²) スチームおよび最高 300 °C熱 媒

(6) 系内圧力

0.5 Torr~大気圧

次に述べる各実験で各々の実験装置フローを示している が,それらの機器仕様は本章による。

#### 2. 実液実験

2.1 樹脂の蒸発実験

2. 1.1 実験目的

溶媒 62 % (ポリマーA) と 68 % (ポリマーB) 含んだ 2 種類のポリマー溶液を蒸発して,含有溶媒量を1%以下 にする。



写真1 テスト装置 Photo.1 Experimental equipment



第1図 実験フローシート Fig.1 Flow sheet of test



第2図 ポリマー濃縮のフローシート Fig. 2 Flow sheet for polycondensation

- 2. 1. 2 実験装置および実験方法
- 第1図に実験装置フローを示す。

実験方法は、ポリマー溶液を原料槽に投入してギヤポン プでエクセバに供給した。エクセバのジャケットに熱媒を 流し、本体伝熱面を加熱して、本体内壁面に形成された薄 膜の溶液中から溶媒を蒸発して、スクリュー排出機から出 てくる残留液を採取した。このサンプルを乾燥器内で110 °Cに 20時間保持して、残留溶媒を蒸発させて減量より残 留溶媒量を求めた。

#### 2. 1. 3 実験結果

ポリマーAの実験結果を**第1表**のNo.1,2,3にポリマー Bの実験結果をNo.4,5,6に示す。ポリマーAでは処理量  $175 \text{ kg/m}^2h$ で,ポリマーBでは  $95 \text{ kg/m}^2h$  で目的を達 成することができた。No.2,3 は処理量,操作条件共おな じであるが,撹拌翼回転数が各々異なり,回転数が速い程 良い結果となった。

No.1の残留液の粘度が,他に比べて低いのは,残留液の 温度が高くなっているためである。これは,濃縮がすすむ につれて粘度が高くなりその結果撹拌動力が増え,撹拌エ ネルギーによって残留液温が上がったためである。

本実験結果は,エクセバが1台でポリマー中に溶媒量が 60%以上も含まれた低粘度液(粘度2.5 P)を蒸発して, 残留溶媒量を1%以下にできることを示している。

エクセバを適用した本ポリマーの蒸発プロセスを**第2図** に示す。

第1表 EXEVA テストデータ Table 1 Performance and operating data of EXEVA

ľ

		Fe	eed			Disc	narge	Operating		
Ňо.	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Pressure	Temperature
	kg/m²h	%	%	Р	kg/m²h	%	%	Р	Torr	°C
1	175	38	62	2.5	67.2	99.0	1.0	440	264	220
2	220	¥	¥	¥	86.8	96.3	3.7	4 500	244	¥
3	220	÷.	c o	Å -	88.1	94.9	5.1	6 700	240	Ý
$\frac{4}{5}$	140	32	↓	2.5	45.4	99.2 98.7 ~	1.3	3 000	265 265	Ť
6	175	↓ _	¥	Ļ	60.3	92.9	7.1	2 300	760	Ť

本プロセスは、予備濃縮と本濃縮を行う2段濃縮法に比 較して、非常にシンプルであり、運転操作も簡単である。

#### 2.2 スチレン系樹脂の蒸発実験

2. 2. 1 実験目的

高分子量グレードのスチレン系ポリマー溶液を蒸発して,残留揮発分が5%以下での処理量を求める。

- 2. 2. 2 実験装置および実験方法
- 第3図に実験装置フローを示す。

実験方法は、次の手順にて行った。

- (1) 原料槽のジャケットに温水を流し,80°Cに加熱した後,その中にポリマー溶液を投入した。
- (2) 原料槽からギヤポンプで送液し、途中スタテックミキサー(ジャケットをスチーム加熱)にてポリマー溶液をさらに加熱して、エクセバに供給した。
- (3) エクセバで 蒸発後の 残留液から サンプルを 採取して、これをガスクロマトグラフィによって分析して含有揮発分を求めた。

#### 2. 2. 3 実験結果

第2表に実験結果を示す。

本実験結果からエクセバは,標準グレードより粘度が高い,高分子量グレードのスチレン系ポリマー溶液を濃縮して,残留液が3200 Pa・s (32000 P)の高粘度液を処理できることを示している。

また,本ポリマーを供給液量で400 kg/m²h も処理する ことができ,処理能力としても申し分のない結果が得られ た。



3図 実験フローシート ig.3 Flow sheet of test

#### 3 スチレン系樹脂の蒸発実験

3.1 実験目的

市販のスチレン系樹脂製品で標準グ ードと高分子量グレードの2種類か 蒸発して,エクセバで最終揮発分を こまで低減できるかを調べる。 3.2 実験装置および実験方法

第4図に実験装置フローを示す。

実験方法は、スチレン系樹脂ペレットを一軸押出機で溶 !昇温して、エクセバに供給し、蒸発後、残留液からサン 'ルを採取した。これをガスクロマトグラフィによって分

第 2 表 EXEVA テストデータ

Table 2 Performance and operating data of EXEVA for polystyrene-acrylonitrile

	]	F	eed			Disc		Operating		
No.	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Pressure	Temperature
	kg/m²h	%	%	Р	kg∕m²h	%	%	Р	Torr	°C
1 2 3	150 250 400	49 ↓	51 ↓ ↓	500 ↓	76 128 206	96. 8 95. 8 95. 2	3.2 4.2 4.8	32 000 26 000 30 000	507 502 503	260 ↓

析して残留揮発分を求めた。

#### 2. 3. 3 実験結果

第3表の№1,2は標準グレード,№3,4は高分子量グ レードのスチレン系樹脂の実験結果を 示す。

3 表 EXEVA テストデータ

**ible 3** Performance and operating data of EXEVA for polystyrene-acrylonitrile

		F	eed			Discharge         Operation           Polymer         Solvent         Viscosity         Pressure         T           %         %         P         Torr         T           99.9         0.010         10 000         5         5           99.9         0.015         6 200         30         30	erating			
lo.	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Pressure	Temperature
-	kg/m²h	%	%	P	kg/m²h	%	%	Р	Torr	°C
1	110	99.75	0.25	25 000	110	99.9	0.010	10 000	5	235
ŝ	130	99.78 99.83	0.22 0.17	65 000	130	99.9 99.9	0.015	20 000	5	236
4	135	$\downarrow$	0.17	65 000	135	99.9	0.035	10 300	30	236

第3表で残留液粘度が供給液粘度よ り低くなっているのは,撹拌翼による せん断エネルギーによって残留液温が 上昇したためである。このように供給 液粘度が高いと撹拌エネルギーが多く 与えられ,この撹拌エネルギーが蒸発 表面に作用するので,超高粘度液にお



第4図 実験フローシート Fig. 4 Flow sheet of test

第4表	EXEVA テストデータ
Table 4	Performance and operating
	data of EXEVA

		Fe	eed			Disc	harge		Operating		
No.	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Rate	Polymer	Solvent	Viscosity	Pressure	Temperature	
	kg/m²h	. %	%	Р	kg/m²h	%	%	P	Torr	°C	
1	100	60	40	2 200	60	99.8	0.2	2 000	21	120	
2	130	4	$\downarrow$	¥	78	99.5	0.5	$2\ 000$	4	$\downarrow$	
3	145	¥	$\downarrow$	$\downarrow$	87	99.9	0.1	$1\ 200$	↓	130	
4	175	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	106	99.1	0.9	3 800	↓	$\downarrow$	
5	95	60	40	300	57	99.5	0.5	2800	6	92	
6	125	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	76	99.2	0.8	3 100	↓	Ŷ	

いても優れた脱揮性能を有することに なる。薄膜温度は、ジャケットの熱媒 温度より高くなっているので、ジャケ ットからの伝熱エネルギーはないと考 えられる。

本実験結果は、エクセバに 6 500 Pa・s (65 000 P) もの高粘度液を供給して、高効率な脱揮、すなわち 市販のスチレン系樹脂製品を蒸発して、標準グレー ドでは揮発分を1/15~1/25に、高分子量グレードで は揮発分を 1/5~1/11 にできることを示している。

エクセバは,溶媒を多量に含んだ低粘度液から溶 媒を蒸発して高粘度液になる物質を処理できるばか りでなく,このように,溶媒の非常に少ない高粘度 液からさらに溶媒を蒸発させて高品質な製品を得る ことができる。

現在,スチレン系樹脂で揮発分を数%から0.3% Fig 以下にする連続蒸発プロセスに,2軸押出機が適用 されている場合がある。2軸押出機は,ポリマー溶 液に水を添加して蒸発しなければ残留揮発分を0.3%以下

にすることが難しい。水の添加は,蒸発界面を増し,水と の共沸を利用している。

蒸発性能は,処理量とも関連があり,2軸押出機の詳し いデータがないので,正確な比較はできないが,エクセバ は水の添加なしで現状よりはるかに少ない残留揮発分にす ることができたことから,2軸押出機より蒸発性能は優れ ているといえる。

本実験結果は,エクセバが通常2軸押出機が適用されて いる超高粘度液からの最終蒸発プロセスに適用できること を示している。エクセバは,蒸発性能面ばかりでなく装置 価格面からも十分2軸押出機に対抗できる機種である。ポ リマー製造プロセスにおける最終蒸発プロセスに,2軸押 出機が数多く用いられていることから,エクセバの適用プ ロセスは多いと考えている。

2.2 と 2.3 の実験結果より,エクセバを用いたスチレン 系樹脂の蒸発プロセスを第5図に示す。

本プロセスは,重合後のポリマー溶液をエクセバ1段目 で残留揮発分を数%程度まで蒸発して,2段目で残留揮発 分を0.3%以下まで蒸発する。そしてギヤポンプで昇圧し てストランド後,ペレットにして製品となる。ギヤポンプ による昇圧は,押出機による昇圧に比べて,省エネルギー で経済的である。このように,蒸発性能の優れたエクセバ と昇圧能力の優れたギヤポンプの組合せは,従来の2軸押 出機に比べて,イニシャルコスト,ランニングコストが低 く,高品質な製品が得られるなど多くの利点をもったプロ セスであるといえる。

本プロセスは,スチレン系樹脂製造プロセスの蒸発のみ でなく他のポリマーにも適用可能であると考えている。

2.1, 2.2 と 2.3の実験結果から, エクセバの蒸発プロセスは原料中の含有揮発分, 処理量, 操作条件, 製品中の残



第5図 高粘度ポリマー濃縮・脱揮工程フローシート Fig. 5 Flow about of polynomiamotics for high views and

Fig. 5 Flow sheet of polycondensation for high viscous products

留揮発分などを考慮して,エクセバ1段処理または2段処 理が選択されることになる。

## 2. 4 樹脂の蒸発実験

2. 4. 1 実験目的

ポリマー溶液(ポリマー A.B の2種類)中に含まれる 溶媒40%を蒸発して、含有溶媒量を1%以下にする。

#### 2. 4. 2 実験装置及び実験方法

実験装置フローおよび実験方法は,2.1.2(第1図)と同様であるが,サンプルは,ガスクロマトグラフィによって分析して残留揮発分を求めた。

2. 4. 3 実験結果

第4表で№1~4はポリマーA, №5,6は、ポリマー Bの実験結果を示す。

0.2 m² エクセバテスト機ではポリマーA, B 共に, 溶 媒1%以下に脱揮して残留液でそれぞれ20 kg/h, 15 kg/h 処理することができた。

2 軸押出機 (ø35 mm, 脱揮ゾーン 3 ヵ所付) でのポリマ ーAの蒸発テスト結果は, 残留液で 2.5 kg/h しか処理で きなかったとのことである。2 軸押出機のテスト条件の設 定などで処理量アップの検討の余地があると考えても, エ クセバに比べて非常に少ない処理量である。

このように、エクセバの蒸発性能は粘度および粘着性の 高い樹脂でも、2軸押出機より格段に優れている。

#### 2.5 樹脂の蒸発実験

#### 2. 5. 1 実験目的

ポリマー中に含まれるモノマー 0.3%および高沸点不純物0.6%を脱揮してモノマーを0.2%以下(目標 0.1%)高 沸点不純物を0.1%以下(目標 0.05%以下)にする。

### 2. 5. 2 実験装置および実験方法

本実験装置 および 実験方法は,2.3.2 (第4図)と同様 である。

<b>第5</b> 表	EXEVA テストデータ				Feed				- i	Discharge			O	perating
[able 5	Performance and operating data of	No.	Rate I kg/m²h	Polymer N %	Aonomer %	Dimer %	Viscosity P	Rate kg/m²h	Polymer %	Monomer %	Dimer %	Viscosit P	y Pressure Torr	Temperature °C
	EXEVA	1 2 3	75 150 150	99 ↓	0.3 ↓	0.6	35 000 ↓ 62 000	75 150 150	99 99 99	0.07 0.07 0.08	<0.01 0.03 0.04	8 000 6 000 5 200	10 30 30	235 233 215
<b>第6表</b>	EXEVA テストデータ	. <del></del>			Feed				D	ischarge			Op	erating
fable 6	Performance and operating data of	No.	Rate kg/m²h	Polymer %	Monor %	ner V	⁷ iscosity P	Rate kg/m²h	Polyme:	r Monom	er Vi	iscosity P	Pressure Torr	Temperature °C
	EXEVA for silicon-rubber	1 2 3 4	60 55 51 44	86. 2 ↓ 97. 3 ↓	$13. \downarrow \\ 2.7 \\ \downarrow \\ $	8 0	2 000 ↓ 3 000 ↓	52 47 50 43	99. 61 99. 75 99. 57 99. 56	0. 39 0. 25 0. 43 0. 44	5	3 000 ↓ ↓	0.5 ↓ ↓	190 220 190 ↓

第7表 EXEVA **Fable 7** Perform operatir

EXEVA テストデータ				Feed	1				Dischar	ge		Op	erating
Performance and	No.	Rate	Sulfonic	Water	Methanol	Viscosity	Rate	Sulfonic acid	Water	Methanol	Viscosity	Pressure	Temperature
operating data of		kg/m²h	%	%	%	P	kg/m²h	%	%	ppm	P	Torr	°.C
EXEVA for	1	240	49	45	4	50	121	97	3	37	170	760	198
surfactant	2 3 4	150 250 159	ţ	¥	ł	ţ	76 128 81	97 96 96	3 4 4	0 79 59	$150 \\ 250 \\ 180$		196
		100	•	• •	•	•	0.2				100	•	¥

#### 2.5.3 実験結果

#### 第5表に実験結果を示す。

第5表からエクセバは、残留モノマーおよび残留ダイマ ー共に目標値を達成している。№.1,2,3で残留モノマー 分にほとんど違いがでていない理由は、本ポリマーが高温 伏態では,ポリマーが分解してモノマーを発生するためで ある。それゆえ、本ポリマーの脱揮性能は、残留ダイマー の含有量で評価することができる。

エクセバは,現ポリマー製品を脱揮して,残留ダイマー を1/15~1/60にすることができた。

#### **2.6** シリコーン樹脂の蒸発実験

#### 2. 6. 1 実験目的

含有低沸物 13.8% のシリコーン樹脂(A)を 蒸発して 1%以下にする。また、含有低沸物2.7%のシリコーン樹 指(B)を蒸発して、低沸物濃度がどこまで下がるかを調 べる。

#### 6.2 実験装置および実験方法

実験装置フローは、2.3.2(第4図)と同様である。

実験方法は、シリコーン樹脂A、B共に原料をナイフで 約4 cm角に切断して, 押出機に押し込んで溶融し, 200°C に昇温してエクセバに供給した。エクセバで蒸発後、残留 夜からサンプルを採取して,それを 乾燥器内で 170°C に 12時間保持して、減量より残留低沸物を求めた。

#### 2. 6. 3 実験結果

シリコーン樹脂(A)の実験結果を第6表の№1,2に, シリコーン樹脂(B)の実験結果をNo.3,4に示す。

第6表の№1,2の含有低沸物13.8%のものも,№3, 4の含有低沸物2.7%のものも、エクセバで処理後は、残 留低滞物が共に約0.4%にであることから、エクセバの処 理量にはまだ余裕があることがわかる。これは、実験方法 で述べたように押出機へのシリコーン樹脂切片の供給が手 動のため、エクセバへの供給量が制限され処理量が少ない 結果となったためである。

No.3とNo.4は、 撹拌翼回転数がそれぞれ異なるが、 残留 低沸物は同等であった。

操作温度の高い№2が残留低沸物が最も少ない。又,同 じ操作条件で2パス, 3パス処理しても残留低沸物濃度は ほとんど変わらなかったことから、高粘度シリコーン樹脂 の残留低沸物濃度は、気液平衡より操作真空度と残留液温 度で決定される。

2 軸押出機でシリコーン樹脂(B)の脱揮テストを実施 したが, 脱揮部分で樹脂が発泡して, 真空度を上げること ができず,残留低沸物濃度は2%より良くならなかったと のことである。

#### 2.7 界面活性剤の蒸発実験

2. 7.1 実験目的

界面活性剤中に含まれるメタノール4%を蒸発して,残 留液中のメタノール含有量を 200 ppm 以下にする。

#### **2.7.2** 実験装置および実験方法

実験装置および実験方法は 2.1.2 (第1図) と同様であ るが,サンプルはガスクロマトグラフィによって分析して 含有メタノール量を求めた。

#### 2.7.3 実験結果

第7表に実験結果を示す。

び

第7表のNo.1,2とNo.3,4は、回転数が異なり、回転数 が速いほど脱揮性能は良好である。残留液は、マヨネーズ のように粘度が低くて流動性が全くなかったが、エクセバ からはスムーズに排出することができた。残留液中のメタ ノール含有量は、目的を達成することができた。

本物質は、非常に発泡性があるが、撹拌翼の高速回転に より、飛沫および付着はみられなかった。

#### む す

高粘度液用薄膜蒸発機「エクセバ」について、客先支給 の各種溶液での蒸発実験結果を一部紹介したが、これから でも,従来機に比べて「エクセバ」の蒸発性能がいかに優 れているかを確認いただけると思う。

今後、ポリマーの高品質化にともなって、モノマーおよ び溶剤の許容値はますます厳しくなってくるであろうし, 設備の簡略化,連続化,省エネルギー化が強く求められて くる。「エクセバ」は、多くの 利点を 備えており、これら の要求に十分対応できると考えており、これからも、高粘 度液の蒸発に携わっておられるユーザ各位の要望に応えて いきたい。

# イオンスクラバー実装置紹介

**Full Size Ion Scrubber** 



The paper presents the ion scrubber recently manufactured and delivered by Shinko Pantec. The unit demonstrates a dual function of efficient removal of fine particles less than  $0.05 \,\mu$ m as well and hazardous gases and deodorization, which have never been attained by a single conventional wet dust collector. Described here is an analysis of the performance of the ion scrubber ranging from pre-order test using a pilot test unit up to selection of a full size unit. The full size unit has succeeded in obtaining outlet dust concentration close to the design level despite the concentration of inlet dust in exhaust gases substantially exceeding the design level.

#### まえがき

従来ダストと有害ガスを同時に除去する方法としては, 電気集塵機と洗浄塔またはベンチュリースクラバーと洗浄 塔などによる2段方式が主であった。当社において,電気 集塵機と洗浄塔の特性を兼ね備えた排ガス処理装置「イオ ンスクラバー」の販売を開始し,以来約2年が経過した。 この間,主として産業廃棄物焼却炉,光関連設備用炉およ び金属溶解炉などからの排ガスを対象とし,各方面へパイ ロットプラントをもちこみ各種のデータを収集してきた。 この装置は'90年10月現在製作中も含めると9機を数えている。

本稿では、イオンスクラバーの概要ならびに銅スグラッ プ溶解炉排ガスのパイロットプラントによるテストおよび 実装置を紹介する。

#### 1. イオンスクラバーの概要

イオンスクラバーは、 $0.05 \,\mu$ m 以下の固体または液体微 粒子をも高効率かつ、少ないエネルギー消費量で除去する 目的で開発したものであるが、粒径  $1 \,\mu$ m 以上の粗粒子、 有害ガスおよび悪臭ガスも同時に処理することができる。

装置内で有害ガスおよび悪臭ガスは高性能充填部を流れ る循環液に吸収される。粗い粒子および液滴は慣性衝突に より捕集され,煙霧質状のものはイメージ作用力により除 去される。このイメージ作用力は,荷電された粒子が中性 表面に接近(約1mm)すると発生し、反対極性の静電気 を誘引し、粒子はその表面に引き寄せられるという原理で ある。

通常燃焼炉排ガスを処理する場合,イオンスクラバーは 急冷塔と組合わせて採用する。

また,イオンスクラバーは装置内部に洗浄装置を備えて おり,タイマー制御により定期的に洗浄を行う構造となっ ているため装置内でのダスト,塩の堆積が最小限におさえ られメンテナンス周期も長く採ることができる。

### 1.1 装置の構造

装置は大きく2つのブロックに分かれており前部の高電 圧イオン化部と後部のスクラバー部より構成されている。 (第1図)

排ガス中の粒子はまず高電圧イオン化部で静電気的に荷 電され、一部はプレートに、残りはスクラバー部でイメー ジ作用力(第2図)により高性能充填材に捕集される。放 電電極は負でプレートは接地極となっている。プレートは 濡れカベとなっており固体粒子やスケールが堆積しないよ う常に循環洗浄しているため安定した粒子のイオン化が期 待できる。

イオンスクラバーは高い電気抵抗値を持つ固体粒子であ っても荷電可能である。







写真1 イオンスクラバーパイロット機 Photo.1 Ion scrubber pilot plant

#### 1.2 スクラバー部

イオン化部後部のスクラバー部は固体および液粒子を効率よく捕集するため表面積の大きい充填材で構成されている。排ガスは充填部を水平に横切り循環液は充填部を上方から下方へ流れている。この間に固体は慣性衝突,イメージ作用力により捕集され,それと同時に有害ガスも洗浄液に吸収される。充填材上部には低圧オリフィス形散水ノズルが設置されている。散水ノズルから噴霧される液滴径は小さいので充填部のガス吸収効果をさらに高められる。

#### 1.3 耐蝕性

イオンスクラバー本体は大部分がFRP樹脂製品および FRPライニング材で構成されており,一般的なFRPの 耐熱温度90°Cまでは前処理(急冷塔)なしで排ガスを通 すことが可能である。しかし低温度のガスに対してはイオ ンスクラバー前部にて加湿し,飽和状態に近づけてやるほ うが実装置も小さくなり,また集塵およびガス吸収効果も 高まる点で望ましい。排ガスと直接接触する金属部分は SUS316,SUS316L,チタンおよびハステロイCなど 耐蝕性金属の中から最適な材質を選定している。

#### 1. 4 圧力損失

本装置の圧力損失は,空塔速度にもよるが平均30 mmAq であり急冷塔を設置しても系内で 50 mmAq 程度である。 それゆえベンチュリースクラバーと比較すると運転費がは るかに安価であり,建設費の差は 1~2 年で相殺されるこ とが計算より得られている。

### 2. 銅スクラップ溶解炉のパイロットテスト

#### 2.1 テスト

パイロット機は  $30\sim 60 \text{ m}^3/\text{min}$  処理の能力を 持っており各主要部材および仕様は次のとおりである。

本	体	: F R P	$6460 \text{ mm}$ L $\times 620 \text{ m}$	m₩
			$\times 2380 \text{ mmH}$	•

イオナイザー		
プレート	: SUS316	
放 電 線	:ハステロイ	С
充填材	: P. P	
内部配管	:FRP	
外部配管	: C - P V C	
循環ポンプ	: PVDF	$500 \ \ell/\min \times 15 \ m$
		$ imes 3.7 \ \mathrm{kW}$



FRP 70 m³/min×250 mmAq × 5.5 kW

パイロット機本体,操作盤およびポンプなどは**写真1**に 示すようにユニット式となっておりトラックでの輸送が容 易な構造となっている。

銅スクラップ溶解炉より発生する排ガス中のダストおよ び,HClガス除去を目的とするイオンスクラバーのサイズ を決定するためにテストを実施した。テストは,第3図に 示すように既設ダクトよりバイパスダクトを設けテスト機 へ接続して実施した。実装置の場合もバイパスダクトおよ びイオンスクラバーを経由し,既設の煙突へルートを戻し ている。また,今回の装置においては系外への排水も制限 されているため,極力循環使用することを前提にブロー水 に凝集剤を添加した場合の沈降速度および排水SS濃度を も合わせて測定を行った。

#### 2.2 テスト結果

実装置の設計条件	
処理ガス量	:15000m ³ N/h wet
処理ガス温度	
および水分	:50°C 飽和
入口濃度	
ダスト	:0.5g/m³N dry
HCl	: 50 ppm dry
出口濃度	
ダスト	:0.03g/m³N dry
HCl	:3ppm dry 以下
排水量	: 2.4 m³/day

設計条件におけるダスト除去率は94%, HCl ガス除去 率も94%である。この条件を満足する実装置を設計製作 するためにテストを実施した。テストにおいては炉での溶 解材料を良材と焼線材とに分けて試験を行った。

テスト機へのガス流入量は、バイパス取り合い点におい て13,15,17 m³N/min wet とした。また。HCl ガス吸収 を考慮し、スクラバー循環液は NaOH 水溶液とし pH 計に より濃度の自動調節を行った。

原ガスの性状を第1表に、イオンスクラバーでの集塵効 率を第4図に、イオンスクラバー入口および出口での粒径

#### 第1表 原ガスの性状 Table 1 Original gas charactor

Item to be measured	Reasonable material	Burned wire
Dust concentration [g/m³N dry]         Sulfur oxides       [ppm]         Nitrogen oxides       [ppm]         HCl       [mg/m³N]         Cl ₂ [mg/m³N]         Smell concentration/index [-/-]       Gas quantity         Gas temparature       [° C]	$\begin{array}{c ccccc} 0.03 \sim 0.04 \\ <1 \\ 8 \sim 14 \\ 1 \sim 3 \\ <0.1 \\ -/- \\ 14800, \ 16800 \\ 52, \ 49 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0.26{\sim}0.42\\ <1\\ 6{\sim}9\\ 12{\sim}168\\ <0.1{\sim}0.3\\ 410/26.2\\ 13900,15100\\ 95,65\end{array}$

#### 第2表 実装置ガス分析結果

Table 2 Results of gas analysis in full size Ion Scrubber

Item to be measured			Inlet of IWS	Outlet of IWS
Actual gas quantity Design gas quantity	(m ³ N/Hr (m ³ N/Hr (m ³ N/Hr	wet] dry] wet]	13 500 13 000 15 000	13 200 12 600 15 000
Actual dust quantity Design dust quantity	[g/m³N [g/m³N	dry] dry]	$2.26 \\ 0.5$	0.04 0.03
Actual HCl quantity Design HCl quantity	[mg/m³N [ppm [ppm	dry] dry] dry]	934 573. 2 50	38 23. 3 3
Actual Cu quantity	[mg/m ³ N	dry]	56.6	4.6



写 真 2 イオンスクラバー実装置及び沈殿槽 Photo. 2 Full size Ion Scrubber and precipitation vessel

#### 分布を第5図に示す。

#### 2.3 考察

焼線材は良材に比べ,ダスト濃度および HCl 濃度が高 値を示しており原材料の影響が大きい。イオンスクラバー の効果は吸引ファン吐出口の煙の有無を一つの判定基準と した。

良材の場合,既設スクラバーでも県の基準を満足していたが煙は消去されていなかった。これにイオンスクラバーを使用すると,風量 930 m³N/h wet において煙は完全に消失しダスト濃度は  $0.01 \text{ g/m^3N}$  dry 以下となった。

焼線材の場合は、風量 990 m³N/h wet においてわずか に煙が残った。この時のダスト濃度は  $0.05 \text{ g/m^3N}$  dry で あり除去率は 93.6% であった。高圧電源装置 ON の場合 の煙と OFF の場合とを比較すると、煙は ON でわずかに 目視できる程度であり、OFF の場合のようなたなびきはな かった。

イオンスクラバー入口および出口における粒径分布は, ほぼ同一であった。

#### 3. 実装置

パイロットテストの結果を基に実装置を納入したのでその外観を写真2に、フローシートを第6図に示す。実装置におけるガス分析は第2表に示すとおりであり、煙突から



第4図 テストでの空塔速度と集塵効率の関係 Fig. 4 Relation between gas speed and collection efficiency in pilot test





Fig. 5 Particle size distribution





の排ガスは目視不可能か,わずかに可視される程度に下が った。

以上のようにイオンスクラパーにおいては、ダストに対 する集塵効率およびガスの除去効率、この両方を同時に満 足するように装置サイズが決定される。しかしながら、ダ ストの集塵効率はガス吸収のデーターのように安定性がな く、ガス組成により大きく異なり、同一風量であっても入 ロダスト濃度の低下に伴い集塵効率が低下していくなど、 今後共パイロットテストの必要性がある。

# 新型球状充填材の開発

Aptitude Tests of Newly Developed Spherical Media at Anaerobic Bio Reactor (AB reactor)



A new plastic spherical packing media (HEC BALL) was developed for the use in anaerobic treatment. The HEC BALL was compared with other conventional media in strength and sludge settleability to and separability from the media. The comparison tests demonstrated the availability of the HEC BALL for commercial use. The HEC BALL is superior in sludge separability when packed at random and there is no problem in strength and settleability.

### まえがき

固定床式嫌気性反応槽用新型充填材の開発にあたり構 造,形状に関する基本概念は次の条件を満足することであ

- った。
  - (1) 充填物表面と流体が一様に効率よく接触できる形状であること。
  - (2) 個体沈殿物が溜るようなデッドスペースを形成しないこと。
  - (3) 汚泥の成長に伴って、目詰まりを生じるような狭い 隙間を作らない。
  - (4) 充填物が充填槽内で互いにかみ合わないこと。
  - (5) 機械的強度が十分であること。
  - (6) 製作が一回の金型開枠でできる構造であること。

上記の事項を踏まえ,開発した充填材が  $\land \neg \rho \pi - \nu$ (High Efficiency Contact Ball の略で以下  $\land \neg \rho \pi - \nu$ ルと呼ぶ。)であり,第1図に外形図を示した。

ー方ヘックボールを実装置で使用した場合,性能的に要求される構造強度,汚泥付着状態および汚泥剥離状態を確認するため試験を行った。ほかの2種充填材についても比較のために同一の試験を行った。次にその結果を報告する。

## 1. 強度試験

#### 1.1 強度試験の目的と方法

ヘックボールが実装置の使用に耐え得るかどうかを,単 体による強度試験と数個の充填材をランダム充填した場合 の強度試験を行った。また評価対象として,現在使用して いる2種類の充填材(V充填材,M充填材)について同様 の強度試験を行った。



第1図 ヘックボール外形図 Fig. 1 Configuration of HEC Ball 1. 1. 1 充填材単体の強度試験

ヘックボールとその他2種類の充填材1個の強度を縦, 横,斜めの方向から検討を行った。第2図に荷重条件を示 す。強度試験には島津製オートグラフAG10TB形精密圧 縮機を用いて,押し下げ速度10mm/minとして行った。 強度は降伏点強度(残留ひずみはあるが,破壊まで到って ない強度)で比較した。

 1. 2 数個の充填材をランダム充填した場合の強度試験 ヘックボールとその他2種類の充填材をそれぞれ480^w ×480^L×700^B mmの箱に詰め、上部に押え蓋をして強度 試験を行った。第3図に荷重条件の例を示す。また強度の 比較は単体の場合と同様、降伏点強度で行った。

### 1.2 実験結果と考察

1. 2. 1 強度試験結果

充填材単体の強度試験結果を第1表に,また数個の充填 材をランダム 充填した場合の 強度試験結果を第2表に示 す。

第1表および第2表より次のことが確認された。

(1) 強度的にはM充填材が最も強く、V充填材、ヘック



第3図

数個の充填材をランダ ム充填した場合の荷重 条件

Fig. 3

Loading condition in the case of several units randomly filled





第2図 単体の荷重条件 Fig. 2 Loading condition in the case of one unit

## 第1表 充填材単体による耐荷重試験 Table 1 Loading test of one unit of media

Type	Direction	Maximum load (kg)	
HEC ball	Horizontal Vertical	55 65	
	Vertical		
M media	Holizontal	490 80	
V media	Holizontal	190	

第2表 数個の充填材による耐荷重試験(488L×488W×700Hの箱に充填) Table 2 Loading test of several units of media (Filled in a box measured 488L×488W×700H)

	<u>(x mea</u>	m a box i	neasured 400	$L \times 488 W$	×700H)
Type	Number	Maximum load [kg]	Compression rate at maximum load (%)	Recovery rate	Remarks
HEC ball	80	1 300	32.0	56.0	1) No breakage 2) No engagement among media
M media	158	2 380	30. 0	49.0	<ol> <li>No breakage</li> <li>Overall engagement among media</li> </ol>
V media	47	2 600	24. 2	46.5	1) No breakage 2) Some engagement among media



ボールの順であった。

- (2) いずれの充填材も破壊することはなかった。(3) 圧縮後の復元率はヘックボールが最も大きくV充填
- 材,M充填材の順であった。 (4) 下線後の方墳社日本の約111
- (4) 圧縮後の充填材同志の絡みは、ヘックボールでは全 く認められず、V充填材では一部絡みが認められ、ま たM充填材では全体的な絡みが認められた。

上記の結果より, ヘックボールは充填材同志の絡みがないことから, 充填材によるプリッジの形状が起こりにくいと推定される。これは形状が球状であることに起因し, A Bリアクターの充填材には適しているといえる。

1. 2. 2 充填材に要求される強度の検討

実装置に使用するための必要強度の確認を行った。

- 充填材投入初期にかかる最大荷重は、充填高さ10 mの場合で、約420 kg/m²(付着汚泥のない場合)と なる。
- (2) 充填材に汚泥が付着した場合の充填材にかかる最大 荷重は,槽内で水が存在する状態下では,約35 kg/m² (充填高さ10 m)となる。
- (3) 汚泥が付着した状態で, 槽内が水抜きされた場合, 充填材にかかる最大荷重は,約5000 kg/m²(充填高 さ10 m)となる。

一方ヘックボールの最小強度は,第1表から,1m²当り 約2700 kg/m² となる。

すなわち, ABリアクターの運転時に異常事態が発生し 槽内の水抜きを行う場合,最大付着状態では完全に空にす ることは強度面から困難であるが,その場合でも水深5m 相当の水抜きには耐えることができる。したがって,通常 の操作の範囲内では使用可能な強度として十分であること を確認した。



**写真 1** N社充填前('89.2.8) **Photo. 1** Packing media before filling (N company)

## 2. 汚泥付着試験

## 2.1 付着試験の目的と実験方法

ヘックボールの汚泥付着状況をほかの2種類の充填材と 比較して遜色ないかどうか確認するために,N社およびF 社の実装置に充填材を投入して汚泥付着試験を行った。

2. 1. 1 N社においての実験方法

各充填材を4個づつ第4図および写真1に示すように充 填材を投入した。槽底部から1段目,2段目,3段目,4 段目とした。付着汚泥量の評価は各充填材の風袋重量を実 装置に投入する前に測定し,一定期間経過後に充填材を取 り出し,汚泥が付着した状態で充填材を計測して充填材 1m³当りの付着汚泥量を求めることとした。

2. 1. 2 F社においての実験方法

N社での汚泥付着速度が非常に遅いため、F社において も同様の実験を行った。第5図に示すように水深のみが異 なり、他の条件はN社と同一にして、充填材1m³当りの 付着汚泥量を求めた。しかし、充填後3カ月で**写真2**に示 すように充填材が閉塞状態となったため実験を終了した。

#### 2.2 実験結果と考察

N社およびF社において,充填材1m³当りの汚泥付着 量(湿潤重量)の確認を行った結果を第3~5表に示す。 汚泥の付着状態は,写真2,3,4に示す。表および写真 より次の結果を得た。

1) N社において汚泥付着状況は,写真3に見られるよう に1段目から4段目までのどの充填材も薄い膜が付着し ている程度であった。

10ヵ月目にようやく1段目の充填材だけ既設の充填材と同程度の汚泥が付着した。

第4表から1段目の充填材で付着汚泥量の多い方から V充填材,ヘックボール,M充填材の順であった。



第5図 充填材投入状況(F社)Fig. 5 Distribution of packing media in tank (F company)

第3表 単位体積当りの汚泥付着量(N社)「充填後3カ月」 Table 3 Volumetrical deposit per unit volume (N company) (3 months after filling) Unit: g/m³

(o months after ming)			0,
	V media (1 100/m ³ )	M media [380/m ³ ]	HEC ball (591/m ³ )
Bottom layer	9 900	8 360	5 910
2nd layer	17 600	7 980	8 865
3rd layer	19 800	13 300	14184
4th layer	$14\ 300$	14060	19 503
Average	15 400	10 925	12 116

第4表 単位体積当りの汚泥付着量(N社)「充填後10カ月」 Table 4 Volumetrical deposit per unit volume (N company)

(10 n	Unit : g/m ^e		
	V media (1 100/m³)	M media [380/m ³ ]	HEC ball (591/m ³ )
Bottom layer	203 500	137 560	158 388
2nd layer	20 900	10 260	13 593
3rd layer	3 300	5 320	8 274
4th layer	18700	4 940	17 139
Average	61 600	39 520	49 349

2) F社においての汚泥付着状況は,写真2に示すように, 3カ月で充填材が閉塞状態となった。これは, 槽に浮遊 している汚泥を充填材内に取り込んで団子状になったの ではないかと考えられる。

充填材内に取り込んだ汚泥も付着汚泥として考えれば、充填材1m³当りの汚泥付着量が多い順からヘックボール、V充填材、M充填材の順であった。

上記より, ヘックボールは汚泥付着の点からも他の充填 材と遜色はなく実装置に適応できると考える。

## 3. 汚泥剝離試験

#### 3.1 汚泥剝離試験の目的と実験方法

ABリアクターの性能上,汚泥によって充填材が閉塞状 態となった場合,ガス逆洗で充填材に付着した汚泥が均一 に剥がれることが必要である。そこで,N社およびF社に おいて汚泥付着試験を行った充填材を用いて,ヘックボー ルとほかの2種類の充填材について剥離試験を行った。

#### 3. 1. 1 剥離試験方法

N社およびF社の汚泥付着試験に用いた充填材を第6図の実験装置に投入し、下部より空気を吹き込み逆洗を行った。

写真2 F社充填後3ケ月目の汚泥付着状況 (各段のヘックボール) Photo.2 Deposit after three months (F company) (HEC ball at every layer)





- 子具 3
N社充填後6ケ月目の汚泥付
着状況(1段目の充填材)
Photo. 3
Deposit on media after six
months (N company)
(Media in bottom layer)

N社充填後10ヶ月目の汚泥付 着状況(1段目充填材) Photo.4

Deposit on media after ten months (N company) (Media in bottom layer)

第5表	単位体積当りの汚泥付着量(F社)	「充填後3カ月」
Table 5	Volumetrical deposit per unit volume	e (F company) Unit : g/m ³

(5 m	Onit: g/m		
	V media (1 100/m³)	M media [380/m³]	HEC ball [591/m ³ ]
Bottom layer	457 600	285 380	458 025
2nd layer	$372\ 900$	358 340	411 927
3rd layer	330 000	334 020	432 021
4th layer	306 900	359 100	432 612
Average	366 850	334 210	433 646



F社の充填材については、全段とも実験に可能なだけ汚泥が付着していたため、逆洗風量 42 ℓ/min・nozzle および



充填材形状及びガスの逆洗流量に対す る汚泥剥離率(F社) 逆洗風量:70(@/min)

Arrangement of media and removal rate

第7図 充填材の方向

Fig. 7 Direction of packing media

第6表 充填材形状及びガスの逆洗流量に対する汚泥剥離率 (N社)逆洗風量:42(ℓ/min)

(at air backwash ra	edia and removal ate∶42 ℓ/min)	I rate (N company)

Туре		Before backwash	After 30 minute backwash (g)	Media weight 〔g〕	Removal rate
V media	(Vertical)	196	101	40	60.9
M media	(Vertical)	461	325	109	38.6
HEC ball	(Vertical)	319	176	70	57.4

第7表 充填材形状及びガスの逆洗流量に対する汚泥剥離率 (F社)逆洗風量:42(ℓ/min) Table 7 Arrangement of modia and arrange (D

 Table 7
 Arrangement of media and removal rate (F company) (at air backwash rate: 42  $\ell/\min$ )

Туре	Before backwash (g)	After 30 minute backwash	Media weight (g)	Removal rate
V media (Vertical) (Holizontal)	317 397	$\begin{array}{c} 273\\212\end{array}$	41 40	15.9 51.8
M media (Vertical) (Holizontal)	$\begin{array}{c} 705 \\ 841 \end{array}$	580 762	$\begin{array}{c} 107 \\ 107 \end{array}$	$20.9 \\ 10.8$
HEC ball (Vertical) (Holizontal)	666 657	$\begin{array}{c} 354 \\ 400 \end{array}$	$71 \\ 71$	52. 4 43. 9

70 ℓ/min・nozzle の 2 種類で充填材の縦方向および横方向 について剥離試験を行った。充填材の縦方向および横方向 については**第7図**に示す。逆洗時間は 30 min とした。

N社の充填材は1段目のみが剥離試験が可能であったため、逆洗風量  $42 \,\ell/\min$ ・nozzle で縦方向の1条件だけで試験を行った。

## 3.2 実験結果と考察

第6表にN社の充填材の剥離試験の結果を示し,第7表 および第8表にF社の充填材の剥離試験の結果を示してい る。またN社およびF社の充填材について逆洗前および逆 洗後の状態の1例を写真5,6に示す。

剥離試験の結果,次のことを確認した。

- (1) N社およびF社の付着汚泥とも剥離率に関してヘッ クボールはV充填材とほぼ同一であり,M充填材に比 べると明かに剥離率が大きかった。
- (2) ヘックボールは他の充填材に比べて充填材の方向に よる剥離率の差が小さかった。

ヘックボールは汚泥の剥離に関して,どの充填材よりも 方向性による影響が少なく,かつ剥離率が大きいことより ランダム充填であるABリアクターには適している。

	(at air backwash rate: 70 $\ell/\min$ )				
Type	Before backwash (g]	After 30 minute backwash	Media weight	Removal rate	
V media (Vertical) (Holizontal)	$\begin{array}{c} 342\\ 275\end{array}$	221 108	41 41 41	40. 2 71. 4	
M media (Vertical) (Holizontal)	$\begin{array}{c} 671 \\ 640 \end{array}$	$\begin{array}{c} 242\\ 308 \end{array}$	$\begin{array}{c} 106 \\ 106 \end{array}$	75. 9 62. 2	
HEC ball (Vertical) (Holizontal)	667 611	201 230	71 71	78. 2 70. 6	



第 8

Table 8

## **写真5** N社充填材(逆洗前) Photo.5

HEC ball before backwash (N company)



## 写真6

N社充填材(ヘックボール)30分逆 洗後

Photo. 6

HEC ball after 30 minute backwash (N company)

## まとめ

新型球状充填材ヘックボールの強度,汚泥付着量,汚泥 剥離率の面から性能確認した結果をまとめると次のとおり である。

- (1) 槽内に水張りを行った状態での運転には、ヘックボ ールは強度的に問題ないことが確かめられた。
- (2) 充填材同志の絡みが認められなかったことから、充 填材によるブリッジの形成が起こりにくいと推定され る。
- (3) 1 m³ 当りの汚泥付着量は他の充填材と比較し、ほ とんど変らなかった。
- (4) 汚泥の剥離に関しては、充填材の方向による剥離率の差が小さく、ランダム充填であるABリアクターの充填材としては適した構造である。

むすび

以上の試験結果より,このたび実装置にヘックボールを 利用することになった。

最後に,本稿の作成に当たり多大なご協力,ご支援を賜 った,関係各位に深謝致します。 深層曝気装置による貯水池の水質改善

Improvement of Impounded Water Results Achieved by Use of Hypolimnetic Aerator



Installation of hypolimnetic aerators was found to be effective in supplying dissolved oxygen to the hypolymnion of a reservoir which was suffering from eutrophication. The water quality was much improved as a result prevented leaching of  $NH_4^+$ ,  $PO_4^{3-}$ ,  $Mn^{2+}$ , etc. out of benthal deposits without disturbing thermal stratification.

## まえがき

一般に河川の下流流域に沿って開発の進んだ都市部から みると,かなり上流流域に位置して,最近までは比較的清 澄な水質の水が得られるとされていた湖沼やダム,貯水池 でさえも,近年の都市化スプロール現象の影響は避けられ ず,さらに上流部に開発された地域から生活排水,工場排 水,農業排水などが流れ込むこととなり,自然の浄化能力 を上まわる汚濁物,栄養塩類が貯水池内に蓄積されて,富 栄養化への過程を急ピッチにたどりつつある。

本来, 富栄養化現象は, 自然界の生物代謝活動の結果と して, 数百年から数千年の年月をかけて徐々に変遷してい くものとされていたが, 近年人類による生産活動の活発化 により, 湖沼などに排出される栄養塩類が急激に増加する こととなり, その結果, 栄養塩類濃度の増加と共に植物性 プランクトンの異常発生をはじめ水質汚濁の問題を引き起 こすこととなった。

以上のような現象も富栄養化と呼ぶが,長年月の自然要 因による富栄養化と区別するために,人為的富栄養化と呼 ばれている。現在われわれが問題とする富栄養化は,ほと んどがこの人為的富栄養化であるといってよい。

このような状況から湖沼・ダム・貯水池などの水質を守 りあるいは改善するために,種々の方策が各方面でとられ ているところであり,その詳細については以前に本技報¹⁾ で紹介したことがある。それによると大別して,

(1)流域対策 :汚濁発生負荷を源から抜本的に削減す る方法(例:下水道の完備)。

(2)貯水池内対策:貯水池内に蓄積した汚濁物 を 除 去 す る。あるいは,水質を改善する方法。 の2方式がある。

今回, 貯水池内対策として, 最も効果があるといわれて いる深層曝気装置を, 神戸市千苅貯水池向けに納入したの で, その運転結果, 水質改善の効果などについて報告する。

#### 1. 深層曝気循環法

貯水池の曝気および循環法には,主に次の2方式がある が,本報では2)深層曝気循環法について紹介する。

1) 全層曝気循環法

貯水池全体を撹拌混合する方法で、表層と底層の温度差 がほとんどなくなることから、温度躍層を破壊することに なり、成層破壊法ともいわれている。本方式の特長は、貯 水池全体の撹拌によって底層部へ酸素を供給することによ り、底質から栄養塩類、Fe, Mn などの溶出を防止して、 底層水の水質改善を行うのみならず、表層部に発生する植 物プランクトンを日光の届かない底層部に移動させて、そ の増殖抑制に寄与することである。その模式的な設置例を 第1図に示す。

なお,当社では大阪府滝畑 ダムや 近畿農政局呑吐 ダム (兵庫県)などに本方式による本格的な実装置を納入し, 好成績を収めている。

#### 2) 深層曝気循環法

深層曝気循環法は、スイスの湖で初めて採用され、その 後、主に欧米で発展してきた。本法は温度躍層を破壊しな いで底層部に直接酸素を供給する方法である。このため底 層部の低温がそのまま維持されるので、自然の生態系に大 きな影響を与えず、たとえば冷水魚の増殖に効果があるた め、欧米のニーズ(釣りなどのリクレーション)に適した 方法であるといわれている。



第1図 全層曝気装置の設置例 Fig. 1 An overall aeration system

神鋼パンテツク技報



第2図 深層曝気装置(エアリフト型,西ドイツ) Fig. 2 A full air lift, hypolimnetic aerator used in Wahnbach Reservoir, West Germany (Bernhardt, 1974)



**写 真 1** 深層曝気装置(アクアマージ) **Photo. 1** Hypolimnetic aerator (AQUA-MARGE)

わが国で既に稼働している深層曝気装置は,1984年に多 目的ダムの一庫ダム(兵庫県)に設置されたものが唯一で あった。本装置は,西ドイツの Wahnbach 貯水池に設置 されたのと同型(**第2図**)である。

ここでは常用洪水吐から放流する際の硫化水素臭の発臭 防止が目的であった。

一方,今回当社が開発し,神戸市の千苅貯水池に納入し た深層曝気装置は全水没型で,水面上に浮かぶ台船や装置 頂部を極力少なくして,景観や船の航行に支障がないよう に工夫している。

本深層曝気装置は**写真1,第3図**に示すような二重円筒 形の水没式エアーリフト装置である。

その構造は陸上に設置したコンプレッサーからエアーホ ース(H)を通じて、貯水池底部近くに設置したエアーディ フュザー(G)に空気を供給すると、空気は深層曝気装置内 筒(E)を上昇する際、水中に一部が溶解し、酸素を供給す るだけでなく、エアーリフト効果によって大量の底層水を 揚水することができる。揚水された底層水は深層曝気装置 外筒(D)を下降し、循環水出口(F)から**第3**図に示す矢印 に沿って、広い範囲に拡散されるので、その溶存酸素の作 用で底層部全域の水質を改善することができる。

一方,溶解せずに循環装置内に残留した空気は,排気用 ホース(C)を通じて排気口(A)に排出されるので,上層の 水域を撹乱することはない。また本装置は底層部深く設置 されるので,上層部は温度躍層を保持したまま静止してい る。

ところで神戸市千苅貯水池は、有効水深27.4m,有効貯



- A : Air vent B : Water return hose C : Air vent hose D : Circulation tube
- E : Water drafting tude
- F : Effluent
- G: Air diffuser
- $H: Air \ hose$

**第3図** 水没式深層曝気装置 Fig. 3 Hypolimnetic aerator

水量1161万m³の水道専用貯水池で,最近は栄養塩や有機 汚濁物の負荷量の増加により富栄養化の兆侯が見られるよ うになってきた。また,夏の成層期には底層部の溶存酸素 が減少するため,底質から栄養塩だけでなく,鉄やマンガ ンの還元溶出も見られるようになった。

本貯水池では水深ごとに任意に選択取水が可能なため, 特に全層曝気を行わず,底層部分の水質改善と富栄養化防 止を目的に,底層部に直接酸素が供給できる深層曝気法を 採用することになった。

貯水池内には**第4図**に示すような要領で,堰堤から上流 に向かってそれぞれ水平距離にして約150,650,1150そ して2000mの位置に1基ずつ合計4基の深層曝気装置を 設置した。

なお、本装置の仕様の概要は次に示すとおりである。

深層曝気装置の仕様

設備名称	住 様	数量
深層曝気 装 置	形式:全水没式 要部材質:FRH 寸法:装置外筒径 1600φ 内筒径 500φ 本体筒長 13,10,8.5,7m	>    4基
空気圧縮機	形式:空冷パッケージ形オイルレフ 容量:3 000 <b>ℓ</b> /min×7 kgf/cm ² 200 V×22 kW×2 p	、ねじ式 2 台

#### 深層曝気装置の揚水特性

#### 2.1 揚水量をもとめる理論式

深層曝気装置を設計するには、その揚水特性(循環水量) を把握する必要がある。エアリフト方式における揚水量を 求める理論式は、(1)式に示すとおりで、本式はエネルギー 収支から導かれる。



第4図 循環装置設置位置 Fig. 4 Setting points of aerator in Sengari reservoir



第5図 ドラフト径と係数値 Fig. 5 Draft dia. vs. coefficient

$$\mathbf{Q}_{\mathbf{w}} = \alpha \times \frac{\mathbf{Q}_{\mathbf{G}}}{\mathbf{h}_{\mathbf{e}}} \times \ln\left(\frac{\mathbf{P}_{\mathbf{1}} + \mathbf{H}}{\mathbf{P}_{\mathbf{1}}}\right) \times \eta \tag{1}$$

ここに,

$Q_{w}$	:揚水量	(m³/h)
$\mathbf{Q}_{\mathbf{G}}$	:吹込ガス量	(m³/h)
$\mathbf{H}$	:ガス吹込深さ	(m)
$P_1$	:ガス吸込状態絶対圧力	(m)
$\mathbf{h}_{e}$	:揚水抵抗	(m)



第6図 ドラフト管内流速と Qw/Qg Fig. 6 Qw/Qg vs. velocity in draft tube

本(1)式中の揚水抵抗 h。は,ドラフト管(**第3図**では、 E:深層曝気装置内筒部のこと)の入口での摩擦損失,残 存速度水頭に等しいと考えられ,管内流速の関数として(2) 式で示される。

$$\begin{split} h_{\rm e} &\propto U^2 \\ &\propto Q_{\rm w}^2/D^4 \end{split} \tag{2}$$

D:ドラフト管径(m)

しかしながら当社におけるガスリフト装置の揚水特性水 理実験より得られた結果³⁾では,揚水量はガス吹込深さH よりドラフト内のガス吹込深さH_Dに強い相関があるとし ており,今回の本装置の設計でも,(1)式は適当でないと判 断し,このガスリフト装置の揚水特性水理実験より得られ た次の実験式(3)式を基準にした。

$$Q_{w} = X \times Q_{G}^{Y} \times \left\{ ln \left( \frac{P_{1} + H_{D}}{P_{1}} \right) \right\}^{Z}$$
(3)

X, Y, Z:ドラフト管径の関数

#### 2.2 実装置の揚水量

揚水量の測定は,設置した4基のうち1号機( $H_{D}$ =11.5 m)と4号機( $H_{D}$ =5.5 m)に流速計を取り付け,吹込ガス量を種々変化させて行った。ガスリフト装置の揚水特性 水理実験より得られたX,Y,Zなどの係数値は第5図に 示すとおりである。

本装置の測定結果からみて,係数Xを補正すれば,(3)式 と測定揚水量はほぼ一致した。

補正比は実験値1にたいして測定値は0.45となったが, これは揚水抵抗が実装置の場合実験装置よりも大きく,そ の影響が出たためと考える。

**第6図**にはドラフト管内流速とQw/Qaの関係を示した。 以上の結果から,揚水量を効率良く増大するためには,ド ラフト管径がある程度大きく,ドラフト管長も長いほうが 良いといえる。

## 3. 運転結果³⁾

本運転の結果,底層部の循環を行うことにより,貯水池内の水温や溶存酸素の分布の様子は次に示すようになった。

#### 3.1 水温

深層曝気装置設置前と後の貯水池内のある 地点での水温の分布状況は**第7図**に示すとお りである。

貯水池表面の年間の水温は5~30°Cまで 大幅に変動するが水深25m以下の底層部は 年間を通じて5~6°Cの冷水となっている。

曝気装置の設置前には水温躍層は通常4~ 5月に形成され始め、その後夏季に向かうに 従って上層と下層の2ヵ所で2層化傾向が顕 著に現れていた。この水温躍層は12~1月に かけて消滅し自然対流による循環期に入った。

水温躍層の位置は季節により変動し,春期 は水深4~7mの位置で,夏期の2段躍層形 成時には水深数mと10数mの位置に形成され る。秋期は2次躍層が消滅して1次躍層のみ が表層から10数mの位置に残るが,冬期には これも消滅して上下層が循環混合することと なる。

一方,曝気装置設置後の水温躍層の形成は 装置設置前の1次躍層の位置が数m下がった 程度で,設置前のパターンとほとんど同じで あった。これらの測定結果から判断して深層 曝気装置による底層部の循環を行っても,貯 水池内の成層破壊は全く起こらなかったとい える。

## 3.2 溶存酸素

(

一般に貯水池の場合,上層部では植物プラ ンクトンによる光合成(酸素生産)が活発に 行われ,逆に下層部では沈降してくる有機物 の分解(酸素消費)が活発に行われる。

一方,夏季の水温上昇に伴って水温の成層 が見られるので,その結果,上層部の溶存酸 素(以下DOと称す)は過飽和となり,下層 部は無酸素状態になると予想される。

深層曝気装置を設置する前後の貯水池内の ある地点での,深度ごとのDOを月を追って 観測した結果は**第8図**に示すとおりである。

設置前の状況は、冬期の循環期には深水層 にまで十分なDOが見られたが、水温躍層が形成されるに つれて深水層域のDOは2~5 mg/ℓ まで減少した。そして 夏期には予想されたとおり、上層部のDOは過飽和にな り、底層部は冬期の循環が起こるまでのあいだ無酸素状態 が続いた。

なお、循環装置運転開始直前の下層循環水域(底部~水 深22 m)のDOは3.3~6.5 mg/ℓであった。そして運転 開始後約30日で酸素の供給および循環作用によってDOは やや増加したものの、その後減少傾向が見えたので、7~ 8月に入って循環装置への空気供給量を増量したところ、 下層循環水域でDOの増加が認められ、10月にはその飽和 率が27%になった。第9図に示すとおり、堰堤から上流 2000 mまでの底層水の無酸素状態はまったく解消され、 目標値の5 mg/ℓまでには至らなかったが好気的状態は保 持できた。これは3.1項の水温に示したように躍層が破壊







第8図 循環装置設置前後の溶存酸素飽和率(%)の鉛直分布

Fig. 8 Vertical distribution of DO saturation degree before and after setting up aerator

されていないことから考えて,本装置による底層部への空 気の供給が酸素の消費量を上回った結果と考えられる。

## 3.3 水質の改善

淡水は4°Cにおいて比重1を示し,それ以上・以下の 水温では比重は1以下となる。このような性質上,貯水池 では水温の上昇・下降に伴い,鉛直方向への水の循環と停 止を繰り返し,年間の鉛直循環サイクルを形成している。 このような貯水池の鉛直循環サイクルに伴い水質も大きく 変化する。

一般に夏の成層期の貯水池底層ではDOの低下と、これによるNH₄⁺, PO₄³⁻, Fe²⁺, Mn²⁺などの底泥からの溶出が起こり、貯水池の水質を著しく悪化させることになる。ところが本装置の設置で酸素が供給されることにより、水質改善の効果が明らかになった。

第10,11図に示すとおり,底層水中に過去10数 mg/ℓも



**第9回** 溶存酸素飽和率分布縦断図(%) Fig. 9 Longitudinal section of DO saturation degree (%)

還元溶出していた NH4⁺ や Mn²⁺が本曝気装 置の運転により抑制されている。

これらのことから本装置の運転制御は,底 層水のDO濃度の管理で行える。ただ,最小 DO維持濃度については,不明であるが,こ のたびの調査では栄養塩濃度が通年の夏から 秋にかけて上昇するパターンとは逆に,減少 傾向にあるため現状では,DO1~3 mg/ℓ以 上が制御目標と推察される。

この結果をふまえ,今後はDO濃度と溶出 との関連および,貯水池全体の水質との相関 を長期的にとらえ,貯水池の富栄養化制御法 としての深層曝気の効果を確認する必要があ る。

### むすび

わが国において実施例の少なかった深層曝 気装置について、特に今回当社が開発した水 没式深層曝気装置の納入事例から、揚水特性 や水質改善に関するデータが得られたことは、 この種の装置の今後の合理的な設計に寄与す るものである。この実績を生かして今年度、 より大型の第2号機を建設省主管の多目的ダ ム(総貯水容量1600万 m³)に納入し1990年 7月より運転開始しており、その水質保全効 果が期待されている。

最後に本装置の納入,運転にあたり多大な るご指導,ご協力をいただいた神戸市水道局 の方々に感謝の意を表します。

#### 〔参考文献〕

- 1) 神鋼フアウドラー技報 Vol. 32, No. 1 (1988)
   p. 35
- 2) 神鋼フアウドラー技報 Vol. 27, No. 3 (1983) p. 61
- 3)酒井茂喜(神戸市水道局):千苅貯水池における 底層水循環装置による水質改善(1),第40回全国 水道研究発表会講演集(1989) p. 469









神鋼パンテツク技報

エマルジョン型高分子凝集剤

## Application of New Emulsion Type Synthetic Flocculants



Numerous kinds of synthetic flocculants have been used not only in water and waste treatment but also as ingredients of products in many industrial fields.

However, most of the synthetic flocculants, being supplied in the form of powder or gel, are not easily measured and dissolved in water in short time.

Contrasted with these disadvantages, new emulsion type synthetic flocculants are liquid and can be fed by a measuring pump, eliminating a measuring instrument and a dissolving tank, and dissolved in water immediately.

In this artcle, application procedure and examples of new emulsion type synthetic flocculants are described.

## まえがき¹⁾

高分子凝集剤の需要は年々増加しており, '90年の国内需 要はアニオン・ノニオン系が1万1000トン, カチオン系が 1万2500トン, 合計約2万5000トンが見込まれるように なっている。

その化学構造も多種にわたっているが,製品としては, 粉末タイプのものがほとんどであり,ペースト状のものは 少なくなっている。

しかも、ここ1~2年の間に新製品として、遠心脱水用 に適したアクリル系カチオンタイプや、溶解しやすくかつ ハンドリング性にすぐれたエマルジョンタイプのカチオン 系高分子凝集剤が登場しており、需要が伸びている。

そこで,本報では,このエマルジョンタイプの高分子凝 集剤について紹介するとともに,その使用法および実施例 について述べる。

#### **1**. エマルジョン型高分子凝集剤とは^{2),3)}

エマルジョンとは、一般的に液体中に液体粒子がコロイ ド粒子あるいは、それより粗大な粒子として分散して乳状 をなすものをいう。このエマルジョンにも2つの型があっ て、油中水型(W/O型:Water in oil)と水中油型(O/W 型:Oil in water)がある。エマルジョン型高分子凝集剤 は油中水型で前者に属するものである。これを溶解すると 反転して後者の水中油型の存在状態となる。すなわち、エ マルジョン型高分子凝集剤はポリマー粒子を水滴ゲル状に して油中に分散したものといえる。媒体である油の方が量 的に多いように思われるが、まったく逆でポリマーを含む 液体コロイドの方が量的にかなり多い。また、ポリマーそ のものの比率は40%程度である。媒体の油はパラフィン系 の炭化水素である。

このような新製品が有効なのは、次の理由による。もと もと高分子は水に溶けにくい。例えば、同じ凝集剤でも硫 酸バンドよりアルギン酸の方が水に溶けにくい。高分子凝 集剤は非常に高分子であるがゆえに、水に溶けにくいもの となっている。したがって水性ポリマー溶液をつくる際、 溶解速度が遅く、粉末ポリマーを水中に分散させようとし ても、水と接触すると塊として集合する性質がある。塊と なると水と接触する表面積が少なくなり,塊の中に水が入っていくのを妨げ,増々溶けにくくなる傾向がある。これを避けるため,粉末タイプの高分子凝集剤は一定の大きさの粒状にして分散のよいものにしている。すなわち,"まま粉"にならないように,また取扱時,飛散しないように一定の粗い粉末(0.1~1.0 mm)にしている。このことが個々の粉末粒子としての溶解速度を逆に遅くすることにもなっている。

エマルジョン型ポリマーの場合,非常に細かい微粒子 (数 µ)にし,水滴ゲル状粒子として分散させているので, 水に接すると,高分子でありながら非常に溶解し易くなっ ているのが特長である。

さらに、溶解性の問題以外にも、このエマルジョン型高 分子凝集剤は粉末タイプの凝集剤と同質のものをエマルジ ョンタイプとして製品化できるだけでなく、2つの粉末製 品をエマルジョンとしてプレンドしたもの、アニオンタイ プとカチオンタイプを共存させた両性タイプのエマルジョ ンが製品化できる。このように2液法として使用するもの を1液法としても製品化できるので、既存の粉末やペース トタイプと違った領域で使用可能な製品を供給できること になった。

#### 2. エマルジョン型高分子凝集剤の特長と種類

従来の粉末品,ペースト品と比較して次のような特長が ある。

- 1)溶解時間が短かく、溶解方法も簡単である。粉末やペ ーストタイプのように、ディスパージャーなどを使用し て分散をよくしても1~2時間の溶解時間を要する。エ マルジョンタイプの溶解時間は通常5分程度で充分であ るが、15分もあれば完全に溶解できる。
- 2) 液状品であるため,定量ポンプでの注入ができ,自動 化や,省力化も容易である。
- 3) 粉末タイプのように微粒子の飛散がない。
- 4) 適用分野としても,塩類濃度が高いもの,pH の高い ものから低いものなど広い範囲に適用可能である。 これらの特長を有するエマルジョンタイプの種類を**第1**
- 表に,また,溶解したときの粘度の一例を第1図に示す。







 エマルジョン型高分子凝集剤の使 用方法

エマルジョンタイプは流動性のある液体な ので,溶解は簡単である。エマルジョンは溶 解が早いので,むしろ短時間で一挙に溶解す る方がよい。

溶解機構としても, 原液タンクからライン ミキシングで直接溶解し, そのまま注入でき るので,溶解タンクの省略も可能であり, シ ステムとして自動化に対応し易い。

粉末タイプはディスパージャーを用いて自動分散できるが、ディスパージャーのノズル が、湿気などで目詰りを起こして定量性を失 うことがあるので、定期的にチェックと清掃 が必要である。また、ペーストタイプの自動 溶解は不可能である。この点、エマルジョン タイプは、溶解タンクに溶解することもでき、 またライン溶解により直接注入することも可 能である。第2~4図に、エマルジョンタイ プの溶解プロセスのモデルを示す。

第2図はスタティックミキサーを利用して, 連続的にラインで溶解し,プラントに直接注 入するプロセスである。

第3図はバッチ式で、粉末タイプやペース トタイプと同様、溶解タンクで直接溶解する プロセスである。ただし、液状なので、人手 によらず、ポンプで投入できるので、溶解作 業はいたって簡単である。

第4図はタンク溶解ではなく、ライン溶解 しながら、貯留タンクに入れる方法である。 大量使用の場合に、粉末タイプだと溶解タン クを2槽設け交互に溶解するが、エマルジョ ンだと1槽で済ますことができる。

エマルジョン型高分子凝集剤の実施例

エマルジョン型高分子凝集剤の実施例を第 2表に示す。写真1は製品の一例を示したも のである。

第1表 エマルジョン型高分子凝集剤の種類 Table 1 List of the emulsion type synthetic flocculants

Brand			Ionic	Mol. Wt.	Effective
Ionicity	Series No.	The main component	potential	approxi.	pH range
Nonionic	2300	Polyacrylamide		1 600×10 ⁴	3~10
Anionic	2341 2650 2360 2541	Polyacrylamide	$ \begin{array}{c} \cdots \rightarrow \\ \cdots \rightarrow \\ \cdots \rightarrow \end{array} $	$\begin{array}{c} 1 \ 900 \times 10^{4} \\ 1 \ 300 \times 10^{4} \\ 1 \ 600 \times 10^{4} \\ 1 \ 900 \times 10^{4} \end{array}$	$5\sim125\sim125\sim124\sim12$
Cationic	$1360 \\ 1560 \\ 1380 \\ 1300 \\ 1500 \\ 1600 \\ 1581$	Polymetacrylic acid ester	$ \begin{array}{c} \cdots \rightarrow \\ \cdots \rightarrow \\ \cdots \rightarrow \\ \cdots \cdots \rightarrow \\ \cdots \cdots \rightarrow \end{array} $	$\begin{array}{c} 500 \times 10^{4} \\ 500 \times 10^{4} \\ 400 \times 10^{4} \\ 350 \times 10^{4} \\ 350 \times 10^{4} \\ 250 \times 10^{4} \\ 400 \times 10^{4} \end{array}$	$ \begin{array}{r} 3 \sim 10 \\ 2 \sim 10 \\ 3 \sim 10 \\ 2 \sim 10 \\ 3 \sim 10 \\ 2 \sim 10 \\ 2 \sim 10 \end{array} $
	3330 3360 3560 3380 3390	Polyacrylic acid ester	$\begin{array}{c} \rightarrow \\ \cdots \rightarrow \\ \cdots \rightarrow \\ \cdots \rightarrow \\ \cdots \cdots \rightarrow \end{array}$	$\begin{array}{c} 700 \times 10^{4} \\ 500 \times 10^{4} \\ 500 \times 10^{4} \\ 400 \times 10^{4} \\ 800 \times 10^{4} \end{array}$	$ \begin{array}{r} 3 \sim 10 \\ 3 \sim 10 \\ 2 \sim 10 \\ 3 \sim 10 \\ 3 \sim 10 \\ 3 \sim 10 \end{array} $
Bi-ionic	BE496A BF496A BY496A BZ496A BE110A	Polyacrylamide Metacrylic acid ester			$2\sim10 \\ 2\sim10 \\ 2\sim10 \\ 2\sim10 \\ 2\sim10 \\ 2\sim10 $





Fig. 2 Continuous dissolving system



第3図 バッチ溶解システム(ケース1) Fig. 3 Batch wise dissolving system (Case 1)



第4図 バッチ溶解システム (ケース2) Fig. 4 Batchwise dissolving system (Case 2)

M社の例は製薬会社の余剰汚泥の脱水で、塩鉄 +ポリマー2液法でも,脱水困難で一時停止して いたものであるが,エマルジョンタイプ1液だけ で良好な結果が得られるようになったケースであ る。

D社とA社はいずれも製薬会社の余剰汚泥であ るが、脱水機は異なる。エマルジョンタイプが従 来のペーストタイプと比較して, 少ない薬注量で 好結果が得られた例である。

S社は食品系の浮上濃縮汚泥の脱水で他の薬品 では満足な運転ができなかったが、エマルジョン タイプに変更すると脱水率が大きく改善され、良 好な結果が得られるようになった例である。

#### す む び

高分子凝集剤のエマルジョンタイプは新製品と して, まだ日が浅く, 実施例は多くないが, 溶解 の容易さと液体であることの特長を生かして,プ ロセスの自動化と省力化を図りたい。 また, pH の適用範囲の広さを生かして、特殊な汚泥処理へ の適用など今後さらに検討を加え、新製品として 適用分野を広げていきたい。

#### 〔参考文献〕

- 1) 化学工業年鑑 90年版
- 2) 公開特許公報, 町田益造他「油中水型高分子エマ ルジョン組成物」
- 3) 公開特許公報, 町田益造他「水溶性ポリマーの安 定な油中水型エマルジョンおよびその製造方法」
- 4) 及川正夫, 蔦ガ谷暢夫, 光上義道「神鋼パンテツ ク技報」vol. 33, No. 2, 38~42 (1989)



エマルジョンポリマーおよび 18 kg 写 真 1 缶製品 Photo. 1 Emulsion polymer and 18 kg packed

can

第2表 エマルジョン型高分子凝集剤実施例

Table 2 The application examples of the emulsion type synthetic flocculants

M Inc. cess idge*1 1.5 lt press	D Inc. -ditto- *1 2. 3 DTT-	A Inc. -ditto- *1 4.0	S Inc. Floatation sludge*2
cess idge*1 1.5 lt press	-ditto- *1 2. 3 DTT-	-ditto- *1 4. 0	Floatation sludge*2
1.5 lt press	2. 3 DTT-	4. 0	. 15
lt press	DTT-		
	MRP*3	RDP*4	Decanter
ix; $C\ell_3$ , ionic anionic lymer* ⁵ $\downarrow$ perfloc: 51: 0 ppm	PAC 2 500 ppm & cationic polymer 1 120 ppm PAC 1 250 ppm Superfloc: 1560; 280 ppm	FeCl ₃ 700 ppm & cationic polymer 785 ppm FeCl ₃ 700 ppm, Superfloc: 1581; 140 ppm	New plant Superfloc: 1581; 1 300 ppm
$\begin{array}{c} 7.\ 0\\ 6\ 800\\ 2\ 250\\ 1.\ 45\\ 1.\ 00\\ 65.\ 5\\ 91.\ 1\\ <0.\ 1 \end{array}$	$ \begin{array}{c} 6.6\\ 5530\\ -2.30\\ 2.02\\ 58.9\\ 60.8\\ <0.1\\ \end{array} $	7. 2 5 510 2. 09 1. 75 79. 9 88. 4 0. 63	6. 0  5. 5 82. 9
→83. 5 Good	87. 5→86. 0 Good	80. 1→79. 5 Good	62. 7 Good
	ix ; Cℓ ₃ , ionic anionic ymer*5 ↓ perfloc : j1 : ) ppm 7. 0 5 800 2 250 1. 45 1. 00 65. 5 91. 1 <0. 1 →83. 5 Good Good rer *4 1	ix ;       PAC 2500 $C\ell_3$ ,       ppm &         ionic       anionic         anionic       polymer         ionic       PAC 1 250         ppm       Superfloc:         1560;       280 ppm         7.0       6.6         5800       5 530         2250       —         1.45       2.30         1.00       2.02         65.5       58.9         91.1       60.8 $\langle 0.1   \langle 0.1  $ >83.5       87.5 ->86.0         Good       Good         Good       Good         Good       Good	ix ;       PAC 2 500       FeC $\ell_3$ C $\ell_3$ ,       ppm &       700 ppm &         ionic       cationic       cationic       cationic         anionic       polymer       polymer       polymer         perfloc:       PAC 1 250       FeC $\ell_3$ j1       20 ppm       785 ppm $\downarrow$ $\downarrow$ $\downarrow$ perfloc:       PAC 1 250       FeC $\ell_3$ j1:       ppm       700 ppm,         j280 ppm       140 ppm         7.0       6.6       7.2         5800       5 530       5 510         2250

Pharmaceutical manufacuturer

*2 Food industry (Mayonnaise)

*8 Drum type thikener

and multi-roller press

*6 Large scale SS more than 100 mesh

^{*5} The operation had been impossible



#### 多孔性ガラス膜で限外沪過システム―

#### 化学、食品向け開拓

Porous glass ultrafiltration system for chemical and food industries.

神鋼パンテックは、多孔性ガラス膜を用いた限外沪過シ ステムを開発,本格的な用途開拓に乗り出した。大阪工業 技術試験所と共同で開発したもので、98%シリカ質のキ *ピラリータイプの無機膜をモュジール化した。とくに20 -1000オングストロームの範囲でシャープな孔径コント ロールが可能なうえ、有機UF膜に比べ高い耐熱性と耐食 性を有する。同社では有機溶剤沪過用途をはじめ、酸液精 製沪過など化学プロセス用途、バイオ・食品沪過プロセ ス、ガス分離プロセスなどに向け実用化を目指す。

多孔性ガラス膜は、組成比の異なる二種のガラスを混合 加熱処理し、非シリカ成分を酸処理によって除去すると、 貫通孔の割合が高い多孔膜が得られる。製造は赤川硬質硝 子工業所の協力を得ている。ガラス質であることからホロ ーファイバーやキャピラリー型などと成形性が良く、ゾル ーゲルガラスなどによる膜の一体化加工が容易となり、シ ール性も高い。また、セラミック膜より温度変化にともな う膨張・収縮に強く、有機膜に比べて耐熱性や耐薬品性に 富む。

すでに膜面積 0.08 m のモジュール (ベッセル径 25 mm, 長さ 300 mm) を試作, トルエンといった有機溶剤の沪過テ ストなど実施している。

同社では超高純度薬品分野での酸の沪過精製や食品・バ イオプロセスでの連続分離工程,エマルジョンやガス分離 プロセスなど化学用途が考えられるとして,用途開拓を加 速させる。 ('90.5.24 化学工業日報)

#### GL機器補修に新技術一

#### 低温処理のゾルーゲル法

New method of repairing GL equipments by sol-gel process under low temperature.

神鋼パンテツクは、ゾルーゲル法によるグラスライニン グ(GL)機器の局部補修技術を確立、本格的展開に乗り 出した。熱処理温度が約300°Cという低温でガラス合成 するため、補修部周辺の正常なライニング層を痛めず(再 加熱によるクラック)、密着性に優れた平滑なライニングガ ラス層を任意に形成する。また補修面が突起しないので、 配管の狭い部分やフランジのR部での補修も可能。まず比 較的耐食条件のマイルドな用途での浸透を図る。

GL機器は,液面をガラスでライニングした耐食機器。 ガラスの持つ耐食性,非付着性などの特性を生かし,金属 イオン混入やコンタミを嫌うファインケミカル,製薬など の分野で幅広く使われている。

同社が確立したのは、GL機器のライニングガラス層に クラックが生じた場合の局部補修「G-Fine-R」(商品名)。 ゾルーゲル法によるシリカガラス合成プロセスを使い、低 温(約 300 °C)で, 高温焼成した ライニングガラス層に 近い形状のライニングガラス層が得られる。

これまで局部補修法として,耐食金属であるタンタル製 のキャップで損傷部分を覆う方法や,高密着性エポキシ系 レジンによるライニングがある。しかし従来のタンタル法 では突起物があり,流動性,狭い場所での補修,エポキシ 系レジン法では耐熱性などの点で問題があった。

ライニングガラス層を約350°Cで再加熱すると引っ張り応力がかかり、クラックが生じてしまう。「G-Fine-R」 は約300°Cの局所的熱処理を行うためその心配はない。 まず平滑性が要求される、比較的耐熱性の緩やかなGL機 器での現場補修技術として実績づくりを進める。またこれ に並行して、耐食性を向上させる研究開発にも注力する考 え。 ('90.6.20 化学工業日報)

#### 工場と研究所移転一跡地は神鋼病院に

After a migration for Harima plant and Seishin research center, remaining site of Kobe plant will be providel for Shinko Clinic.

神鋼パンテツクは19日,生産部門を播磨工場に全面移転,技術開発部門は神戸市西区に新設の「西神研究所」に集約する計画を発表した。95年度を最終年度とする中期経営計画の一環で,生産の合理化とコストダウンが狙い。92年春には工場,研究所とも全面稼働させる。総投資額は60億円。本社移転跡地の一部には親会社である神戸製鋼所が神鋼病院を移設する。

計画によれば、敷地面積98500 mの播磨工場(兵庫県・ 播磨町)に13000 mの建屋を新設。重さ30トンまでの製品 をグラスライニングできる大型焼成炉をはじめ、小型炉, コージュネレーション(熱電併給)システムを新たに設置 する。事務棟も約三倍に拡張する。同社では昨年秋までに ステンレス部門の播磨工場移転を終えており、生産部門の 播磨集約が完了することになる。

神戸市西区の神戸ハイテクパークには西神研究所を新 設。11000 mの土地を確保しており、今年9月から一期工 事を開始、クリーンルーム、分析計測設備を持つ研究棟、 実験棟を建てる。92年には現本社周辺に散らばる研究要員 70人を集め、新素材、バイオ、粉体などの研究を始める。 工場集約、研究所新設に必要な60億円のうち、一部は20万 株の第三者割当増資(発行価格11000円、額面500円、割 当先は神戸製鋼所13万株などすべて神鋼グループ、8月21 日払い込み)により調達(新資本金は21億2000万円,発 行済み株式数224万株)し、残りは移転後跡地を区割りし て売却するなどして賄う。

移転後の跡地 50 000 m⁶ については 神戸製鋼所と 共同で 開発することになるが, うち15 000 m⁶に老朽化した神鋼病 院の移設を決定。'94 年 5 月の開院を目標に神鋼が 11 階建 て, ベッド数 325 床の新病院を建てる。

('90.7.23 日刊工業新聞)